

簡式公開說明書

(發行一〇二年度第一期無擔保普通公司債申報用稿本)

- 一、本公開說明書編印目的：發行一〇二年度第三期無擔保普通公司債。
- 二、本次發行公司債之種類、金額、利率及發行條件：
 - (一) 種類：無擔保普通公司債。
 - (二) 金額：發行總額不超過新台幣壹佰貳拾伍億元整。
 - (三) 利率：詳見發行條件 4.。
 - (四) 發行條件：
 1. 名稱：台灣積體電路製造股份有限公司一〇二年度第三期無擔保普通公司債(以下簡稱本公司債)。
 2. 發行總額及面額：發行總額不超過新臺幣壹佰貳拾伍億元整，依發行期限分為甲類四年期及乙類六年期兩種。票面金額為新臺幣壹仟萬元整。
 3. 發行期間及方式：本公司債發行期間分為甲類四年期及乙類六年期，於發行日依票面金額十足發行。
 4. 票面利率：依發行時市場利率訂定，預估年利率不超過 1.55%。
 5. 計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
 6. 還本方式：甲類四年期及乙類六年期均為到期一次還本。
 7. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
 8. 債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
 - (五) 公開承銷比例：不適用。
 - (六) 承銷及配售方式：未委託證券承銷商對外公開承銷。
- 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：詳見本說明書第 44 頁。
- 四、本次發行之相關費用：
 - (一) 承銷費用：不適用。
 - (二) 其他費用：約新台幣 3,000 仟元。
- 五、有價證券之生效不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
- 七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項(詳見公開說明書第 4 頁)。
- 八、投資人查詢本公開說明書電子檔案之網址：公開資訊觀測站(<http://mops.tse.com.tw>)。

一、本次發行前實收資本額來源：詳本公開說明書第 21 頁

二、公開說明書之分送計畫

(一)陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構。

(二)分送及索取方式：請附小包裏郵資及信封袋向本公司索取或請透過網路取閱 (<http://newmops.twse.com.tw>)。

三、公司債承銷商：不適用。

四、公司債保證機構：不適用。

五、公司債受託機構：

名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司

地址：台北市仁愛路四段169號

電話：(02) 2771-6699

網址：<http://www.fubon.com>

六、公司債簽證機構：不適用

七、辦理公司債過戶機構：

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市中正區博愛路35號4樓

電話：(02)2361-0262

網址：<http://www.kgi.com.tw>

八、公司債信用評等機構：

名稱：中華信用評等股份有限公司

地址：台北市信義路五段7號49樓

電話：(02)8722-5800

網址：<http://www.taiwanratings.com>

九、公司債簽證律師：

律師事務所名稱：現代法律事務所

簽證律師：郭惠吉

地址：台北市大安區新生南路二段82號3樓之一

電話：(02)2392-0628

網址：<http://modernlaw.myweb.hinet.net>

十、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林鴻鵬、黃樹傑

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市民生東路三段156號12樓

電話：(02)2545-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

十一、複核律師：不適用

十二、本公司發言人及代理發言人

發言人：何麗梅

職稱：資深副總經理暨財務長

電子郵件：invest@tsmc.com

電話：(03)563-6688

代理發言人：孫又文

職稱：企業訊息處處長

電子郵件：invest@tsmc.com

電話：(03)563-6688

十三、本公司網址：www.tsmc.com

台灣積體電路製造股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 259,282 百萬元 (截至 102 年 3 月 31 日止)		公司地址：新竹科學工業園區力行六路 8 號		電話：(03)5636688	
設立日期：76 年 2 月 21 日			網址：www.tsmc.com		
上市日期：83 年 9 月 5 日		上櫃日期：不適用		公開發行日期：81 年 10 月 30 日	
管理股票日期：不適用		負責人：董事長 張忠謀		發言人：何麗梅	
職稱：資深副總經理暨財務長		代理發言人：孫又文		職稱：企業訊息處處長	
公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司		電話：(02) 2361-0262		網址：http://www.kgi.com.tw	
地址：台北市中正區博愛路 35 號 4 樓					
公司債承銷機構：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
最近年度簽證會計師：林鴻鵬、黃樹傑		電話：(02)2545-9988		網址：	
現任簽證會計師：高逸欣、黃鴻文				http://www.deloitte.com.tw	
地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓					
複核律師：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司		電話：(02) 8722-5800		網址：	
				http://www.taiwanratings.com	
地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓					
最近一次經信用評等日期：		評等標的：		評等結果：twAAA	
102 年 7 月 15 日		本公司一〇二年度第三期無擔保普通公司債			
董事選任日期：101年6月，任期：3年			監察人選任日期：不適用		
全體董事持股比例：7.12%（102 年 3 月 31 日）			全體監察人持股比率：不適用		
董事、監察人及持股超過 10%股東及其持股比例：(102 年 3 月 31 日)					
職 稱	姓 名	持 股 比 例	備 註		
董事長	張忠謀	0.47%			
副董事長	曾繁城	0.13%			
董事	李鍾熙	6.38%	行政院國家發展基金管理會代表人		
董事	蔡力行	0.13%			
獨立董事	彼得·邦菲爵士	-			
獨立董事	施振榮	0.01%			
獨立董事	湯馬斯·延吉布斯	-			
獨立董事	鄒至莊	-			
獨立董事	陳國慈	-			
工廠地址：	(二廠、五廠)	新竹科學工業園區園區三路121號	電話：(03)5636688		
	(三廠)	新竹科學工業園區研新一路9號	電話：(03)5636688		
	(六廠)	台南科學工業園區南科北路1號	電話：(06)5056688		
	(八廠)	新竹科學工業園區力行路25號	電話：(03)5636688		
	(十二廠)	新竹科學工業園區力行六路8號	電話：(03)5636688		
	(十四廠)	台南科學工業園區南科北路1號之1	電話：(06)5056688		
	(十五廠)	台中市大雅區科雅六路1號	電話：(04)27026688		
主要產品：積體電路及其他晶圓半導體裝置之製造與銷售			市場結構：內銷 13.6% 外銷 86.4%		參閱本文之頁次
					25 頁
風 險 事 項 請參閱本公開說明書之公司概況二					4 頁

去 (101) 年度(註)	營業收入：新台幣506,249佰萬元 買賣業：- 佰萬元 加工業：- 佰萬元 製造業：新台幣506,249佰萬元 稅前純益：新台幣 181,554 佰萬元	每股盈餘：6.41 元(稅後基本)	53 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	一〇二年度第三期無擔保普通公司債；發行金額不超過新台幣壹佰貳拾伍億元整		
發行條件	見公開說明書封面		
募集資金用途及預計產生效益概述	購置機器設備，效益請參閱公開說明書第 44 頁		
本次公開說明書刊印日期：102 年 7 月 17 日		刊印目的：發行一〇二年度第三期無擔保普通公司債	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄			

(註)本公開說明書內民國101年12月31日(含)以前之財務報表及相關財務資訊係依據中華民國財務會計準則所編制，民國102年1月1日(含)以後之財務報表及相關財務資訊係依據中華民國金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則所編制。

台灣積體電路製造股份有限公司
公開說明書目錄

目錄

壹、 公司概况.....	1
一、 公司簡介.....	1
(一) 設立日期.....	1
(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話.....	1
(三) 公司沿革.....	2
二、 風險事項.....	4
(一) 風險因素.....	4
(二) 訴訟或非訟事件.....	10
(三) 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事.....	11
(四) 其他重要事項.....	11
三、 公司組織.....	12
(一) 關係企業圖.....	12
(二) 董事及監察人.....	15
四、 資本及股份.....	21
(一) 股本形成經過.....	21
(二) 主要股東名單.....	23
(三) 最近兩年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形.....	23
(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料.....	23
(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞.....	24
貳、 營運概況.....	25
一、 公司經營.....	25
(一) 業務內容.....	25
(二) 市場及產銷概況.....	34
二、 轉投資事業.....	38
(一) 轉投資事業概況.....	38
(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權情形.....	39

三、 重要契約.....	40
參、 發行計畫及執行情形.....	41
一、 本次發行公司債資金運用計畫分析.....	41
(一) 資金來源.....	41
(二) 本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款 項之籌集計畫與保管方法.....	41
(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來 一年每股盈餘稀釋影響.....	43
(四) 本次發行價格之訂定方式：依票面金額十足發行。.....	44
(五) 資金運用概算及可能產生之效益.....	44
二、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。.....	45
三、 本次併購發行新股應記載事項：不適用。.....	45
肆、 財務概況.....	46
一、 財務分析.....	46
(一) 財務分析 - 國際財務報導準則.....	46
(二) 財務分析 - 中華民國財務會計準則（台積公司及子公司合併財務報表）.....	47
(三) 財務分析 - 中華民國財務會計準則（台積公司財務報表）.....	49
二、 財務報告應記載事項.....	50
(一) 最近二年度財務報告及會計師查核報告(申報募集發行有價證券已逾所應公告申報 各季財務報告期限，加列最近一季財務報告).....	50
(二) 最近二年度經會計師查核簽證之年度個體財務報告.....	50
(三) 申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報告及個體財務報告.....	50
三、 財務概況應記載事項.....	51
四、 財務狀況及經營結果檢討分析.....	51
(一) 財務狀況.....	51
1. (台積公司財務報表).....	51
2. (台積公司及子公司財務報表).....	51
(二) 經營結果.....	52
1. (台積公司財務報表).....	52
2. (台積公司及子公司財務報表).....	53
(三) 現金流量.....	54
1. (台積公司財務報表).....	54
2. (台積公司及子公司財務報表).....	54

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	54
(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃.....	55
(六) 其他重要事項	55
伍、 特別記載事項	55
一、 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形	55
二、 委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告	55
三、 證券承銷商評估總結意見	55
四、 律師法律意見書	55
五、 由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	55
六、 本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項.....	55
七、 最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者	55
八、 公司治理運作情形.....	55
(一) 董事會運作情形	56
(二) 審計委員會運作情形.....	58
(一) 薪酬委員會運作情形.....	59
(二) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因.....	62
(三) 履行社會責任情形.....	65
(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施.....	73
(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式.....	77
(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總.....	77
(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊	78

壹、公司概況

一、公司簡介

(一) 設立日期

民國76年2月21日

(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

公司總部及晶圓十二廠

300-78新竹科學工業園區力行六路8號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5637000

晶圓二廠、五廠

300-77新竹科學工業園區園區三路121號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781546

晶圓三廠

300-77新竹科學工業園區研新一路9號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781548

晶圓六廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號

電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5052057

晶圓八廠

300-78新竹科學工業園區力行路25號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5662051

晶圓十四廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號之1

電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5051262

晶圓十五廠

428-81台中市大雅區科雅六路1號

電話：886-4-27026688 傳真：886-4-25607548

北美子公司

2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.

電話：1-408-3828000 傳真：1-408-3828008

歐洲子公司

World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV Amsterdam

The Netherlands

電話：31-20-3059900 傳真：31-20-3059911

日本子公司

21F, Queen' s Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku

Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan

電話：81-45-6820670 傳真：81-45-6820673

台積電（中國）有限公司

上海市松江區文翔路4000號

郵政編碼：201616

電話：86-21-57768000 傳真：86-21-57762525

台積電韓國有限會社

15F, AnnJay Tower, 718-2, Yeoksam-dong, Gangnam-gu
Seoul 135-080, Korea

電話：82-2-20511688 傳真：82-2-20511669

印度聯絡處

1st Floor, Pine Valley, Embassy Golf-Links Business Park
Bangalore-560071, India

電話：1-408-3827960 傳真：1-408-382-8008

加拿大子公司

535 Legget Dr, Suite 600, Kanata, ON K2K 3B8, Canada

電話：613-576-1990 傳真：613-576-1999

(三) 公司沿革

台積公司成立於民國七十六年二月二十一日，總部設立於台灣新竹科學工業園區，是全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。

台積公司的客戶遍布全球，為客戶生產的晶片被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。民國一百零一年，台積公司所擁有及管理的產能達到1,509萬片八吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有三座先進的十二吋晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有二家海外子公司WaferTech(美國)、台積電(中國)有限公司及其他轉投資公司之八吋晶圓廠產能支援。台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。

1、歷史沿革

民國七十六年公司初創之時，向工研院租用一六吋晶圓廠，成為當初台積公司晶圓一廠；民國七十七年，台積公司於美國成立北美子公司；民國七十九年，台積公司晶圓二廠落成啟用；民國八十二年，於荷蘭成立歐洲子公司；民國八十三年，台積公司股票於台灣證券交易所掛牌上市；民國八十四年，首座八吋晶圓廠一晶圓三廠落成啟用，同年於美國設立Wafertech公司及晶圓廠；民國八十六年，美國存託憑證於紐約證券交易所掛牌上市，同年晶圓四廠、五廠落成啟用，亦設立日本子公司；民國八十七年，於新加坡與荷商飛利浦公司(Philips)合資設立SSMC公司與晶圓廠；民國八十九年，首座位於台南科學園區的晶圓六廠落成啟用；民國九十年，完成合併德基公司並命名為晶圓七廠、完成合併世大公司並命名為晶圓八廠，同年首座十二吋晶圓廠一晶圓十二廠落成啟用；民國九十一年，晶圓三、四廠重組並統稱為晶圓三廠；民國九十二年，於上海設立上海子公司及晶圓廠；民國九十三年，第二座十二吋晶圓廠一晶圓十四廠於南科落成啟用，同年上海晶圓廠亦落成啟用。民國一百年，第三座十二吋晶圓廠一晶圓十五廠於中科落成啟用。截至公開說明書刊印日止，台積公司之三座十二吋晶圓廠均持續擴建中。

民國九十九年，台積公司投資固態照明及太陽能相關的二項新事業。民國一百年六月，台積公司股東會決議，核准將太陽能業務及固態照明業務分別分割讓與兩家新設且由本公司百分之百持有之台積太陽能股份有限公司及台積固態照明股份有限公司，並以民國一百年八月一日為分割基準日。截至民國一〇二年三月三十一日，本公司分別持有台積太陽能股份有限公

司 99%股份，以及台積固態照明股份有限公司 95%股份。

2、最近五年度及截至公開說明書刊印日止重要廠房之擴充及新技術之推出

最近五年台積公司持續擴建位於新竹的晶圓十二廠及位於台南的晶圓十四廠的廠房及產能。台積公司座落於中部科學園區的第三座十二吋超大晶圓廠—晶圓十五廠，也於民國一百年第二季開始進行裝機，並持續擴建中。

民國九十七年，台積公司成為全球第一家將 40 奈米先進製程技術導入量產的專業積體電路製造服務業者。同時，領先專業積體電路製造服務領域，成功示範第一個能同時支援類比及數位積體電路的 32/28 奈米高介電層／金屬開製程技術。此外，台積公司持續領先專業積體電路製造服務領域推出高效能（N40G）和低耗電（N40LP）的 40 奈米製程技術，並通過產品驗證。

民國九十八年，繼先前宣佈 28 奈米全世代高效能高介電層／金屬開（簡稱 28HP）以及低耗電氮氧化矽（簡稱 28LP）製程技術的推出時程計劃之後，台積公司新增 28 奈米低耗電高介電層／金屬開（簡稱 28HPL）製程，提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。民國九十八年十二月，台積公司於中國大陸宣佈汽車業界第一個車用電子製程驗證規格（Automotive Process Qualification Specification）及符合車用電子等級的半導體製造套裝服務（Automotive Service Package）。台積公司位於台灣的多個晶圓廠以及在上海的晶圓十廠皆已具備生產車用電子等級的積體電路產品的能力。

民國九十九年，台積公司保有持續不斷的改善及開發動能，在 28LP、28HP、28HPL 技術上刷新 64Mb 靜態隨機存取記憶體良率紀錄，並且順利達成 64Mb 靜態隨機存取記憶體良率及可靠度目標。此外，28 奈米低耗電技術（28LP）率先在民國九十九年九月完成製程驗證，讓台積公司成為半導體及專業積體電路製造服務產業第一家能夠提供 28 奈米技術試產的公司。

民國一百年，台積公司持續提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。同時，亦在民國一百年年底進入 20 奈米製程投片生產。除了一般邏輯製程技術，台積公司也針對客戶需求提供廣泛的製程技術，例如：嵌入式非揮發性記憶體（Embedded Non-volatile Memory）製程、嵌入式動態隨機存取記憶體（Embedded DRAM）製程、混合訊號／射頻（Mixed Signal/RF）製程、高壓（High Voltage）製程、互補金屬氧化物半導體影像感測器（CMOS Image Sensor）、彩色濾光片（Color Filter）、微機電系統（MEMS）、矽鍺（Silicon Germanium）製程以及符合車用電子等級的半導體製造套裝服務（Automotive Service Packages）等。

民國一百零一年及截至公開說明書刊印日止，台積公司量產 28 奈米全世代製程技術，包括支援高效能表現的 28HP 以及 28 奈米高效能行動運算製程技術（簡稱 28HPM）外，亦提供支援低耗電表現的 28LP 製程技術及 28HPL 技術，提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。此外，20 奈米製程客戶亦開始投片生產。

3、最近五年度及截至公開說明書刊印日止經營權之改變

民國九十八年六月十二日，張忠謀董事長重新兼任總執行長一職。

4、最近五年度及截至公開說明書刊印日止董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換

民國九十六年三月九日台積公司和飛利浦公司共同宣佈雙方就飛利浦公司逐步有秩序地釋出台積公司持股事宜，規劃出多階段釋股方案，包括：飛利浦公司將在台灣證券集中交易市場透過一次或多次的鉅額交易釋出股份、將台積普通股轉換發行美國存託憑證出售、並於民國九十六年至九十九年間，於台積公司執行公司股份買回時參與應賣。

此釋股方案的第一階段於民國九十六年三月十二日執行完成，飛利浦公司於台灣證券交易市場透過鉅額交易之方式，將市值約 17 億 5,000 萬美元的台積公司普通股股份售予國內數家法人機構。第二階段於民國九十六年五月十八日執行完成，飛利浦公司將所持有市值約 25 億 6,000 萬美元之本公司普通股，轉換發行為美國存託憑證出售。

第三階段於民國九十六年十一月十四日至民國九十六年十二月三十一日執行完成，台積公司總計在集中交易市場買回 8 億股之普通股股票，總金額約美金 15 億元，隨後並將買回之股份辦理註銷。飛利浦公司亦於台積公司執行買回公司股份期間，同時在集中交易市場上出售 8 億股台積公司普通股股票。

第四階段於民國九十七年五月十四日至六月三十日之期間及民國九十七年八月十四日執行完畢，飛利浦公司透過集中市場出售及鉅額交易的方式將剩餘的 5.1% 持股售出，完成釋股。

二、風險事項

(一) 風險因素

1、利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

■ 利率變動

台積公司的利率風險，主要來自為支應營運活動所產生之負債。為降低利率風險，台積公司主要以營運現金收入，及發行固定利率的長期負債來滿足資金上的需求。在資產方面，台積公司將大部分現金存在短天期定存，並配置其投資部位於高流動性之短期固定收益債券，以保障本金安全及維持流動性。

■ 匯率變動

台積公司超過一半以上的資本支出及製造成本以非新台幣貨幣，如美元、日圓及歐元支付。此外，台積公司超過90%之營收來自美元及其他貨幣。因此，任何顯著而不利的國際匯率變動對台積公司財務狀況均可能會有不利影響，例如，民國九十九年九月一日至民國九十九年十二月三十一日期間，新台幣對美元升值達8.9%，即對台積公司帶來負面的影響。根據台積公司民國一百零一年的營運成果，新台幣對美元每升值1%，即會使台積公司的營業利益率下降0.4個百分點。台積公司主要使用外幣短期借款，換匯換利交易及遠期外匯合約，從事外匯避險。

此外，新台幣對美元的匯率變化也可能會對台積公司普通股股價轉換成以美元表示後之數值、美國存託憑證之股價及現金股利轉換成美元後之數值產生影響。

■ 通貨膨脹及通貨緊縮

當市場對於通貨膨脹及通貨緊縮的預期心理突然產生變化時，往往影響全球經濟甚鉅。舉例來說，民國九十七年至九十八年的金融風暴及其後的歐債危機所導致的結構性改變（如全球各國主要央行採取高度寬鬆貨幣政策），便可能改變了市場對通貨膨脹或通貨緊縮的預期。不論是高度的通貨膨脹或是通貨緊縮，都將減低市場效率、干擾儲蓄及投資決策，對於總體及個體經濟產生不利的影響。這些波動可能對台積公司的營運成本帶來負面影響；不僅如此，對於必須在此經濟不確定下進行採購規劃的台積公司客戶，其營運亦可能受到不利影響。因此，對台積公司之產品與服務的需求可能隨著市場對於通貨膨脹或通貨緊縮的預期而產生變化。

2、從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

自民國一百零一年初至公開說明書刊印日為止，台積公司並未從事高風險／高槓桿的財務投資。本公司與海外子公司及本公司之子公司間之背書保證與資金貸與均符合相關法令，並依相關規定辦理。

台積公司所從事的衍生性金融商品交易均是以避險為目的，而不是交易或投機性之操作。有關交易細節，請參考本公司民國一百零一年年報及民國一百零二年第一季度財務報告。

以交易為目的及備供出售的金融投資，其公允價值會因市場狀況等因素改變而與取得成本不同，進而影響相關的報酬率。

為了控管財務交易風險，台積公司已依據證期局的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」。

3、未來研發計畫及預計投入之研發費用

基於民國一百零一年在先進技術上締造的優異成果，台積公司未來將繼續擴展其研發投資。台積公司計劃進一步強化前瞻性技術研究，繼續研發新的電晶體及製程技術，例如三維（3D）結構、應變層互補金屬氧化半導體（Strained-layer CMOS）、高載子移動率材料以及創新的三維積體電路元件。目前，奈米級互補金屬氧化半導體電晶體的基本物理和其特性的研究是台積公司的研發重點之一，以作為了解和引導未來先進製程元件的設計方向。台積公司已經運用相關的研究結果，確保我們繼續在 28 奈米和 20 奈米製程技術世代的領導地位，並將此領先優勢延續到 10 奈米和 7 奈米製程。台積公司的目標之一，是藉由內部的創新以及與產業領導者和學術界共同合作來延續摩爾定律，我們尋求具有成本效益的技術和製造解決方案。

台積公司將繼續與國際聯盟組織及光學微影設備供應商合作，確保能夠及時進行 193 奈米波長高數值孔隙（High-NA）掃描機技術、極紫外光微影技術和多重平行電子束直寫技術的開發。這些技術在台積公司 10 奈米、7 奈米及更先進製程技術的製程研發上具有與日俱增的重要性。

台積公司將繼續與光罩寫入器及檢測設備供應商合作，共同開發先進的光罩製造技術，以維持在光罩品質及交期週期上的領導地位，並滿足研發、

產品試製及生產的高標準要求。

台積公司擁有優異、高度專注的研發團隊，加上對創新的承諾，我們深信一定能提供客戶最具競爭優勢且最具成本效益的系統單晶片製程技術，從而支援台積公司的營運成長及獲利能力。

台積公司未來主要研發計劃摘要

計劃名稱	計劃內容	預計生產時程
16 奈米邏輯技術平台與應用	同時支援數位及類比產品應用的下一代製程技術	民國一〇二年
10 奈米邏輯技術平台與應用	同時支援數位及類比產品應用的前瞻性製程技術	民國一〇四年
三維積體電路	因應系統級封裝技術，開發更具成本效益以及更具尺寸、效能優勢的解決方案	民國一〇二年至民國一〇三年
下一世代的微影技術	發展極紫外光及多重電子束技術以延伸摩爾定律	民國一〇三年至民國一〇五年
長期研發	特殊系統單晶片技術，包括新興非揮發性記憶體、微機電、射頻、類比晶片和 10 奈米電晶體	民國一〇二年至民國一〇四年
以上計劃之研發經費約佔民國一〇二年全年營收之 8%。		

4、國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

台積公司經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策與法令，並訂定相關風險管理程序。民國一百零一年及至公開說明書刊印日止，與本公司營運有關之重要法令變動如下：

金融監督管理委員會要求上市公司自民國一百零二年一月一日起，須依「證券發行人財務報告編製準則」及該會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下簡稱 IFRSs）編製合併財務報告。台積公司已於民國九十八年成立專案小組負責推動，訂定採用 IFRSs 之因應計劃暨預計執行進度，並定期將執行情形提報公司董事會控管。採用 IFRSs 的潛在影響可能包括改變部分交易的會計處理以及財務報告的表達方式，台積公司將持續注意 IFRSs 之增修及國內相關配套法令調整對公司之影響。台積公司民國一百零一年期中及年度合併財務報告已依規定說明採用 IFRSs 計劃之重要內容及執行情形，以及 IFRSs 與現行會計政策之重大差異與影響。

民國一百年一月修訂公布之全民健康保險法，增加雇主及員工需各另負擔 2% 費率之補充保費之規定，施行日為民國一百零二年一月一日。台積公司未來發給員工分紅及非經常性給付之獎金時，需另負擔 2% 費率的補充保費。台積公司將持續參與健保局及相關單位舉辦之座談會及說明會，以了解相關施行細節並做好各項相關財務控管。

民國一百零一年八月修訂公布之所得基本稅額條例（即最低稅負）規定，

自民國一百零二年一月一日起，營利事業基本稅額徵收率由 10%調高至 12%。由於此法令變動再加上各種適用於台積電公司之租稅獎勵及免稅的改變，台積電公司預估民國一百零二年有效稅率將由民國一百零一年的 8.7%提高至 14.0%，此將影響台積電公司民國一百零二年之純益。台積電公司已評估此項法律修訂對於財務報表之影響，並將遵循法令規定辦理。

民國九十九年五月修訂公布之個人資料保護法（即原電腦處理個人資料保護法），已於民國一百零一年十月一日施行部分條文，其適用範圍擴及所有蒐集、處理、利用個人資料的自然人、法人或團體；受保護之個人資料型態包括電磁紀錄或書面資料，並須有適當安全措施防止個人資料受侵害。台積電公司一向有妥適處理及保管個人資料之措施，未來亦將持續依相關法令規定進行對個人資料之保護及管理。

此外，立法機關正在研議環保相關法令（例如溫室氣體減量法、能源稅條例）及勞工安全衛生法等。溫室氣體減量法雖尚未經立法通過，本公司自民國八十九年已經開始執行許多節能減排相關措施；至於能源稅條例，由於法令內容尚不確定，目前無法判斷可能的具體影響，但有可能會增加公司營運成本。另勞工安全衛生法將修正並改名為「職業安全衛生法」，該草案將加強雇主對勞工安全衛生的身心保護，台積電公司一向有妥適的安全衛生管理機制及保護措施，未來亦將持續依相關法令規定進行對勞工安全衛生的管理及保護。

除前述法令外，其他相關政策及法令的變化對台積電公司的財務及業務尚不會造成重大影響。

5、科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

■ 產業發展

電子產業與半導體市場一向深受景氣循環、產品需求快速變化的重大影響，這樣的市場特性也對台積電公司的積體電路製造服務業產生影響。台積電公司的多數客戶均隸屬於上述產業，因此台積電公司的營收與獲利，也受到客戶下單波動的影響。

電子產業與半導體產業不時面臨重大且持續不景氣及產能過剩的情況，台積電公司目前及未來業務需求皆來自這些產業客戶，上述產業不景氣及產能過剩的情況將導致整體半導體製造服務業及台積電公司的業務需求下降，如果台積電公司不能透過降低成本或其他措施來有效抵銷需求下降的影響，營收、利潤與獲利率均會受到衝擊。此外，由於產品與服務在技術上的複雜度持續增加，全球經濟環境充滿不確定性，台積電公司必須提高客戶銷貨退回與折讓的準備金，避免對營運結果產生不利影響。

■ 技術變革

因應半導體產業與其技術的不斷變化，台積電公司的競爭利器為持續開發先進製程與衍生技術，以製造功能更多的產品。倘若台積電公司無法洞察技術的改變並迅速發展創新技術，或遇到競爭者無預期地取得更先進技術，台積電公司便可能無法以具競爭力的條件贏得積體電路製造服務的訂單。此外，台積電公司的客戶已大幅縮短其產品或服務上市的時間，如果台積電公司無法達到較短產品上市時間的要求，可能將面臨失去這些客戶

的風險，同時，我們需要堅強的研發實力方能應付這些挑戰，如果台積公司無法開發新技術以滿足客戶需求，營收將可能大幅衰退。雖然台積公司致力維持研發優勢，但若不能在技術或製程上繼續領先，或是未能取得由他人所發展的技術或製程之移轉或授權，台積公司的競爭力將有所影響。

6、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

台積公司秉持「誠信正直、承諾、創新、客戶信任」的核心價值，以優異的營運績效與完善的公司治理，善盡企業公民責任，追求「永續發展、公平正義、安居樂業社會」的共好願景，在經濟、環境與社會各面向不斷展現創新的永續實力，早已在國內外建立了良好的企業形象。

民國一百零一年，台積公司的企業形象因各式獎項的肯定而更進一步強化。除了再次榮獲道瓊永續指數全球半導體類別領導者，並連續十二年獲選為道瓊永續指數的組成企業外，同時並獲得包括行政院環保署全國企業環保獎、節能減碳行動標章、科學工業園區低碳企業績優獎、天下雜誌之全國最佳聲望標竿企業第一名、天下雜誌企業公民獎、遠見雜誌「企業社會責任獎」環境保護組一首獎、中華徵信所「台灣十大幸福企業」第一名、電子工程專輯(EETimes)中國 IC 設計公司成就獎／最受認可晶圓代工企業、Euromoney 亞洲科技業最佳管理公司、亞洲公司治理協會(Asian Corporate Governance Association) 亞太地區公司治理排名第一以及 FinanceAsia 台灣及香港地區最佳管理公司、台灣地區最佳公司治理與最佳企業社會責任等種種肯定。

此外，公司設有品牌管理、客戶服務、公共關係、員工關係、投資人關係、風險管理、廠區工安環保、內部控制及文教基金會等各專責部門，統合全公司力量，力求在既有良好的企業形象基礎上再上層樓。同時針對可能影響公司形象的潛在危機，如天災、火災、職災、停電、缺水、人員傷亡等意外事件建立緊急應變指揮組織系統，相關部門定期演練並不斷改善緊急應變的運作程序，一旦危機發生，除了立即啟動緊急通報程序，期能免除或降低意外事件對人員生命、周遭環境、公司財產及生產中斷之損失外，並將第一時間通知公關部，建立各級利害關係人的溝通準則，並由公關部統一對外界發言，以維持公司形象於不墜。

7、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

自民國一百零一年初至公開說明書刊印日為止，台積公司並未進行任何併購。

8、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

台積公司定期預測長期的市場需求，以了解總體經濟環境與台積公司所提供之產品與服務的市場狀況。基於上述預測，台積公司依照市場需求來調控其總產能。然因市場狀況可能變化劇烈且無法預期，因此市場需求隨時可能有顯著的變化。另外，由於需求變化，本公司的部分生產線或機台可能會被暫時停止，亦可能無法即時擴產。

為滿足客戶需求，台積公司持續擴充在新竹科學工業園區、南部科學工業園區以及中部科學工業園區十二吋晶圓廠的產能，其每月總產能已從民國一百年十二月三十一日的 29 萬 100 片十二吋晶圓增加至民國一百零一年十

二月三十一日的 36 萬 6,800 片十二吋晶圓。總體來說，台積公司在民國一百零一年度之產能較前一年度增加約 187 萬片八吋晶圓約當量，全年平均整體晶圓出貨產能利用率為 91%。產能的擴充及生產技術的提升會增加營運成本，例如需要添購機器設備、人事的訓練或擴充。如果本公司無法相對增加營收來支付前述公司成本的增加，這將對本公司的財務造成負面的影響。

台積公司針對未來市場需求，建立一套預測和評量系統，來評估擴充或減少產能的效益，而截至公開說明書刊印日止，台積公司的產能擴充效益尚符合台積公司預期。

9、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

■ 採購集中的風險

➤ 原物料

台積公司需要適時取得生產晶圓所需的原物料，例如矽晶片、製程用氣體、化學原料、光阻等。過去曾發生部分供應商或半導體業的原物料短缺，導致暫時性的價格調整和交期延誤。另外，由於台積公司採購的原物料中，有些是由單一廠商所供應，在未及時找到替代貨源的狀況下，可能出現供貨無法滿足需求的風險。如果台積公司無法適時取得所需的原物料，或原物料價格顯著上漲，而增加的成本無法轉嫁給客戶，台積公司的營收和獲利將因此可能下滑。

為降低供應鏈風險與有效地管理成本，台積公司除致力開發新供應商外，亦鼓勵供應商推動分散生產廠區，並將生產廠區自高成本地區移至台灣，以提高成本競爭力，這是供應商與台積公司的雙贏。此外，台積公司亦將持續改善庫存計劃及每日庫存監控系統，以確保供應鏈維持合理之庫存水位與供應價格。

➤ 設備

設備的市場經常呈現供應商供給有限，且交貨時間冗長的現象，因此台積公司的營運成長以及產能的持續擴充，皆仰賴於能否從有限的供應商中得到足量的設備及相關服務。半導體相關產業中，機台的採購前置期可能長達六個月或更久。為了減低風險，台積公司與廠商共同討論訂定各種商業模式與風險管理應變措施，以縮短機台採購前置期，並提供供應商機台需求預測，以利供應商預先安排機台的生產計劃；同時台積公司亦採購二手機台，並將持續尋找取得相關二手機台的機會。除此之外，著眼次世代微影技術日趨複雜，倘若技術無法及時發展將延遲設備與相關零組件的取得，也會影響台積公司對商機的快速掌握，並可能增加設備與零件的採購價格。台積公司如果不能以合理價格即時取得到所需設備以滿足客戶訂單，將可能對財務及營運造成負面影響。

■ 銷售集中之可能風險

近年來，台積公司的客戶群與客戶的業務性質出現顯著變化。儘管台積公司在全球各地擁有數百位客戶，但來自前十大客戶的淨銷貨收入總和，在民國一百年與一百零一年，約佔公司當年淨銷貨收入的56%與59%，其中最大客戶則各約佔14%與17%。客戶集中度的產生，部分來自電子產業

的結構性改變，轉由行動裝置及其內容相關的應用程式與軟體所主宰的局面。目前僅有少數客戶成功利用這個新的商業模式；而為了因應此一趨勢，台積電也觀察到客戶業務模式的轉變。例如，更多的系統公司改變營運方式，以期產品及服務能在多變的終端市場脫穎而出。倘若其中一位或多位主要客戶，因持續的競爭壓力、產業整併、設計或委外製造的策略或做法改變、客戶或經銷商存貨調節時間的影響、重要客戶經營模式的改變，而停止或顯著縮減採購規模，將可能對台積電的營運與財務表現產生負面影響。

10、董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司影響、風險及因應措施：

台積電現有股東所持有股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。台積電現有的股東可能會不定時地大量出售本公司之普通股或美國存託憑證（ADS）。例如：台積電主要股東之一的行政院國家發展基金管理會，自民國八十六年起至民國九十四年間，即以美國存託憑證形式多次出售台積電股份。截至民國一〇二年三月三十一日，行政院國家發展基金管理會仍持有本公司約 6.4% 的股權。

截至本公開說明書刊印日為止，台積電無持股超過 10% 之股東。

11、經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施

無。

12、其他重要風險及因應措施：

無。

（二）訴訟或非訟事件

台積電有時會接獲第三人的通知，主張台積電所研發或由台積電所提供給同屬半導體產業之客戶使用的技術、設計或製程，有侵害他人專利或其他智財權之虞。某些情況下，這些爭議可能會導致雙方間的訴訟（台積電或為原告或為被告），有時，支付和解金亦為雙方解決爭議的方式之一。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少已造成台積電訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。

Keranos 公司於民國九十九年六月，在美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。民國九十九年十一月，台積電、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理，台積電尚無法預知上述訟案之訴訟結果。

Ziptronix 公司於民國九十九年十二月，在美國北加州地方法院對台積電、TSMC North America 以及另一公司，提出對若干美國專利之專利權侵害訴訟。本公司尚無法預知訴訟結果。

除前述訴訟案件之外，台積電在最近兩年度及截至公開說明書刊印日止並無涉入其他重大訴訟案件。

(三) 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事

無。

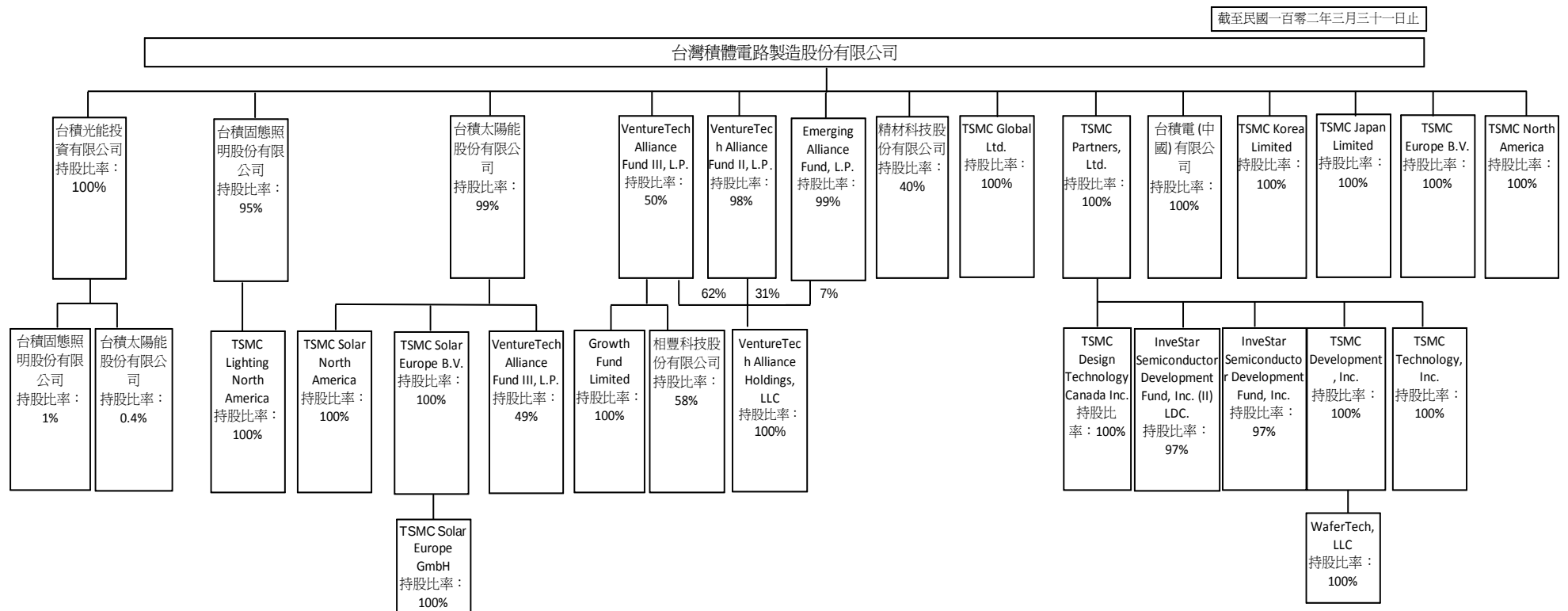
(四) 其他重要事項

無。

三、公司組織

(一) 關係企業圖

關係企業組織圖



與關係企業之關係及相互持股情形

截至民國一〇二年三月三十一日止

單位：新台幣仟元

關係企業名稱	與本公司關係	本公司投資情形			投資本公司情形：無		
		持股比例	股數（仟股）	原始投資金額 （外幣為仟元）	持股比例	股數（仟股）	原始投資金額
TSMC Global Ltd.(TSMC Global)	子公司	100	1	\$42,327,245	-	-	-
TSMC Partners, Ltd.(TSMC Partners)	子公司	100	988,268	31,456,130	-	-	-
台積電(中國)有限公司(台積電中國子公司)	子公司	100	-	18,939,667	-	-	-
TSMC North America	子公司	100	11,000	333,718	-	-	-
VentureTech Alliance Fund III, L.P. (VTAF III)	子公司	99	-	3,709,150	-	-	-
精材科技股份有限公司(精材公司)	子公司	40	94,950	1,357,890	-	-	-
VentureTech Alliance Fund II, L.P.(VTAF II)	子公司	98	-	710,334	-	-	-
Emerging Alliance Fund, L.P.(Emerging Alliance)	子公司	99	-	852,258	-	-	-
TSMC Europe B.V.(TSMC Europe)	子公司	100	-	15,749	-	-	-
TSMC Japan Limited (TSMC Japan)	子公司	100	6	83,760	-	-	-
TSMC Korea Limited (TSMC Korea)	子公司	100	80	13,656	-	-	-
台積太陽能股份有限公司	子公司	99	1,122,404	11,224,045	-	-	-
台積固態照明股份有限公司	子公司	96	435,072	4,339,376	-	-	-

台積光能投資有限公司(台積光能公司)	子公司	100	-	100,000	-	-	-
TSMC Solar Europe B.V. (TSMC Solar Europe)	子公司	99	-	504,107	-	-	-
TSMC Solar North America, Inc. (TSMC Solar NA)	子公司	99	1	205,772	-	-	-
TSMC Lighting North America, Inc. (TSMC Lighting NA)	子公司	96	1	3,133	-	-	-
TSMC Development Inc. (TSMC Development)	子公司	100	-	USD 0.001	-	-	-
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (ISDF)	子公司	97	787	USD 787	-	-	-
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (II) LDC. (ISDF II)	子公司	97	14,153	USD 14,153	-	-	-
TSMC Technology, Inc. (TSMC Technology)	子公司	100	-	USD 0.001	-	-	-
TSMC Design Technology Canada Inc. (TSMC Canada)	子公司	100	2,300	USD 2,300	-	-	-
相豐科技股份有限公司(相豐公司)	子公司	58	15,643	USD 5,212	-	-	-
Growth Fund Limited (Growth Fund)	子公司	100	-	USD 1,830	-	-	-
VentureTech Alliance Holdings, LLC (VTA Holdings)	子公司	100	-	-	-	-	-
TSMC Solar Europe GmbH	子公司	100	-	EUR 12,400	-	-	-
WaferTech, LLC (WaferTech)	子公司	100	293,637	USD 280,000	-	-	-

(二) 董事及監察人

1、董事會成員簡介

截至民國一〇二年三月三十一日止

職稱 姓名	選(就) 任日期 (註一)	任期至 (註一)	初次選任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註二)		配偶、未成年子女 現在持有股份 (註二)		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率		
董事長 張忠謀	101/6/12	104/6/11	75/12/10	123,137,914	0.48%	123,137,914	0.47%	135,217	0.00%	美國麻省理工學院機械工程學士及碩士 美國史丹福大學電機工程博士 前美國德州儀器公司總公司集團副總裁 前美國通用儀器公司總裁暨營運長 前工業技術研究院董事長 美國麻省理工學院終身榮譽理事 美國國家工程學院院士	台積公司執行長
副董事長 曾繁城	101/6/12	104/6/11	86/5/13	34,662,675	0.13%	34,662,675	0.13%	132,855	0.00%	國立成功大學電機工程博士 前世界先進積體電路(股)公司總經理 前台積公司總經理 前台積公司副總執行長 財團法人台積電文教基金會董事長	台積電(中國)有限公司董事長 創意電子(股)公司董事長 台積太陽能(股)公司董事 台積固態照明(股)公司董事 世界先進積體電路(股)公司董事 太極影音科技(股)公司董事 宏碁(股)公司獨立董事、薪酬委員會 委員及「財務報表及內控查核委員會」 主席
董事 行政院國家發 展基金管理會 代表人：李鍾熙 (註三)	101/6/12	104/6/11	75/12/10 99/08/06 (註四)	1,653,709,980	6.38%	1,653,709,980	6.38%	-	-	美國伊利諾理工學院化學工程博士 美國芝加哥大學企業管理碩士 美國哈佛大學進階企管班結業 前美國阿岡國家實驗室計劃主持人 前美國強生美西公司資深經理 前工業技術研究院院長 財團法人生物技術開發中心董事長 中華民國生物產業發展協會理事長	福聚太陽能(股)公司獨立董事 臻鼎科技控股(股)公司獨立董事 遠東新世紀(股)公司獨立董事

董事 蔡力行	101/6/12	104/6/11	92/6/3	33,665,046	0.13%	33,207,046	0.13%	-	-	美國康乃爾大學材料工程博士 前世界先進積體電路（股）公司總經理 前台積公司全球行銷暨業務執行副總經理 前台積公司營運長 前台積公司總經理暨總執行長 前台積公司新事業總經理 中華民國行政院政務顧問	台積太陽能（股）公司董事長暨執行長 台積固態照明（股）公司董事長暨執行長 台積公司所屬子公司董事 台積公司所屬子公司總經理 茂迪（股）公司董事
獨立董事 彼得·邦菲 爵士	101/6/12	104/6/11	91/5/7	-	-	-	-	-	-	- 英國Loughborough大學工程榮譽學位 倫敦皇家工程學院會員 Chair of Council and Senior Pro-Chancellor, Loughborough University, UK 前ICL Plc董事長暨執行長 前英國電信公司執行長及Executive Committee主席 前英國品質基金會副總裁	荷蘭恩智浦半導體公司董事長 新力公司董事（日本） L.M. Ericsson董事（瑞典） Mentor Graphics Corporation Inc. 董事（美國奧勒岡） The Longreach Group諮詢委員會委員 新力公司諮詢委員會委員 New Venture Partners LLP諮詢委員會 委員 Apax Partners LLP顧問 Board Mentor, CMi Rothschild 資深顧問（英國倫敦）
獨立董事 施振榮	101/6/12	104/6/11	89/4/14	1,480,286	0.01%	1,480,286	0.01%	16,116	0.00%	國立交通大學電子工程學士及碩士 國立交通大學名譽工學博士 香港理工大學榮譽科技博士 英國威爾斯大學榮譽院士 美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士 宏碁集團創辦人暨榮譽董事長 前宏碁集團董事長暨執行長 財團法人國家文化藝術基金會董事長	智融集團董事長 宏碁（股）公司董事 佳世達科技（股）公司董事 緯創資通（股）公司董事 南山人壽保險（股）公司董事

獨立董事 湯馬斯·延吉布斯	101/6/12	104/6/11	98/6/10	-	-	-	-	-	-	-	美國普渡大學電機工程學士及碩士 美國普渡大學電機工程榮譽博士 國家工程學院 (NAE) 會員 Texas Business Hall of Fame會員 Woodrow Wilson獎 前美國德州儀器公司執行副總經理暨半導體集團總經理 前美國德州儀器公司總經理暨總執行長 前美國德州儀器公司董事長 前Catalyst董事長 Catalyst榮譽董事 美國 Southwestern Medical 基金會榮譽理事	美國 J. C. Penney 公司董事長
------------------	----------	----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------

獨立董事 鄒至莊	101/6/12	104/6/11	100/6/9	-	-	-	-	-	-	-	康乃爾大學經濟學系學士，1951 芝加哥大學經濟學碩士，1952 芝加哥大學經濟學博士，1955 中央研究院院士 美國哲學學會院士 美國統計學協會院士 美國計量經濟學學會院士 前動態經濟及控制學學會主席 中山大學榮譽博士 嶺南大學法學博士 香港科技大學企業管理榮譽博士 中國大陸復旦大學、廣西大學、海南大學、南開大學、山東大學、人民大學、華中科技大學、中國科學院研究生院管理學院、中山大學及香港城市大學榮譽教授 麻省理工學院助理教授，1955-1959 康乃爾大學助理教授，1959-1962 IBM Thomas Watson研究中心經濟研究計劃研究員及經理，1962-1970 哥倫比亞大學兼任教授，1964-1970 普林斯頓大學計量經濟學研究計劃教授及主任，1970-2001（2001年，為了向他表示敬意，普林斯頓大學將該研究計劃更名為鄒至莊計量經濟研究計劃「the Gregory C. Chow Econometric Research Program」） 普林斯頓大學1913年級政治經濟學教授，1976-2001 中美經濟學教育交流委員會美方委員會主席，1981-1994 中國大陸經濟學教育和研究之美方委員會主席，1985-1994 1960年代中期至1980年代初期為中華民國政府就經濟政策提供諮詢 1985年至1989年間為中國大陸總理及國家經濟體制改革委員會就經濟轉型提供諮詢 普林斯頓大學經濟學教授及1913年級政治經濟學榮譽教授，2001至現在 普林斯頓大學—Lecturer with the Rank of Professor	無
-------------	----------	----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	--	---

獨立董事 陳國慈	101/6/12	104/6/11	100/6/9		-	-	-	-	5,120	0.00%	英國Inns of Court School of Law 英國大律師資格 新加坡律師資格 美國加州律師資格 台積公司資深副總經理暨法務長， 1997-2001 國家文化藝術基金會執行長，1995-1997 漢聲出版社副總經理，1992-1995 國振法律事務所合夥人，1988-1992 聯鼎法律事務所合夥人，1975-1988 美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe法律事務所律師，1974-1975 美國紐約Sullivan & Cromwell法律事務所律師，1971-1974 新加坡陳材清法律事務所律師， 1969-1970 東吳大學教授，2001-2008 國立政治大學教授，2001-2004 國立清華大學客座教授，1999-2002 東吳大學副教授，1981-1998 新加坡南洋大學講師，1970-1971 「台北故事館」創辦人／總監 「撫臺街洋樓」創辦人／總監 中華民國行政院政務顧問 台北市政府市政顧問 財團法人台積電文教基金會董事 財團法人國家文化藝術基金會董事 財團法人中華民國婦癌基金會董事	無
附註： 1. 董事利用他人名義持有台積公司股份：無 2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事：無												

註一：民國年／月／日。

註二：截至民國一〇二年三月三十一日實際持有股數。

註三：該法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東（股權比例佔前十名之股東名稱）
行政院國家發展基金管理會	不適用

該法人股東其主要股東為法人者：不適用。

註四：行政院國家發展基金管理會於民國九十九年八月六日指派李鍾熙先生擔任本公司董事代表人。

2、董事所具專業資格及獨立性情形

依金融監督管理委員會所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列：

截至民國一〇二年三月三十一日止

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註一）										兼任其他台灣 公開發行公司 獨立董事家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
董事長 張忠謀			√			√		√	√	√	√	√	√	√	0
副董事長 曾繁城			√		√			√	√	√	√	√	√	√	1
董事 李鍾熙	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		3
董事 蔡力行			√					√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 彼得·邦菲			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 施振榮			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 湯馬斯·延吉布斯			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 鄒至莊	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 陳國慈	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0

註一：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打「√」。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者，不在此限）。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第30條各款情事之一。
10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

四、資本及股份

(一) 股本形成經過

1、股本形成

單位：股／新台幣元

民國 年/月	發行價格 (每股面額)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財 產擴充股本者	核准日期與文號(註)
97/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,627,103,715	256,271,037,150	員工認股權行使：9,019,210元 買回股份註銷：8,000,000,000元	無	97/03/20 國商字 第0970006741號
97/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,629,241,609	256,292,416,090	員工認股權行使：21,378,940元	無	97/06/04 國商字 第0970014822號
97/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,151,365,437	261,513,654,370	盈餘轉增資：4,452,425,160元 資本公積轉增資：768,813,120元	無	97/08/06 國商字 第0970021495號
97/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,936,820,778	259,368,207,780	員工認股權行使：21,293,410元 買回股份註銷：2,166,740,000元	無	97/09/10 國商字 第0970024882號
97/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,902,552,963	259,025,529,630	合併銷除股份：342,678,150元	無	97/09/23 國商字 第0970027199號
97/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,625,290,957	256,252,909,570	員工認股權行使：16,129,940元 買回股份註銷：2,788,750,000元	無	97/12/17 國商字 第0970035975號
98/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,625,437,256	256,254,372,560	員工認股權行使：1,462,990元	無	98/03/09 國商字 第0980005952號
98/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,626,012,160	256,260,121,600	員工認股權行使：5,749,040元	無	98/08/17 國商字 第0980023001號
98/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,896,009,261	258,960,092,610	盈餘轉增資：1,931,207,890元 資本公積轉增資：768,763,120元	無	98/08/18 國商字 第0980023041號
98/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,896,353,344	258,963,533,440	員工認股權行使：3,440,830元	無	98/09/16 國商字 第0980026364號
98/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,900,662,339	259,006,623,390	員工認股權行使：43,089,950元	無	98/12/02 國商字 第0980034205號
99/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,902,706,622	259,027,066,220	員工認股權行使：20,442,830元	無	99/03/11 國商字 第0990005852號
99/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,903,769,184	259,037,691,840	員工認股權行使：10,625,620元	無	99/06/01 國商字 第0990015685號
99/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,905,017,151	259,050,171,510	員工認股權行使：12,479,670元	無	99/09/02 國商字 第0990025771號
99/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,907,343,943	259,073,439,430	員工認股權行使：23,267,920元	無	99/12/02 國商字 第0990035818號
100/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,910,078,664	259,100,786,640	員工認股權行使：27,347,210元	無	100/03/11 國商字 第1000007213號
100/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,193,297	259,141,932,970	員工認股權行使：41,146,330元	無	100/06/07 國商字 第1000015848號
100/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,283,114	259,142,831,140	員工認股權行使：898,170元	無	100/08/26 國商字 第1000025518號
100/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,149,208	259,141,492,080	員工認股權行使：8,660,600元 註銷庫藏股：9,999,660元	無	100/12/14 國商字 第1000037707號

101/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,916,222,575	259,162,225,750	員工認股權行使：20,733,670元	無	101/03/22 國商字第1010008872號
101/07	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,920,604,605	259,206,046,050	員工認股權行使：43,820,300元	無	101/07/09 國商字第1010020130號
101/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,920,709,359	259,207,093,590	員工認股權行使：1,047,540元	無	101/09/04 國商字第1010027766號
101/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,922,047,578	259,220,475,780	員工認股權行使：13,382,190元	無	101/12/17 國商字第1010039355號
102/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,924,435,668	259,244,356,680	員工認股權行使：23,880,900元	無	102/03/11 國商字第1020007200號
102/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,928,232,685	259,282,326,850	員工認股權行使：37,970,170元	無	102/06/06 國商字第1020016352號

註：民國年／月／日。

2、最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募普通股執行情形：

無。

(二) 主要股東名單

持股基準日：民國一〇二年四月十三日

主要股東名稱	持有股數	持有比率%
花旗託管台積電存託憑證專戶	5,457,339,113	21.05%
行政院國家發展基金管理會	1,653,709,980	6.38%
摩根大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	845,826,927	3.26%
花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	516,583,378	1.99%
大通託管歐洲太平洋成長基金大衛費雪等專戶	425,265,136	1.64%
美商摩根大通託管阿布達比投資局投資專戶	329,347,439	1.27%
渣打託管 i S h a r e s M S C I 新興市場指數基金投資專戶	295,148,000	1.14%
美商摩根大通銀行託管挪威中央銀行投資專戶	255,420,515	0.99%
國泰人壽保險股份有限公司	206,455,235	0.80%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管 S t i c h t i n g 存託 A P G 新興市場股票共同基金投資專戶	205,152,361	0.79%

(三) 最近兩年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

不適用。

(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

項目	民國 100 年	民國 101 年	民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 3 月 31 日
每股市價（註一）			
最高	78.00	99.20	109.00
最低	63.30	74.30	98.00
平均	72.09	84.08	102.01
每股淨值			
分配前	24.29	27.90	-
分配後	21.29	（註五）	-

每股盈餘			
加權平均股數(仟股)	25,924,682	25,927,936	-
稀釋每股盈餘	5.18	6.41(註五)	-
每股股利			
現金股利	3.00	3.00(註五)	-
累積未付股利	-	-	-
投資報酬分析			
本益比(註二)	13.92	(註五)	-
本利比(註三)	24.03	(註五)	-
現金股利殖利率(註四)	4%	(註五)	-

註一：資料來源為台灣證交所網站。

註二：本益比=當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘。

註三：本利比=當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利。

註四：現金股利殖利率=每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價。

註五：俟股東會決議後定案。

(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1、公司章程所載員工分紅及董事酬勞之有關資訊

依本公司章程規定，公司分派每一營業年度盈餘時，應於依法提撥公積後，提撥所餘盈餘不高於0.3%作為董事酬勞，及不低於1%作為員工紅利。

2、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：實際配發情形與估列數無重大差異。

3、盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：不適用。

4、盈餘分配議案業經股東會決議者：

本公司於一百零一年度所認列之員工獎金與紅利及董事酬勞金額如下：

— 已發放之員工現金獎金新台幣11,115,239,773元

— 民國一〇二年股東常會通過後配發之員工現金紅利新台幣11,115,239,772元

— 董事酬勞新台幣71,351,700元

5、前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

民國一百零一年度董事酬勞及員工紅利，將俟民國一百零二年六月十一日股東常會決議通過後配發。

貳、營運概況

一、公司經營

(一) 業務內容

1、業務範圍

身為專業積體電路製造服務的創始者和領導者，台積公司的成就源自於提供客戶先進的製程技術、「超越摩爾定律」(More-than-Moore)的製程技術以及優異的生產效率。台積公司致力於提供客戶最高的整體價值，視客戶的成功為台積公司的成功。

台積公司提供了全面整合的積體電路製造服務，滿足客戶日益多樣化的需求，也因為與客戶建立密切的合作關係而獲致極大的成長。台積公司藉由優異的最先進製程技術、領先設計服務、量產能力和產品品質，滿足客戶生產需求，並贏得來自全球客戶的信任。

民國九十八年五月，台積公司設立新事業組織，以開拓專業積體電路製造服務領域以外的相關市場機會。民國一百年八月，新事業組織正式獨立為台積固態照明與台積太陽能兩家子公司，持續推動固態照明及太陽能相關的二項新事業。

過去二十五年來，全球已有超過600家客戶透過台積公司生產應用於個人電腦與其周邊產品、資訊應用產品、有線與無線通訊系統產品、汽車與工業用設備以及包括數位影音光碟機、數位電視、遊戲機、數位相機等消費性電子與其他應用產品的晶片。

未來終端電子產品的日新月異，將促使客戶更加廣泛地採用台積公司創新的技術與服務，同時也更促進台積公司自身的技術發展，台積公司深信成功將屬於產業的領導者而非追隨者。

■ 最近二年度銷售量值表

單位：銷售量（八吋晶圓約當片數）／銷售值（新台幣仟元）

		民國 101 年		民國 100 年	
		銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
晶圓	內銷	2,348,115	64,958,354	2,077,487	49,039,389
	外銷	11,508,104	401,877,584	10,411,227	340,588,566
包裝元件	內銷	0	0	0	0
	外銷	143,267	6,124,451	24,881	1,045,714
其他	內銷		4,180,117		4,499,828
	外銷		29,557,232		26,298,590
合計	內銷	2,348,115	69,138,471	2,077,487	53,539,217
	外銷	11,651,371	437,559,267	10,436,108	367,932,870

2、產業概況

■ 產業未來展望、機會與挑戰

➢ 積體電路製造服務市場的需求與供給

經過了民國一百年 5% 的平穩成長後，受惠於無晶圓廠設計公司市佔率增加以及先進製程的引進，積體電路製造服務領域在民國一百零

一年顯著成長 16%。

民國一百零二年整體半導體產業預計將成長 4%。長期而言，因電子產品採用半導體元件的比率提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市佔率，以及系統公司增加特殊應用元件直接委外代工，自民國一百零一年至民國一百零六年，積體電路製造服務領域的成長可望較整體半導體產業 4% 年複合成長率為高。

積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與通訊、電腦、消費性電子產品等主要終端產品的市場狀況息息相關。

✓ 通訊

就通訊產業，尤其是手機部分而言，民國一百零一年的單位出貨量達 5% 的平穩成長。擁有較多半導體組成元件的智慧型手機，更是帶動成長的主要力道。

手機由 3G 演進至 4G/LTE 將持續推動市場的成長。民國一百零二年，擁有更高效能、更低耗電及更多智慧型應用的智慧型手機，將更為吸引消費者的購買興趣；同時，較低階的智慧型手機在新興市場國家的普及，亦是持續推動手機市場成長的動力。

低耗電特性的晶片對手機製造商而言是不可缺少的一環。擁有最佳成本、耗電及外型尺寸（晶片面積）的系統單晶片，以及對於運算複雜軟體的高效能需求，將加速先進製程技術的推進，而台積公司在先進製程技術方面已居領導地位。

✓ 電腦

相較於民國一百年電腦相關領域幾乎持平的表現，民國一百零一年電腦相關領域產品的單位出貨量減少 3%。主要係因已開發國家的保守支出，以及因平板電腦出現，取代了消費者在電腦上的支出。

展望民國一百零二年，預期電腦產業將呈現負成長。同時受到對未來經濟展望持續悲觀的影響，期望創新的產品特性和外型，如可拆式鍵盤筆電及混合型平板／筆電，以及 Windows 8 作業系統的更新，亦有助刺激電腦的消費。

因應低耗電、高效能及高整合度的電腦主要半導體元件如中央處理器、繪圖處理器與晶片組等的需求，產品設計將朝向先進製程技術發展。

✓ 消費性電子

歷經民國一百年的持平表現，民國一百零一年消費性電子產業成長動能消退，整體單位出貨量減少了 2%。經濟景氣的不確定性抑制了消費性電子產品的買氣。除此之外，可攜式產品的成長也對消費性電子產品的銷售造成一定程度的影響。

展望未來，新款遊樂器的推出以及低價大尺寸電視將帶動新一波消費者的買氣。而許多國家對購買數位電視的補貼政策亦將帶動消費者將類比電視轉換為數位電視的換機潮。

此外，數位消費電子產品的創新應用已創造了如觸控螢幕、運動感測、高解析度及 3D 顯示等在新產品上的整合使用模式，除將提高對先進製程技術的需求外，也將進一步增加對如：互補金屬氧化物影像感測器、高壓製程、嵌入式記憶體及微機電製程等「超越摩爾定律」（More-than-Moore）特殊製程的依賴。台積公司提供的技術全面且完整，以求在新趨勢下持續獲利。

✓ 新興應用不斷崛起

新興應用如平板電腦對積體電路製造服務業的貢獻正在逐漸發酵。在蘋果電腦 iPad 的帶領下，平板電腦於民國一百零一年出貨已達 1 億 5,500 萬台，遠高於民國一百年 6,800 萬台的出貨量。強勁的銷售動能在民國一百零二年將隨著其他廠商推出更多機型而持續成長。預期民國一百零一年至民國一百零六年間，平板電腦市場將以 23% 的年平均複合成長率，推動半導體業和積體電路製造服務業持續強勁成長。

■ 產業供應鏈

電子產品的供應鏈複雜而冗長，且各個環節環環相扣。身處產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供即時且充足的產能以因應市場的激烈變化，而積體電路製造服務更是確保產業鏈穩健的重要元素。台積公司身為積體電路製造服務領域的領導者，將持續提供最先進的製程技術及充足的產能，以確保整體產業的穩定與持續創新。

3、技術及研發概況

■ 研發團隊之組織與投資

民國一百零一年，台積公司持續擴大研發規模，進一步強化技術領先優勢。民國一百零一年全年研發總預算約佔總營收之 8%，此一研發投資規模不僅與眾多世界級一流科技公司相當，甚至超越了許多公司的規模。由於研發預算增加，台積公司也同時擴增研發團隊人力，增幅超過 27.5%。

有鑑於驅動互補金屬氧化物半導體（CMOS）製程微縮的摩爾定律是否能繼續延伸，已面臨眾多技術面之困難，在擁有豐富半導體研發經驗的研發副總經理們的領導下，台積公司持續努力提升其研發組織的能力，相信將能克服眾多技術上的挑戰。民國一百零一年，台積公司持續擴增 28 奈米製程產能，此一技術貢獻民國一百零一年第四季總營收將近 22%，預計民國一百零二年將有更顯著的成長。

同時，台積公司亦更進一步加速先進元件技術的發展，特別在 16 奈米製程導入 3D 立體結構的鰭式場效電晶體（FinFET）、嵌入式記憶體以及低介電層銅導線技術的發展。民國一百零一年，台積公司研發團隊藉由成功開發 20 奈米先進製程技術及在 16 奈米電晶體建立的領先地位再次證明了堅強的研發實力。此外，台積公司也擴展電晶體研究的範圍，除了矽晶材料外，也投入其他高效能及低功耗替代性元件材料的研發，例如：鍺及三五族化合物半導體等。

台積公司亦致力於擴展與研發夥伴的合作以及與世界級研發機構的聯盟，例如：台積公司是位於比利時的知名半導體技術研發中心 IMEC 的核心會

員，同時也與矽智財公司策略合作，促成先進製程之矽智財研究發展。此外，台積公司也加強與主要合作夥伴對設計和製程做最佳化的研究開發，並持續贊助國內外主要的大學從事奈米科技研究，以推動創新及先進技術。

上述研發上的努力與投入，讓台積公司屢屢能夠領先專業積體電路製造服務領域，提供客戶量產製程技術與設計解決方案，以協助客戶在複雜且充滿挑戰的市場環境成功且快速地推出其產品。



■ 民國一百零一年研究發展成果

➤ 研究發展組織卓越成果

✓ 28 奈米製程技術

民國一百零一年，台積公司 28 奈米製程技術增加了高效能加強版（28HPP）及高效能三閘極（28HPT）兩項進階製程技術。相較於民國一百年推出的高效能（28HP）製程及高效能行動運算（28HPM）製程，28HPP 與 28HPT 之速度增快 10%。28HPP 已通過驗證並完成首次晶片驗證成功進入初期量產，而 28HPT 在民國一百零一年十二月完成首項客戶產品設計定案（Tape Out），預計民國一百零二年四月以前達成首次晶片驗證成功的目標。

✓ 20 奈米製程技術

民國一百零一年，台積公司持續專注於研發 20 奈米先進製程，包含制定基礎製程、提升良率、研擬並精鑄設計法則、建構 SPICE 模型以及評估製程可靠性。為了提供領先的類比及數位應用產品的晶片製造技術，台積公司採用先進的微影（Lithography）技術，以因應更小尺寸的晶片製造。由於結合了第二世代的高介電層/金屬閘極（HKMG）元件結構、更多的矽應力與新元件結構等優勢，純電晶體之執行效能仍然依循摩爾定律而進一步提高。此外，藉由採用一種特別設計的技術，能夠有效地減少與控制外在電阻（External Resistance）；而後段製程（Back-end of Line, BEOL）亦擁有以超低介電層作為金屬間介質材料與採用創新低電阻銅金屬化製程

的優勢。台積公司 20 奈米邏輯電晶體與靜態隨機存取記憶體單位元 (Bit Cell) 能夠滿足高效能系統單晶片產品之應用。

20 奈米技術的發展可提供極高的閘級密度與晶片效能，然而隨著製程的日益先進，客戶所要面對的昂貴成本與複雜度也持續增加。民國一百零一年，台積公司成功地產出製程開發載具、缺陷抑制載具及內含先進 ARM 核心區塊的邏輯良率提升載具。台積公司利用這些載具進行製程開發，於民國一百零一年提出 1.0 版製程流程、設計套件（設計法則，SPICE 模型與 PDK 製程設計套件）與矽智財，協助客戶降低製造成本。台積公司如期達成精進電晶體性能目標，並締造領先群倫的靜態隨機存取記憶體單位元的操作良率。除了自製製程研發載具，台積公司於民國一百零一年四月與十一月分別啟用晶圓共乘服務，共計超過十家客戶採用此共乘服務並完成矽智財驗證。台積公司高效能 20 奈米製程預計於民國一百零二年第一季進行試產。

✓ 16 奈米製程技術

台積公司在民國一百零一年完成 16 奈米製程技術的定義並且著手開發 16 奈米製程技術。為了要讓摩爾定律延續下去，16 奈米製程技術除了使用第三世代高介電層／金屬閘極 (HKMG) 元件結構、第五世代應力技術以及先進的 193 奈米微影 (Lithography) 技術之外，更運用了先進的三維元件架構—鰭式場效電晶體 (FinFET)。因此，相較於採用傳統平面式電晶體架構的製程技術，在相同的晶片效能之下，16 奈米製程技術提供先進行動應用產品必備的優異省電效能。

民國一百零一年，台積公司在測試載具 (Test Vehicle) 預備、基礎製程制定、設計法則研擬、SPICE 模型建構及製程可靠性評估方面皆有顯著的進步。台積公司按照計劃成功地完成一組製程開發載具的產品設計定案，及早提供客戶設計套件（設計法則與 SPICE 模型），並且在鰭式場效電晶體架構的 SRAM 記憶體上展示功能性的良率。

✓ 微影技術

民國一百零一年，20 奈米微影技術呈現穩定的發展，在材料品質、製程穩定度以及微影機台的維護上皆有持續性的學習與改良，進而取得可靠的成像解決方案，所達成的缺陷學習及缺陷密度 (D0) 目標能夠成功提升 SRAM 驗證載具的良率並完成許多主要客戶的產品設計定案。

16 奈米微影技術代表創新的成像技術，讓 48 奈米線間距 (Pitch) 的 FinFET 得以實現，特別是針對三維元件結構所帶來的晶片表面凹凸落差，要達到充分的表面包覆及平坦化。此外，我們還發展出 80 奈米線間距金屬層的單次微影成像解決方案來協助客戶取得更高的成像密度。基於在 20 奈米製程的學習經驗，我們的試產流程和控制已進入自動化，以加速 SRAM 開發的時間和提升良率。

台積公司已開始使用浸潤式曝光機來進行 10 奈米製程的先期研究，基於成本與下一世代機台取得的考量，這項技術將變得更加精密，

在基礎製程上扮演關鍵的角色。我們正在開發創新的製程來因應 10 奈米技術所帶來的製程控制挑戰。光學近接效應修正已經能夠解決製程的問題，這項改變大幅改善成本及量測的精確性。

由於技術成熟的時機較晚，極紫外光微影和多重電子束直寫是針對 7 奈米製程所開發，然而，10 奈米製程將試用這些技術。

在特殊製程技術，研發微影已進一步推升八吋晶圓廠曝光機的極限，微縮設計準則並協助客戶在晶圓片上取得更多的晶粒以降低成本。研發部門已經技術轉移了多項 eFlash 技術並導入生產，並且推出了 eMRAM 和 eRRAM 微影技術。針對微機電系統，研發部門也已開發出應用於麥克風與加速度計 (Accelerometers) 的技術且完成生產技術的轉移。

台積公司持續與曝光機夥伴艾司摩爾 (ASML) 公司攜手發展浸潤式和極紫外光微影技術，面臨極紫外光光源技術的延遲，193 奈米浸潤式曝光機提升了解析度、規格、並擁有更高的產出能力以實現多重曝影。同時，晶圓十二廠使用的 NXE3100 beta 機台協助我們開發與光罩和光阻相關的 10 奈米及 7 奈米單次曝光極紫外光技術。然而，極紫外光微影技術能否在這些先進製程上大量生產將取決於極紫外光光源能否成功達到每小時超過 100 片的產出。

我們正在廣泛研究 KLA-Tencor REBL 多重電子束直寫機台的可行性、性能及改善方案。台積公司結合設計、互補金屬氧化物半導體、微機電系統和封裝領域所組成的團隊，正在開發與製造應用於 REBL 機台的動態圖形產生晶片。兩部用來鑑定動態圖形產生器和試驗光阻的測試機台已建置完成並將於民國一百零二年運送至台積公司十二吋超大晶圓廠。兩家曝光機公司皆正在評估多重電子束直寫技術的可行性，這項多重電子束直寫技術不僅擁有關鍵層顯像的潛能，更具備降低非關鍵層生產成本與十八吋晶圓成像成本的能力。

✓ 光罩技術

光罩技術是先進曝光顯影技術中極為重要的一環。民國一百零一年，台積公司完成 20 奈米光罩技術的開發，進而實現雙重曝影技術。我們的研發光罩設備啟用更多先進的光罩機台以協助完成未來幾年 16 奈米及 10 奈米光罩技術的開發。具備獨特電子束寫入器、蝕刻機、檢測、修復及驗證的極紫外光光罩技術亦持續發展中。身為 SEMATECH 的核心成員與 EIDEC 的共同開發夥伴，台積公司積極投入極紫外光光罩關鍵架構的開發，例如應用在光罩基板上的同波長修復驗證機台與同波長檢視機台。

➤ 導線與封裝技術整合

- ✓ 民國一百零一年，台積公司成為全球首家提供客戶全方位系統整合解決方案的專業積體電路製造服務公司。台積公司開發並提供後段封裝技術，從先進後段製程導線、結合矽穿孔 (TSV) 與晶粒堆疊可供量產的細間距矽中介層、到包括扇入式 (Fan-in) / 扇出式 (Fan-out) 與超精細間距大型晶粒無鉛覆晶封裝技術之晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP)。台積公司提供客戶相關的設計工具、技術

及量產的能力，這些服務已於民國一百零一年提供給客戶。台積公司藉由創新製程進一步改善與擴展先進後段製程導線技術。此外，我們亦擴大了覆晶封裝技術的範圍，以涵蓋更大的晶粒尺寸和更細的凸塊間距，使其能應用於先進製程技術（28 奈米和 20 奈米）。扇入式與扇出式晶圓級封裝技術也已提供給客戶，這項解決方案已經通過部分客戶的驗證。

✓ 先進導線技術

民國一百零一年，台積公司持續聚焦在開發最低 RC 延遲的先進導線技術。針對 16 奈米與更先進製程技術，台積公司已經開發一種新的導線結構以達成最小間距，同時亦開發一種新的金屬層成像方式將電阻／電容 RC 延遲最小化。在 20 奈米製程，我們的銅導線有效電阻率具高度競爭力且低於國際半導體技術藍圖（The International Technology Roadmap for Semiconductors, ITRS）的預估值。

✓ 先進封裝研究發展

為了在民國一百零一年提供創新和具成本競爭力的無鉛凸塊及封裝解決方案，台積公司已開發並驗證具有超精細間距陣列（100 微米間距）銅凸塊的 28 奈米製程銅柱導線直連封裝技術（Bump-on-Trace, BOT）以用於行動式裝置。台積公司亦擴大無鉛封裝技術的範圍到 20 奈米製程，並提供多樣的無鉛覆晶封裝技術支援行動／手持式裝置和高效能應用產品，以強化客戶競爭力。

✓ 三維積體電路（3D IC）

民國一百零一年，台積公司完成 CoWoS™ 製程和封裝技術的驗證，並完成技術移轉導入量產。CoWoS™ 解決方案提供了一個精簡的整合製程，以利客戶開發的產品達到成本最佳化與產品週期最佳化。我們也發展出採用 28 奈米高效能行動運算製程（28HPM）穿透電晶體堆疊技術（Through Transistor Stacking, TTS）的三維積體電路，協助客戶實現對小尺寸外觀、高性能及低功耗產品的應用。透過對三維積體電路散熱管理關鍵特性的了解，台積公司也開發出與 CoWoS™ 和 TTS 技術相關的散熱解決方案。整體而言，台積公司提供多項技術解決方案，以便客戶作三維晶圓級封裝（System-in-Package, SiP）的設計，其中包括封裝設計、封裝粹取電性分析、時序、信號完整性、阻抗壓降、設計準則查驗（DRC）之散熱與物理驗證以及布線與布局比對（LVS），此產品整合解決方案已可提供給客戶。

➤ 先進電晶體元件研究發展

市場對於高效能及低耗電應用產品的強烈需求推動電晶體結構的創新與研究，遍及應用於各個領域的先進邏輯技術。台積公司積極投入研發除了矽晶材料外的其它高效能、低功耗替代性元件材料，例如鍺及三五族化合物半導體等。此外，台積公司亦積極研究運用創新奈米技術的電晶體結構新概念。

➤ 多樣且完備的製程技術

除了上述先進製程的研發成果，台積公司亦持續成功開發出多樣化的新製程技術，並加速了系統單晶片的技術藍圖，以提供更高的整合度及更多的不同選擇。

✓ 混合訊號／射頻技術

台積公司成功開發出完備的氮氧化矽及多晶矽 28 奈米射頻技術，其低功耗與低成本的優勢可支援下一世代射頻收發器（RF Transceiver）（例如：4G 長期演進技術）。除了標準電壓及低臨界電壓元件之外，台積公司亦提供超低臨界電壓元件，可提供更充分的設計裕度及更低的操作功耗。台積公司提供與互補金屬氧化物半導體相容的技術以實現矽製程的手機射頻切換器（RF Switch）應用，足以與傳統化合物半導體製程相抗衡，台積公司也成功將整合式被動元件（Integrated Passive Device, IPD）技術導入量產，以滿足快速成長的行動裝置市場。

✓ 電源 IC／雙極—互補金屬氧化半導體—雙重擴散金屬氧化半導體（BCD）技術

民國一百零一年，台積公司在高壓及電源管理產品方面共計出貨逾一百萬片晶圓給客戶。除此之外，台積公司研發團隊推出第二代 0.18 微米 BCD 技術，其中一位夥伴客戶的首款產品已經送樣給系統客戶。

✓ 面板驅動技術

民國一百零一年，台積公司推出支援智慧型手機面板驅動晶片的 80 奈米高壓製程並導入量產。此外，此技術衍生的客製化產品亦支援夥伴客戶的產品設計，除了應用於智慧型手機的小尺寸面板，我們亦一直積極開發支援平板電腦應用的 0.11 微米技術。

✓ 微機電系統技術

民國一百零一年，台積公司推出支援加速度計之模組化微機電系統技術，並協助夥伴客戶進入量產。同時，亦執行了一項支援高解析度、能夠消除雜音的麥克風產品專案。

✓ 快閃記憶體／嵌入式快閃記憶體技術

民國一百零一年，台積公司在 65/55 奈米嵌入式快閃記憶體技術達成數項重要的里程碑。65 奈米分離閘（Split Gate）技術已完成車用電子產品製程可靠性驗證，並且已進入量產。在其他反或閘（NOR）式快閃記憶體技術方面，已有一家客戶開始提供數種送樣的 prototype 產品。在混成式（Hybrid）技術方面，亦有 100K 記憶卡應用產品送樣中。

在 40 奈米技術方面，台積公司已與整合元件領導廠商針對車用電子和消費性電子方面的應用合作開發氮化物薄膜（Nitride Film）儲存型快閃記憶體及反或閘式快閃記憶體技術。

■ 技術平台

現今積體電路設計者需要一套精緻的設計基礎架構，來達成令人滿意的生產力及生產工期。這其中包括了電子設計自動化（EDA）流程、通過矽

晶片驗證的資料庫和矽智財、模擬及驗證用的設計套件，如：製程設計套件（PDK）及技術檔案。這些都以製程技術為建構的基礎，而每一項製程技術都需要有各自的設計基礎架構，讓設計者容易使用，這就是技術平台的概念。

台積公司的技術平台反映了多年來台積公司和它的策略夥伴所合作的最佳成果。自從民國九十七年台積公司推出「開放創新平台計劃」以來，台積公司持續地增加了合作的成果以加強技術平台的內容。

民國一百零一年十月，台積公司經由「開放創新平台」的合作，發表了完整的 20 奈米設計生態系統的成果。台積公司的 20 奈米設計生態系統是以基礎設計組件為主，諸如設計法則檢查（DRC）、布局與電路比較（LVS）和製程設計套件；基礎矽智財，包括標準元件庫（Standard Cell）、標準輸出入單元（Standard I/O）、可編程融絲（eFuse）與記憶體編譯器（Memory Compiler）；以及標準的矽智財介面元件，諸如通用串列匯流排（USB）、周邊元件互連介面（PCI）和雙倍資料率動態隨機存取記憶體（DDR）／低功率雙倍資料率動態隨機存取記憶體（LPDDR）。客戶能夠很輕易地從 TSMC-Online 下載這些資料。再者，電子設計自動化工具（EDA）也都完成及時的改版與更新，以滿足客戶 20 奈米設計的技術需求。

民國一百零一年，台積公司藉由兩個特定的參考流程解決最關鍵性的設計挑戰：20 奈米參考流程和 CoWoS™ 參考流程。經由此兩項參考流程，客戶可以取得所需的解決方案，以完成台積公司 20 奈米製程及 CoWoS™ 生產技術的設計。

民國一百零一年十月，台積公司同時也發表專業積體電路製造服務領域的 20 奈米客製化設計參考流程及射頻設計參考流程套件第四版（RF RDK 4.0），提供客製化設計及射頻設計所需的設計協助。

為了確保開放創新平台合作夥伴符合台積公司新製程的要求，台積公司和相關的合作夥伴積極地驗證電子設計自動化工具以確保它們為客戶的設計準備就緒，同時也將驗證報告發布在 TSMC-Online 上。

從 20 奈米製程開始，電子設計自動化驗證的涵蓋範圍更從設計法則檢查、布局與電路比較、寄生元件參數萃取（RCX）及布局與繞線（Placement and Routing）擴大增加了靜態時序分析（Statistical Timing Analysis）、電遷移（Electro-Migration）、阻抗壓降（IR Drop）以及客製化設計。

為了降低客戶採用先進製程的障礙，台積公司先後在民國九十八年提供 65/55 奈米的整合設計流程（Integrated Sign-Off Flow, ISF），在民國一百年提供 40 奈米整合設計流程的設計解決方案，以及民國一百零一年 28 奈米整合設計流程。ISF 是一個奠基於台積公司多年設計經驗所誕生的產品驗證設計流程。台積公司在 ISF 所投入的努力，在民國九十九年開花結果，讓多數初次使用 65/55 奈米製程的客戶群自 0.13 微米等成熟製程成功地移轉至先進製程，並大幅降低中國大陸等新興市場採用先進製程技術的門檻。而 40 奈米整合設計流程的推出更進一步地幫助客戶掌握更多的商機，例如在民國一百年幫助客戶在中國市場上成功地推出 40 奈米的移動裝置應用處理器與第三代／第四代通訊晶片。民國一百零一年，台積公司新推出的 28 奈米整合設計流程協助客戶藉由 28 奈米製

程的設計充分掌握行動通訊市場的商機。

Soft-IP 聯盟計劃希望能加速 soft-IP 在先進製程準備就緒並提早上市的時程。多年以來，soft-IP 的發展獨立於製程技術之外，因此在晶片的用電、效能與面積等方面並未達到最佳化。基於系統單晶片（SoC）等高整合性的晶片設計，對於「首次生產即成功」與「提早產品上市時程」的需求與日俱增，積體電路製造與矽智財業者之間的緊密技術合作將更形重要，才能讓晶片設計達到最佳表現。

民國一百年，台積公司建立一個專注於品質管理的系統以確保 soft-IP 的最高品質並延續在 hard-IP 成功實現的高效能品質紀錄。客戶現可經由 TSMC-Online 來取得 soft-IP 的 soft-IP9000 評估狀況報告。民國一百零一年，新版的 soft-IP Handoff 套件（the soft-IP Kit 2.0）已經準備就緒可供 soft-IP 夥伴使用。Soft-IP Kit 2.0 提供了一組增強版的檢查功能，包括新增的早期實體實作方面的設計檢查（例如面積、時序和壅塞）以及先進的正式 lint 檢查。

（二）市場及產銷概況

1、市場分析

民國一百零一年，全球半導體市場的產值估計約為美金3,080億元，較民國一百年衰退2%。其中，從事半導體製造的積體電路製造服務業產值約為美金340億元，年成長率為16%。

民國一百零一年，即使面對既有競爭者及新進競爭者的挑戰，台積公司在全球半導體業之積體電路製造服務領域，仍以45%的市場佔有率持續保持領先地位。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域保持領先地位的重要關鍵。民國一百零一年，約有62%的營收來自65奈米及以下更先進製程。

除了聚焦贏得了客戶信賴外，台積公司於民國一百零一年亦持續強化「開放創新平台」（Open Innovation Platform®），以提供更多的創新服務。在民國一百零一年舉辦的台積技術論壇（TSMC Technology Symposium）及IEEE設計自動化會議（Design Automation Conference of IEEE/ACM），台積公司揭露了20奈米參考流程、CoWoS™參考流程、射頻技術參考設計套件（Radio Frequency Reference Design Kit）第四版，以及20奈米客製化設計參考流程（Custom Design Reference Flow），以彰顯透過「開放創新平台」整合設計的成功。民國一百零一年十月在美國加州聖荷西舉行的「開放創新平台生態論壇」（OIP Ecosystem Forum）邀請了客戶及生態產業夥伴共襄盛舉，展示透過「開放創新平台」合作所創造之價值及促進創新之綜效。

台積公司持續提升半導體製程技術，在民國一百零一年開發和已提供的製程包括：

- 發展16奈米鰭式場效電晶體製程技術（16nm FinFET），以提供最佳的速度與功耗滿足中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）、加速處理器（APU）、場域可程式化開陣列（FPGA）、網路等新世代產品的需求，以及行動運算之應用，包括智慧型手機、平板電腦及高端的系統單晶片（SoC）。
- 發展20奈米系統單晶片製程技術（20-SoC），以提供平順的28奈米遷移

路徑 (Migration Path)，支持性能導向產品以及行動運算之應用。

- 28奈米高性能製程技術 (28HP) 支援中央處理器、圖像處理器、加速處理器、場域可程式化閘陣列及高速網路晶片等性能導向之應用。
- 28奈米高性能行動運算製程技術 (28HPM) 支援平板電腦、智慧型手機及高端的系統單晶片之應用。
- 28奈米低耗電製程技術 (28LP & HPL) 及射頻製程技術 (28HPL-RF) 提供主流智慧型手機、應用處理器 (AP)、平板電腦、家庭娛樂及數位消費性電子產品之應用。
- 40奈米泛用型製程技術 (40GP) 支援中央處理器、圖像處理器、場域可程式化閘陣列、硬碟驅動晶片 (HDD)、遊戲機 (Game Console) 及千兆位元乙太網路控制器 (GbE) 等性能導向之應用市場。
- 40奈米低耗電及射頻製程技術 (40LP & RF) 提供智慧型手機、數位電視 (DTV)、機上盒 (STB)、遊戲晶片及無線網路連接產品解決方案。
- 與客戶共同開發40奈米非揮發性嵌入式快閃記憶體 (eFlash) 製程技術以符合高端車用電子應用。
- 55奈米低耗電射頻技術提供無線區域網路 (WLAN)、藍芽 (Bluetooth) 及其他手持裝置等應用。
- 55奈米及65奈米5伏橫向擴散金屬氧化物半導體製程技術 (5V LDMOS) 以支援電源管理之應用。
- 55奈米及85奈米超低耗電製程技術支援快閃記憶體控制器 (Flash Controller) 之應用。
- 與客戶共同開發65奈米非揮發性嵌入式快閃記憶體製程技術已通過工業／車用微控制晶片及智慧卡 (Smartcard) 應用規格驗證並已量產。
- 80奈米及0.11微米高壓製程支援高畫質 (HD720) 及超高畫質 (FHD) 面板驅動晶片，而該晶片支援智慧型手機範圍涵蓋視網膜解析度(Retina)至超級視網膜解析度 (Super Retina) 之顯示品質。
- 90奈米超低漏電 (Ultra Low Leakage) 嵌入式快閃記憶體技術已通過特定應用積體電路及微控制器晶片應用規格驗證並已量產。
- 0.13微米新一代二進碼十進數 (Binary Coded Decimal) 製程技術以支援行動運算之應用已進入試產階段，提供具有全球競爭優勢的LDMOS Rds(on)性能以達到最佳電源效率、支援微控制晶片整合以進一步增加電池使用時間。
- 0.18微米第二代BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) 製程技術已進入試產階段，提供具有全球競爭優勢的LDMOS Rds(on) 性能及從6伏至70伏的寬廣電壓以支援電腦運算、通訊及消費性電子市場等多重應用。
- 0.18微米及0.25微米高精度類比製程已經全面釋出，並提供薄膜電阻 (Film Resistor) 及高線性MIM (Metal-Insulator-Metal) 給要求性能的類比混合訊號之應用。

此外，台積公司在民國一百零一年持續強化特殊製程技術的開發，包括 0.5 微米超高壓功率 IC 製程、90/65 奈米智慧卡嵌入式快閃記憶體製程、40 奈

米車用電子及成功從 0.11 微米轉換至 65 奈米的背面照度互補金屬氧化物影像感測器製程 (BSI CIS) 並於十二吋廠量產。民國一百零一年，台積公司亦提供三維模組化微機電系統 (3D Modular MEMS) 平台，具備厚度達 30 微米之微機電系統架構及晶圓級封裝技術。第一波客戶已採用此模組化微機電系統平台整合客製化的驅動晶片，支援加速度計應用產品

(Accelerometer Application) 並且已經量產。台積公司將於民國一百零二年第一季提供全面整合的互補金屬氧化物三維模組化微機電系統 (CMOS 3D Modular MEMS) 平台及設計準則成為標準支援項目。這些特殊製程技術是台積公司與其他競爭者的重要差異，能提供客戶更多價值。

■ 台積公司之市場定位、差異化與策略

➤ 台積公司的市場定位

身為專業積體電路製造服務領域的領導者，台積公司在民國一百零一年的合併營收約為美金 171 億元，佔積體電路製造服務領域的 45%。依據地區劃分，其中來自北美市場的營收佔台積公司總體營收的 69%、日本與中國大陸以外的亞太市場佔 14%、歐洲市場佔 9%、中國大陸市場佔 5%、日本市場佔 3%。依據終端產品市場來區分，電腦相關產品佔台積公司總體營收的 19%、通訊相關產品佔 50%、消費性電子產品佔 9%、工業及標準性產品則佔 22%。

➤ 台積公司的差異化優勢

台積公司在業界的領導地位奠基於「先進技術、卓越製造、客戶信任」三位一體的差異化競爭優勢。身為技術領導者，台積公司一直以來均為首家致力研發下一代先進技術的專業積體電路製造服務公司；身為製造領導者，台積公司以優良的良率管理著稱，並提供加速產品上市及量產的最佳支援服務；在客戶信任上，台積公司也以與客戶緊密無間的合作來提升設計和製造效率。身為專業積體電路製造服務公司，台積公司絕不與客戶競爭。前瞻未來，台積公司將持續藉由三位一體的競爭優勢，提供客戶最有價值的服務。

➤ 台積公司策略

台積公司深信，差異化優勢將使台積公司更能把握未來積體電路製造服務領域的成長機會。因此，台積公司致力於保持與提升上述的三大競爭優勢，例如：積極投入 20 奈米及 16 奈米鰭式場效電晶體先進製程以保持技術上的領先。此外，台積公司也不遺餘力地確保製造優勢，例如：不斷提升可製造性設計的支援服務，以提升良率及效率；推出「開放創新平台」，透過設計生態系統介面與由台積公司主動發起或提供支援的設計服務，能有效率地帶動整體半導體業供應鏈每個環節的創新。最後，在客戶關係上，台積公司於民國一百零一年持續進行客戶評量與調查，以進一步瞭解客戶需要，作為調整服務的參考，以強化與客戶的關係。

為了克服晶圓銷售價格不斷下滑及因應市場上激烈競爭的挑戰，台積公司計劃將繼續強化其核心競爭力，適切地規劃公司長短期技術及業務發展策略，以提高投資報酬率和成長目標。

2、最近二年度主要產品別毛利率重大變化說明

年度 項目	99 年度	100 年度	101 年度
毛利率	49.35%	45.44%	48.12%
毛利率變動	-	-7.9%	5.9%

註：最近二年度毛利率變動均未達 20%，故毋需進一步分析變動情形。

二、轉投資事業

(一) 轉投資事業概況

截至民國一百零一年十二月三十一日止

單位：新台幣仟元

轉投資事業	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市 價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額(仟股)
				股數 (仟股)	股權比例 %				本期認列之投資(損)益(註一)	分配股利	
TSMC Global	一般投資業務	\$42,327,245	\$49,954,386	1	100	\$49,954,386	-	子公司	\$ 469,933	-	-
TSMC Partners	半導體設計、製造等相關投資業務及一般投資業務	31,456,130	38,635,129	988,268	100	38,635,609	-	子公司	5,088,451	-	-
世界先進公司	積體電路、大型、超大型積體電路及其零組件之研發、設計、製造、封裝、測試及銷售	13,232,288	9,462,038	628,223	40	8,511,045	\$12,658,703	採權益法評價之被投資公司	770,379	394,004	-
台積太陽能公司	可再生能源及節能相關之技術與產品之研究、開發、設計、製造及銷售	11,222,945	6,054,445	1,122,294	99	6,031,163	-	子公司	(4,044,944)	-	-
台積固態照明公司	固態照明裝置及其相關應用產品與系統之研究、開發、設計、製造及銷售	4,338,266	2,430,369	433,820	96	2,430,369	-	子公司	(1,397,589)	-	-
SSMC	積體電路之製造及供應	5,120,028	6,710,956	314	39	6,496,972	-	採權益法評價之被投資公司	1,831,634	1,145,417	-
台積電中國子公司	依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路	18,939,667	17,828,683	-	100	17,886,314	-	子公司	4,740,524	-	-

TSMC North America	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務	333,718	3,209,288	11,000	100	3,209,288	-	子公司	312,232	-	-
VTAF III	新創科技事業之投資	3,698,832	2,369,309	-	99	2,347,299	-	子公司	122,852	-	-
精材公司	晶圓級晶方尺寸之封裝業務	1,357,890	1,550,313	94,950	40	1,550,313	-	子公司	(49,604)	9,394	-
創意公司	積體電路元件之研究、開發、生產、測試及銷售	386,568	1,222,972	46,688	35	1,222,972	4,692,130	採權益法評價之被投資公司	209,312	140,064	-
VTAF II	新創科技事業之投資	704,447	563,056	-	98	556,869	-	子公司	61,102	-	-
Emerging Alliance	新創科技事業之投資	852,258	167,359	-	99	167,359	-	子公司（註二）	(2,925)	-	-
TSMC Europe	市場行銷業務及工程支援業務	15,749	235,761	-	100	235,761	-	子公司（註二）	34,931	-	-
TSMC Japan	市場行銷業務	83,760	142,412	6	100	142,412	-	子公司（註二）	3,786	-	-
TSMC Korea	客戶服務及技術支援業務	13,656	26,935	80	100	26,935	-	子公司（註二）	2,602	-	-
台積光能公司	一般投資業務	100,000	65,007	-	100	65,007	-	子公司（註二）	(24,928)	-	-

註一：一百零一年度認列之投資（損）益業已考量聯屬公司間未實現銷貨利益之影響數。

註二：一百零一年度認列之投資（損）益係依該公司同期間未經會計師查核之財務報表計算。

(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權情形無。

三、重要契約

截至民國一〇二年三月三十一日止

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容/限制條款
合資協議書	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司、新加坡經濟發展局（在民國九十五年九月間，飛利浦公司將其於本合約下之權利義務移轉予已更名為恩智浦之飛利浦半導體股份有限公司。台積公司與恩智浦公司在民國九十五年十一月自新加坡經濟發展局購買其所擁有之全數 SSMC 公司股份後，新加坡經濟發展局已不再為此合資協議書之契約對象。）	於民國八十八年三月三十日生效，得依合約規定終止。	台積公司與飛利浦公司、新加坡經濟發展局同意共同出資於新加坡設立晶圓代工公司 Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)。依約定飛利浦公司（現為恩智浦公司）與台積公司有義務購買 SSMC 特定比例之產能。
技術合作契約	Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)	民國八十八年三月三十日至民國九十三年三月二十九日，任一方未於到期前一年以書面通知他方期滿終止合約者，本合約自動展延五年。	台積公司應移轉特定製程技術予 SSMC，SSMC 則應按其銷貨收入淨額之特定比率支付技術報酬金予台積公司。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十六年十二月二十日至民國一〇六年十二月三十一日	簽約雙方就特定之半導體專利達成交互授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
製造、授權及技術移轉契約	世界先進積體電路股份有限公司	民國九十三年四月一日至民國九十五年三月三十一日，每次合約到期將自動展展一年，直到合約雙方當事人以書面合意決定終止。	世界先進公司保留其特定產能予台積公司，並依雙方約定之條件為台積公司製造特定產品。台積公司移轉特定技術予世界先進公司，並向世界先進公司收取權利金作為報酬。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十一年十一月一日至民國一〇一年十月三十一日	簽約雙方就特定之半導體專利達成交互授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
修訂研究及發展合作契約	恩智浦公司 (NXP B.V.)	民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日，雙方另可每年合意延展之。	簽約雙方就特定之先進半導體技術達成共同開發之協議。
股權投資協議及股東協議	荷蘭艾司摩爾公司 (ASML)	股權投資協議契約期間：民國一百〇一年八月五日生​​效。 股東協議契約期間：於民國一百〇一年十月三十一日起生效，得依合約規定終止。	台積公司加入荷蘭艾司摩爾公司 (ASML)「客戶聯合投資專案」並簽訂股權投資協議及股東協議，該等協議內容包括透過子公司 TSMC Global 投資 ASML 歐元 837,816 仟元取得該公司約 5%無表決權之普通股股權，該股權自取得日起兩年半內受有轉讓限制。
研究發展投資協議	荷蘭艾司摩爾公司 (ASML)	民國一百零一年十月三十一日至民國一百零六年十二月三十一日。	台積公司應於一〇二年至一〇六年間陸續支付歐元 276,000 仟元參與 ASML 之研發計畫。

註：除日常的一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂其他重要契約。另本公司於財務報表中亦揭露「重大或有負債及未認列之合約承諾」，請參閱本公司財務報表

參、發行計畫及執行情形

一、本次發行公司債資金運用計畫分析

(一) 資金來源

- 1、目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
- 2、計畫所需資金總額：不超過新台幣 12,500,000 仟元。
- 3、資金來源：發行一〇二年度第三期無擔保普通公司債（金額不超過新台幣 12,500,000 仟元）。
- 4、計畫項目及預定運用進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金金額	預定資金運用進度
			102 年度
			第 4 季
購置機器設備	102 年第 4 季	12,500,000	12,500,000

(二) 本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法

- 1、公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司。
- 2、公司債總額及債券每張之金額：公司債發行總額不超過新台幣壹佰貳拾伍億元整，每張票面金額新台幣壹仟萬元。
- 3、公司債之利率及計、付息方式：

本公司債利率為固定年利率，依發行時市場利率訂定，預估年利率不超過 1.55%。自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。以每仟萬元為基準計付利息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。

4、公司債發行期限及還本：

本公司債發行期限分為四年期及六年期，到期一次還本。

5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入支應，並將依代理還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構，以備兌付到期本息。

6、公司債募得價款之用途及運用計畫：購置機器設備。

7、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣壹仟參佰捌拾柒億元及子公司 TSMC Global Ltd. 發行之公司債美金壹拾伍億元整。

8、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

截至 102 年 3 月 31 日止，核定股本金額為新台幣貳仟捌佰零伍億元整 (NT\$280,500,000 仟元整)，每股面額新台幣壹拾元 (NT\$10) 整，已發行普通股新台幣 貳仟伍佰玖拾貳億捌仟貳佰參拾貳萬柒仟元整 (NT\$259,282,327 仟元整)。

9、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：

截至 102 年 3 月 31 日止，該項餘額為新台幣柒仟伍佰柒拾壹億柒仟零陸拾肆萬捌仟元整(NT\$757,170,648 仟元整)。

10、證券管理機關規定之財務報表：

請參閱本公開說明書「肆、財務概況」。

11、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司為各債權人(以下簡稱債權人)之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並與本公司訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途受讓者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予承認，並同意授與受託契約有關受託事項之全權代理，此授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

12、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

13、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：不適用。

14、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

15、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

18、附認股權者，其認購辦法：不適用。

19、董事會之議事錄：請參閱第 125 頁。

20、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

21、信用評等：

(1)信用評等機構：中華信用評等股份有限公司

(2)信用評等日期：102.07.15

(3)信用評等結果：twAAA

22、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

23、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

24、債券形式：

本公司債為記名式，採無實體發行，由台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)登錄。

25、還本付息代理機構：

將於本公司債定價後，選定還本付息代理機構，代理還本付息事宜及製作扣繳憑單，寄發予債權人，並依集保結算所提供之債權人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。

26、通知方式：

有關本公司債應通知債權人之事項，由受託人依相關法令規定辦理。

(三) 本次計劃之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年每股盈餘稀釋影響

1、本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行金額不超過新台幣 12,500,000 仟元，每張面額為新台幣壹仟萬元，按面額發行。本公司債採未委託證券承銷商對外公開承銷之方式，洽特定人認購，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

2、本次發行公司債之必要性評估：

本次發行公司債之資金將用於購置晶圓十二廠之機器設備，以因應公司長期成長所需，故本次發行公司債應屬必要。

3、本次發行公司債之合理性評估：

本次公司債採固定利率發行，依發行時市場利率訂定，預估年利率不超過 1.55%，由於目前國內長期利率水準尚屬低廉，故發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

4、分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

(1)各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市（櫃）公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權籌資工具，前者有普通公司債、銀行借款及國內外轉換公司債等，後者如現金增資及發行美國存託憑證等。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目		有利因素	不利因素
債權	普通公司債	1.可取得中、長期穩定之資金。 2.借貸成本相對低廉。 3.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 4.債息列為費用，具節稅效果。 5.運用財務槓桿，提高股東權益。	1.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 2.將使負債比率增加。
	銀行借款	1.資金調度運用彈性較大。 2.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 3.債息列為費用，具節稅效果。 4.運用財務槓桿，提高股東權益。	1.較不利於長期資金之取得 2.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 3.將使負債比率增加。
	可轉換公司債	1.因附有轉換權利，票面利率較公司債低。 2.相較於股權籌資，可延緩或不造成每股盈餘及股權稀釋。	1.轉換前將使負債比率增加。 2.轉換後將稀釋每股盈餘及股權。
	現金增資	1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。
股權	美國存託憑證(ADR)	1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 3.募資對象以國外法人為主，可免增資新股釋出，致國內流通股數膨脹，對股價產生不利影響。	1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。 3.發行成本較高，為達成規模經濟效益，募資額度不宜過低。

(2) 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘及股權稀釋。由於目前市場利率處於低點，故利息負擔尚屬合理，對每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：依票面金額十足發行。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益

1、如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者

(1) 資金運用概算：

單位：新臺幣佰萬元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度							
			102 年度				103 年度			
			第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
購置機器設備	102 年	12,500	-	-	-	12,500	-	-	-	-

(2) 預計可增加之產銷量、值、毛利、營業淨利及資金回收年限(表列資料以計畫之預計可能產生效益年度起至預計可收回資金年限止)

單位：千片；新台幣億元

年 度	項 目	生 產 量	銷 售 量	銷 售 值	毛 利	營 業 淨 利
103	晶圓十二廠	17	17	32	14	6
104	晶圓十二廠	35	35	66	30	13
105	晶圓十二廠	35	35	66	30	13
106	晶圓十二廠	35	35	66	30	13
107	晶圓十二廠	35	35	66	30	13

預估資金回收年限：5 年

2、如為轉投資其他公司者

(1) 轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。

(2) 如轉投資特許事業者，應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及其核准或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

3、如為充實營運資金、償還債務者

(1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報(請)年度及未來一年度各月份之現金收支預測表

A. 債務逐年到期金額及償債計畫：不適用。

B. 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形：不適用。

C. 目前營運資金狀況：不適用。

D. 所需之資金額度及運用情形：不適用。

E. 現金收支預測表：不適用。

(2) 申報(請)年度及預計未來一年度應收帳款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產風險性資產比率)，說明償債

或充實營運資金之原因

A. 應收帳款政策及應付帳款政策：不適用。

B. 資本支出計畫：不適用。

C. 財務槓桿及負債比率：不適用。

D. 充實營運資金原因：不適用。

(3)增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成之情形：不適用。

(4)如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。

(5)如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

肆、財務概況

一、財務分析

(一) 財務分析 - 國際財務報導準則

年 度 分析項目（註 1）			最近五年度財務分析					當年度截至 民國 102 年 3 月 31 日 財務分析 （註 2）
			民國 97 年	民國 98 年	民國 99 年	民國 100 年	民國 101 年	
財務 結構 (%)	負債占資產比率							27.60
	長期資金占不動產、廠房 及設備比率							134.41
償 債 能 力 %	流動比率							188.20
	速動比率							163.12
	利息保障倍數							93.61
經 營 能 力	應收款項週轉率（次）							8.50
	平均收現日數							42.96
	存貨週轉率（次）							7.61
	平均銷貨日數							47.96
	應付款項週轉率（次）							20.21
	不動產、廠房及設備週轉 率（次）							0.80
	總資產週轉率（次）							0.50
獲 利 能 力	資產報酬率（%）							15.80
	權益報酬率（%）							21.30
	占實收 資本比 率（%）	營業利益						68.54
		稅前純益						70.58
	純益率（%）							29.78
	基本每股盈餘（元）							1.53
	稀釋每股盈餘（元）							1.53
現 金 流 量	現金流量比率（%）							186.01
	現金流量允當比率（%）							82.84
	現金再投資比率（%）							11.19
槓 桿 度	營運槓桿度							2.49
	財務槓桿度							1.01
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達 20% 者可免分析） 不適用。								

註 1：財務比率計算公式如下：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益淨額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

- (1)流動比率＝流動資產／流動負債。
- (2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
- (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
- 3.經營能力
- (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
- (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
- (6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
- (7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。
- 4.獲利能力
- (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。
- (2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益淨額。
- (3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
- (4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。
- 5.現金流量
- (1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。
- (3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金）。
- 6.槓桿度：
- (1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益。
- (2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

註2：相關分析項目若為期間損益業已推估為全年度損益後計算。

(二) 財務分析 - 中華民國財務會計準則（台積公司及子公司合併財務報表）

年 度 分析項目（註1）		最近五年度財務分析					當年度截至 民國 102 年 3 月 31 日 財務分析 （註3）
		民國 97 年	民國 98 年	民國 99 年	民國 100 年	民國 101 年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	14.05	16.08	19.50	18.37	24.01	
	長期資金占固定資產比率	203.81	186.51	152.08	133.06	130.83	
償債能力 %	流動比率	444.07	328.31	212.29	192.52	177.12	
	速動比率	415.32	300.15	187.57	170.06	149.81	
	利息保障倍數	182.26	244.85	401.30	229.27	177.80	
經營能力	應收款項週轉率（次）	10.73	10.78	10.57	10.06	10.77	
	平均收現日數	34.01	33.86	34.54	36.29	33.89	
	存貨週轉率（次）	9.88	9.30	8.62	8.75	8.38	
	平均銷貨日數	36.94	39.25	42.36	41.70	43.55	
	應付款項週轉率（次）	20.02	18.77	17.23	18.77	19.39	
	固定資產週轉率（次）	1.37	1.08	1.08	0.87	0.82	
	總資產週轉率（次）	0.60	0.50	0.58	0.55	0.53	
獲利	資產報酬率（%）	17.89	15.57	24.77	18.08	19.30	
	股東權益報酬率（%）	20.74	18.37	30.23	22.30	24.57	

能力	占實收資本比率(%)	營業利益	40.75	35.50	61.43	54.62	69.84	
		稅前純益	43.50	36.85	65.72	56.01	70.03	
	純益率(%)		30.17	30.25	38.68	31.48	32.78	
	基本每股盈餘(元)(註2)		3.84	3.45	6.24	5.18	6.41	
	稀釋每股盈餘(元)(註2)		3.81	3.44	6.23	5.18	6.41	
現金流量	現金流量比率(%)		389.91	202.15	186.28	211.60	202.94	
	現金流量允當比率(%)		139.50	126.39	113.91	101.93	95.97	
	現金再投資比率(%)		12.98	6.90	11.13	11.12	11.69	
槓桿度	營運槓桿度		2.53	2.53	2.12	2.50	2.31	
	財務槓桿度		1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	
請說明最近二年度(民國 101 及 100 年度)各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)								
1. 負債佔資產比率增加 31%：主要係應付公司債增加所致。								
2. 利息保障倍數減少 22%：主要係利息費用增加所致。								
3. 營業利益佔實收資本比率增加 28%：主要係營業利益增加所致。								
4. 稅前利益佔實收資本比率增加 25%：主要係稅前利益增加所致。								
5. 基本每股盈餘及稀釋每股盈餘皆增加 24%：主要係稅後純益增加所致。								

註1：財務比率計算公式如下：

1. 財務結構

(1) 負債佔資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金佔固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均固定資產淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。

6. 槓桿度：

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益／(營業利益－利息費用)。

註2：按盈餘及資本公積轉增資比率(九十六年至九十七年盈餘年度)及員工紅利配股比率(至九十六年盈餘年度)追溯調整後之每股盈餘。

註3：相關分析項目若為期間損益業已推估為全年度損益後計算。

(三) 財務分析 - 中華民國財務會計準則(台積公司財務報表)

年 度 分析項目(註1)		最近五年度財務分析					當年度截至 民國102年 3月31日 財務分析 (註3)
		民國97年	民國98年	民國99年	民國100年	民國101年	
財務結構(%)	負債占資產比率	11.87	14.26	18.12	17.31	23.57	
	長期資金占固定資產比率	219.72	196.27	157.73	142.52	136.93	
償債能力%	流動比率	338.70	256.07	162.88	144.79	149.73	
	速動比率	312.83	228.94	140.07	122.41	122.85	
	利息保障倍數	312.95	669.76	789.71	325.54	195.29	
經營能力	應收款項週轉率(次)	11.08	11.17	10.93	10.40	11.01	
	平均收現日數	32.93	32.66	33.40	35.09	33.14	
	存貨週轉率(次)	10.86	10.06	9.44	9.61	9.13	
	平均銷貨日數	33.59	36.29	38.67	37.97	39.97	
	應付款項週轉率(次)	20.40	18.46	16.89	18.17	18.23	
	固定資產週轉率(次)	1.47	1.12	1.11	0.92	0.85	
	總資產週轉率(次)	0.60	0.49	0.58	0.55	0.53	
獲利能力	資產報酬率(%)	18.35	15.98	25.31	18.40	19.56	
	股東權益報酬率(%)	20.74	18.37	30.23	22.30	24.57	
	占實收資本比率(%)	41.48	36.49	59.76	53.60	68.20	
	稅前純益	43.22	36.67	65.34	55.84	70.83	
	純益率(%)	31.06	31.22	39.71	32.09	33.24	
	基本每股盈餘(元)(註2)	3.84	3.45	6.24	5.18	6.41	
現金流量	稀釋每股盈餘(元)(註2)	3.81	3.44	6.23	5.18	6.41	
	現金流量比率(%)	399.16	214.83	188.12	217.99	199.78	
	現金流量允當比率(%)	134.79	122.02	109.98	99.13	93.47	
槓桿度	現金再投資比率(%)	12.95	6.99	11.20	11.07	11.53	
	營運槓桿度	2.50	2.46	2.17	2.54	2.37	
槓桿度	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	

請說明最近二年度（民國 101 及 100 年度）各項財務比率變動原因。（若增減變動未達 20% 者可免分析）

1. 負債佔資產比率增加 36%：主要係應付公司債增加所致。
2. 利息保障倍數減少 40%：主要係利息費用增加所致。
3. 營業利益佔實收資本比率增加 27%：主要係營業利益增加所致。
4. 稅前利益佔實收資本比率增加 27%：主要係稅前利益增加所致。
5. 基本每股盈餘及稀釋每股盈餘皆增加 24%：主要係稅後純益增加所致。

註 1：財務比率計算公式如下：

1. 財務結構

- (1) 負債佔資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
- (2) 長期資金佔固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 償債能力

- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。
- (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

- (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。
- (3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。
- (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。
- (6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均固定資產淨額。
- (7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

- (1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。
- (2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。
- (3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。
- (4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5. 現金流量

- (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。
- (2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。
- (3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。

6. 槓桿度：

- (1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。
- (2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註 2：按盈餘及資本公積轉增資比率(九十六年至九十七年盈餘年度)及員工紅利配股比率(至九十六年盈餘年度)追溯調整後之每股盈餘。

註 3：相關分析項目若為期間損益業已推估為全年度損益後計算。

二、財務報告應記載事項

- (一) 最近二年度財務報告及會計師查核報告(申報募集發行有價證券已逾所應公告申報各季財務報告期限，加列最近一季財務報告)

請參閱第79頁。

- (二) 最近二年度經會計師查核簽證之年度個體財務報告

請參閱第103頁。

- (三) 申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告

不適用。

三、財務概況應記載事項

最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第 185 條情事者：

截至公開說明書刊印日止無此情事。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一) 財務狀況

1. (台積公司財務報表)

單位：新台幣仟元

項目	民國101年	民國100年	增減金額	增減比率(%)
流動資產	207,815,340	158,563,352	49,251,988	31%
固定資產	586,603,294	454,373,533	132,229,761	29%
其他資產	12,006,629	19,070,145	(7,063,516)	-37%
資產總額	946,173,183	761,407,874	184,765,309	24%
流動負債	138,795,878	109,514,430	29,281,448	27%
長期負債	84,179,591	22,299,930	61,879,661	277%
負債總額	222,975,469	131,814,360	91,161,109	69%
股本	259,244,357	259,162,226	82,131	0%
資本公積	56,137,809	55,846,357	291,452	1%
保留盈餘	410,601,289	322,191,155	88,410,134	27%
股東權益總額	723,197,714	629,593,514	93,604,200	15%

■ 增減比例超過 20%之變動分析：

流動資產增加：主要係現金及約當現金與應收關係人款項增加所致。

固定資產增加：主要係先進製程設備相關之資本支出所致。

其他資產減少：主要係存出保證金收回及遞延所得稅資產減少所致。

資產總額增加：主要係固定資產增加所致。

流動負債增加：主要係應付工程及設備款、短期借款及應付所得稅增加所致。

長期負債增加：主要係一百零一年度發行公司債 620 億元所致。

負債總額增加：主要係長期負債增加所致。

保留盈餘增加：主要係一百零一年度淨利，部分因盈餘分配而抵銷。

■ 最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

■ 未來因應計劃：不適用。

2. (台積公司及子公司財務報表)

單位：新台幣仟元

項目	民國101年	民國100年	增減金額	增減比率(%)
流動資產	252,288,635	225,260,396	27,028,239	12%
固定資產	617,529,446	490,374,916	127,154,530	26%
其他資產	19,430,182	24,171,126	(4,740,944)	-20%
資產總額	955,034,605	774,264,942	180,769,663	23%
流動負債	142,435,944	117,006,687	25,429,257	22%
長期負債	86,844,962	25,214,704	61,630,258	244%
負債總額	229,280,906	142,221,391	87,059,515	61%
股本	259,244,357	259,162,226	82,131	0%
資本公積	56,137,809	55,846,357	291,452	1%
保留盈餘	410,601,289	322,191,155	88,410,134	27%
母公司股東權益合計	723,197,714	629,593,514	93,604,200	15%
股東權益總額	725,753,699	632,043,551	93,710,148	15%

■ 增減比例超過 20%之變動分析：

固定資產增加：主要係先進製程設備相關之資本支出所致。

其他資產減少：主要係存出保證金收回及遞延所得稅資產減少所致。

資產總額增加：主要係固定資產及長期投資增加所致。

流動負債增加：主要係應付工程及設備款、短期借款及應付所得稅增加所致。

長期負債增加：主要係一百零一年度發行公司債 620 億元所致。

負債總額增加：主要係長期負債增加所致。

保留盈餘增加：主要係一百零一年度淨利，部分因盈餘分配而抵銷。

■ 最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

■ 未來因應計劃：不適用。

(二) 經營結果

1. (台積公司財務報表)

單位：新台幣仟元

項目	民國101年	民國100年	增減金額	變動比例(%)
銷貨收入總額	506,697,738	421,472,087	85,225,651	20%
銷貨退回及折讓	(6,825,851)	(3,226,594)	(3,599,257)	112%
銷貨收入淨額	499,871,887	418,245,493	81,626,394	20%
銷貨成本	265,538,540	233,083,068	32,455,472	14%
調整前銷貨毛利	234,333,347	185,162,425	49,170,922	27%
關聯企業間已(未)實現銷貨毛利	(25,029)	398,440	(423,469)	-106%
銷貨毛利	234,308,318	185,560,865	48,747,453	26%
營業費用	57,506,548	46,655,102	10,851,446	23%
營業利益	176,801,770	138,905,763	37,896,007	27%
營業外收入及利益	11,188,077	7,287,046	3,901,031	54%
營業外費用及損失	4,359,899	1,484,965	2,874,934	194%
稅前利益	183,629,948	144,707,844	38,922,104	27%
所得稅費用	(17,471,146)	(10,506,565)	(6,964,581)	66%
本年度淨利	166,158,802	134,201,279	31,957,523	24%

■ 增減比例超過 20%的變動分析

銷貨收入總額及銷貨收入淨額增加：主要係一百零一年度晶圓出貨量增加及 28 奈米產品銷售比重增加所致。

銷貨退回及折讓增加：主要係因銷貨收入增加，致依比例提列銷貨退回及折讓準備隨之增加。

調整前銷貨毛利及銷貨毛利增加：主要係一百零一年度晶圓出貨量增加所致。

關聯企業間未實現銷貨毛利增加：主要係一百零一年度第四季銷售予被投資公司之金額增加所致。

營業費用增加：主要係先進製程相關之研究發展費用增加所致。

營業利益增加：主要係銷貨毛利增幅超過營業費用增幅所致。

營業外收入及利益增加：主要係採權益法認列之投資淨益增加所致。

營業外費用及損失增加：主要係一百零一年度提列金融資產減損損失所致。

稅前利益增加：主要係營業利益增加所致。

所得稅費用增加：主要係課稅所得與所得稅稅率增加所致。

一百零一年度淨利增加：主要係稅前利益增加所致。

2. (台積公司及子公司財務報表)

單位：新台幣仟元

項目	民國101年	民國100年	增減金額	變動比例(%)
銷貨收入總額	513,435,603	430,490,500	82,945,103	19%
銷貨退回及折讓	(7,187,023)	(3,409,855)	(3,777,168)	111%
銷貨收入淨額	506,248,580	427,080,645	79,167,935	19%
銷貨成本	262,628,681	232,937,388	29,691,293	13%
調整前銷貨毛利	243,619,899	194,143,257	49,476,642	25%
關聯企業間未實現銷貨毛利	(25,029)	(74,029)	49,000	-66%
銷貨毛利	243,594,870	194,069,228	49,525,642	26%
營業費用	62,537,677	52,511,810	10,025,867	19%
營業利益	181,057,193	141,557,418	39,499,775	28%
營業外收入及利益	6,782,037	5,358,527	1,423,510	27%
營業外費用及損失	6,285,254	1,768,268	4,516,986	255%
稅前利益	181,553,976	145,147,677	36,406,299	25%
所得稅費用	(15,590,287)	(10,694,417)	(4,895,870)	46%
本年度合併總淨利	165,963,689	134,453,260	31,510,429	23%
本年度歸屬予母公司股東淨利	166,158,802	134,201,279	31,957,523	24%

■ 增減比例超過 20%的變動分析

銷貨退回及折讓增加：主要係因銷貨收入增加，致依比例提列銷貨退回及折讓準備隨之增加。

調整前銷貨毛利及銷貨毛利增加：主要係一百零一年度晶圓出貨量增加所致。

關聯企業間未實現銷貨毛利減少：主要係一百零一年度第四季銷售予被投資公司之金額減少所致。

營業利益增加：主要係銷貨毛利增幅超過營業費用增幅所致。

營業外收入及利益增加：主要係採權益法認列之投資淨益增加所致。

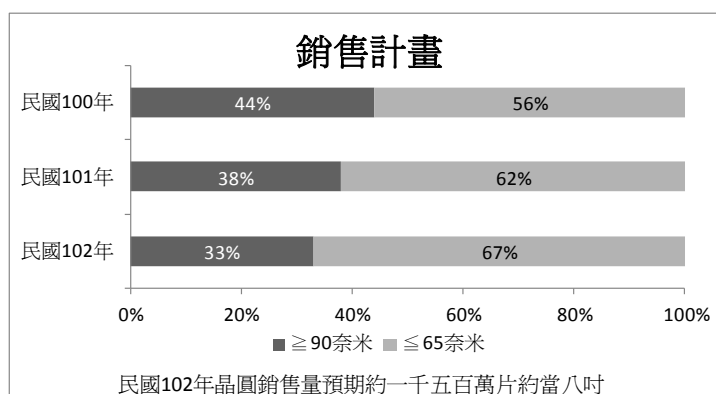
營業外費用及損失增加：主要係金融資產減損損失增加所致。

稅前利益增加：主要係營業利益增加所致。

所得稅費用增加：主要係課稅所得與所得稅稅率增加所致。

一百零一年度合併總淨利及一百零一年度歸屬予母公司股東淨利增加：主要係稅前利益增加所致。

■ 預期未來一年銷售數量及其依據



(三) 現金流量

1. (台積公司財務報表)

單位：新台幣仟元

年初現金餘額 (民國100年12月31日)	全年來自營業活動淨現金 流量(民國101年)	全年因投資及融資活動 淨現金流量(民國101年)	現金剩餘數額 (民國101年12月31日)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
85,262,521	277,288,704	(253,400,415)	109,150,810	-	-

■ 民國一百零一年度現金流量變動分析

營業活動之現金流入約 2,773 億：主要係源自營業純益及無現金支出之折舊及攤銷。

投資活動之現金流出約 2,419 億：主要係用於資本支出。

理財活動之現金流出約 115 億：主要係發放現金股利，部分為發行公司債而抵銷。

■ 現金不足額的補救措施及流動性分析：無現金不足額之情形。

■ 未來一年現金流動性分析：不適用。

2. (台積公司及子公司財務報表)

單位：新台幣仟元

年初現金餘額 (民國100年12月31日)	全年來自營業活動淨現金 流量(民國101年)	全年因投資及融資活動 淨現金流量(民國101年)	現金剩餘數額 (民國101年12月31日)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
143,472,277	289,063,801	(289,125,490)	143,410,588	-	-

■ 民國一百零一年度現金流量變動分析

營業活動之現金流入約 2,891 億：主要係源自營業純益及無現金支出之折舊及攤銷。

投資活動之現金流出約 2,732 億：主要係用於資本支出。

融資活動之現金流出約 138 億：主要係發放現金股利，部分為發行公司債而抵銷。

■ 現金不足額的補救措施及流動性分析：無現金不足額之情形。

■ 未來一年現金流動性分析：不適用。

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出之運用情形及其資金來源

單位：新台幣仟元

計劃	實際或預計之資金來源	實際或預計之資金運用情形
		民國101年
生產及廠務設備	自有資金及發行公司債	222,899,226
研發設備	自有資金	20,994,106
其他	自有資金	2,244,029
合計	自有資金	246,137,361

預期可能產生效益

台積公司在民國一百零一年度之產能較前一年度增加約 187 萬片八吋晶圓約當量。

(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資皆著眼於長期策略性目的；然而，當本公司評估某項投資已不具顯著之策略性價值時，可能將其視為財務性投資。本公司民國一百零一年度採權益法之轉投資獲利為新台幣幣 8,127,748 仟元（合併基礎之下為新台幣 2,028,611 仟元），較民國一百年獲利大幅成長，主要受惠於行動運算產品之高度成長。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

(六) 其他重要事項

- 本公司持有備供出售金融資產之國外上市公司股票，於一〇一年度因其公平價值大幅下跌，而認列減損損失 2,677,529 仟元。
- 本公司於一〇一年八月五日加入荷蘭艾司摩爾公司（ASML）「客戶聯合投資專案」並簽訂股權投資協議，依據該協議將透過子公司 TSMC Global 投資 ASML 歐元 837,816 仟元取得該公司約 5% 普通股股權，該股權於未來兩年半內受有轉讓限制；同時雙方另簽訂研究發展投資協議，本公司將於一〇二年至一〇六年間陸續支付歐元 276,000 仟元參與 ASML 之研發計畫。

伍、特別記載事項

一、委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形

本公司無需委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告

請參照第 120 頁。

三、證券承銷商評估總結意見

不適用。

四、律師法律意見書

不適用。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見

請參照第 126 頁。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項
[]

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者

無。

八、公司治理運作情形

台積公司堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，台積公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准，且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。審計委員會及薪酬委員會完全由獨

立董事所組成。

民國一百零一年榮獲公司治理獎項

組織	獎項
Corporate Governance Asia	第八屆公司治理獎：亞洲最佳台灣公司
FinanceAsia	亞洲最佳管理企業獎（香港及台灣地區） 台灣最佳管理企業：第一名 台灣最佳公司治理：第一名
Asian Corporate Governance Association	亞太區公司治理：第一名
財團法人證券暨期貨市場發展基金會	第九屆上市公司資訊揭露評鑑「A++」

（一） 董事會運作情形

董事會組織

台積公司於民國一百零一年度股東常會選出第十二屆董事，董事全數連任。台積公司董事會由九位擁有豐富的世界級公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力。九位董事中五位為獨立董事，分別為：前英國電信公司執行長彼得·邦菲爵士、前宏碁集團董事長施振榮先生、前德州儀器公司董事長湯馬斯·延吉布斯先生、普林斯頓大學教授鄒至莊先生，以及現為中華民國行政院政務顧問及台北市政府市政顧問陳國慈女士。台積公司獨立董事人數已經超過全體董事席次的二分之一。

董事會職責

在張忠謀董事長領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

依張董事長對公司治理的理念，董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。

為了善盡監督責任，台積公司董事會建立了各式組織與管道，例如：審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核等。

董事會的第二個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊作調整。

董事會的第三個責任，是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事薪酬

目前台積公司董事係領取固定薪酬，公司章程中明訂董事酬勞不超過盈餘的特定百分比（由早期規定依法完成相關提撥後之盈餘的1%，調降為0.3%，嗣又調整為不高於0.3%）。目前在不高於依法完成相關提撥後之盈餘0.3%的原則下，台積公司董事只領取固定薪酬，與現行國際上的最佳運作實務（Best Practice）相符。民國一百零一年，台積公司支付董事之薪酬總額約僅佔稅後純益的0.06%，

而本公司董事兼任經理人者，不支領董事酬勞。

董事會運作情形資訊

張忠謀董事長於民國一百零一年共召開四次董事常會以及三次臨時董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	張忠謀	7	0	100%	連任（註）
副董事長	曾繁城	6	1	86%	連任（註）
董事	行政院國家發展基金管理會代表人：李鍾熙	7	0	100%	連任（註）
董事	蔡力行	7	0	100%	連任（註）
獨立董事	彼得·邦菲爵士	4	3	57%	連任（註） 彼得·邦菲爵士於其中二次委託出席之臨時董事會亦經由電話參與會議討論。
獨立董事	施振榮	6	1	86%	連任（註）
獨立董事	湯馬斯·延吉布斯	4	3	57%	連任（註） 湯馬斯·延吉布斯先生於其中一次委託出席之臨時董事會亦經由電話參與會議討論。
獨立董事	鄒至莊	4	3	57%	連任（註） 鄒至莊先生於其中一次委託出席之臨時董事會亦經由電話

					參與會議討論。
獨立董事	陳國慈	7	0	100%	連任（註）
其它應記載事項： 一、證券交易法第十四條之三所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無 三、加強董事會職能之目標：台積公司相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，本公司成立了審計委員會及薪酬委員會，以協助董事會執行其職責。					

註：本公司民國一百零一年六月十二日股東常會完成第十二屆董事改選，九位董事全數連任，任期自民國一百零一年六月十二日至一百零四年六月十一日止。

（二） 審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。台積公司審計委員會符合上述法令規定。此外，審計委員會亦聘任了一位符合美國證券交易委員會規定的財務專家顧問。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。審計委員會組織章程請參考本公司網站。

審計委員會運作情形資訊

審計委員會主席邦菲爵士於民國一百零一年度共召開四次常會，審計委員會委員出席情形如下表。除上述常會外，審計委員會委員、顧問與管理階層另經由五次電話討論，審閱有關本公司依中華民國及美國法令規定編製之年報及法人說明會資料。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	彼得·邦菲爵士	4	0	100%	連任（註）
委員	施振榮	4	0	100%	連任（註）
委員	湯馬斯·延吉布斯	4	0	100%	連任（註）

委員	鄒至莊	4	0	100%	連任(註)
委員	陳國慈	4	0	100%	連任(註)
財務專家	羅貝茲	4	0	100%	無
其他應記載事項： 一、證券交易法第十四條之五所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（如就公司財務、業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等） 說明：（一）本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國一百零一年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。 （二）本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國一百零一年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。					

註：彼得·邦菲爵士、施振榮、湯馬斯·廷吉布斯、鄒至莊及陳國慈於民國一百零一年六月十二日股東常會當選本公司獨立董事，並成為審計委員會委員，任期自民國一百零一年六月十二日至一百零四年六月十一日止。

（一） 薪酬委員會運作情形

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據台積公司薪酬委員會組織章程，該委員會應至少由三位獨立董事組成。目前，台積公司薪酬委員會由全體五位獨立董事組成，張忠謀董事長應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。

薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。

薪資報酬委員會成員資料

條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	符合獨立性情形（註）	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
----	-------------------------	------------	---

姓名 身份別	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所需相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格領 有證書之專 門職業及技 術人員	具有商 務、法務、 財務、會計 或公司業 務所需之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	
施振榮 獨立董事			√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
彼得·邦 菲爵士 獨立董事			√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
湯馬斯· 延吉布斯 獨立董事			√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
鄒至莊 獨立董事	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
陳國慈 獨立董事	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打「√」。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7. 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
8. 未有公司法第 30 條各款情事之一。

薪酬委員會主席施振榮先生於民國一百零一年度共召開四次常會，薪酬委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	施振榮	4	0	100%	連任(註)
委員	彼得·邦菲爵士	4	0	100%	連任(註)

委員	湯馬斯・延吉布斯	4	0	100%	連任(註)
委員	鄒至莊	4	0	100%	連任(註)
委員	陳國慈	4	0	100%	連任(註)
其他應記載事項： 一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無					

註：台積公司於民國一百零一年六月十二日的董事會中核准任命施振榮、彼得・邦菲爵士、湯馬斯・延吉布斯、鄒至莊及陳國慈五位獨立董事為薪酬委員會委員，任期自民國一百零一年六月十二日至一百零四年六月十一日止。

(二) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司責成包括企業訊息處、股務、法務等相關部門處理股東建議或糾紛等事宜。 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股情形。 本公司已依法令於本公司內部控制制度及「關係企業管理辦法」中建立相關控管。	無
二、董事會之組成及職責 (一) 公司設置獨立董事之情形 (二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	彼得·邦菲爵士、施振榮先生、湯馬斯·延吉布斯先生、鄒至莊先生以及陳國慈女士等五人為本公司獨立董事。 本公司由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性。	無
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司視不同狀況，責成包括企業訊息處、股務等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。	無
四、資訊公開 (一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形	本公司透過公司網站 (http://www.tsmc.com, 中英文版) 隨時揭露相關資訊。 本公司美國存託憑證 (ADR) 在美國紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌交易，為外國發行人，須遵守NYSE相關規定。其中，本公司須依據NYSE上市	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	準則，揭露本公司公司治理執行情形與美國國內公司執行情形之重大差異，有關上述資訊之揭露請參考以下網址： http://www.tsmc.com/download/english/eo3_governance/NYSE_Section_303A.pdf 本公司責成企業訊息處、股務等相關部門負責依規定蒐集及揭露相關資訊。 本公司依規定設有發言人。 本公司法人說明會提供網路現場直播。	
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司設有審計委員會及薪酬委員會，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第55至78頁)。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形： 台積公司堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，台積公司於民國九十一年及民國九十二年先後於董事會下成立審計委員會及薪酬委員會。有關本公司公司治理運作情形，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第55至78頁)。		

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）： （一）員工權益、僱員關懷之執行情形：請參閱本公司民國一百零一年年報「5.5 員工」說明（第77-80頁） （二）投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利之執行情形：請參閱本公司民國一百零一年年報「7.企業社會責任」說明（第98-109頁） （三）董事進修之情形：請參閱本公司民國一百零一年年報第39頁。 （四）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本公司民國一百零一年年報「風險管理」說明（第88-95頁）。 （五）客戶政策之執行情形：請參閱本公司民國一百零一年年報「5.4 客戶信任」說明（第75-76頁）。 （六）本公司已為董事及經理人購買責任保險。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無 民國一百零一年，台積公司榮獲Corporate Governance Asia 雜誌頒發「第八屆2012年亞洲公司治理獎」、FinancialAsia 頒發「台灣最佳公司治理獎」、Asian Corporate Governance Association 頒發「亞太區公司治理第一名」、財團法人證券暨期貨市場發展基金會第九屆上市公司資訊揭露評鑑「A++」以及榮獲天下雜誌頒發「台灣最佳聲望標竿企業」。		

(三) 履行社會責任情形

台積公司認為，「企業社會責任」包含許多面向，在「道德、商業水準、經濟、法治、平衡生活、關懷地球與下一代、公益」這幾方面的實踐和進步，都是身為一個企業公民應負的重要責任與使命。若能在這些方面，落實一己之力，樹立安定社會的力量，促使更多人起而效尤，社會就能更加美好。

我們堅信，所謂「企業社會責任」就是成為促使社會向上提升的力量，以實現「共創永續發展、公平正義、安居樂業的社會」的社會願景。以下台積公司實踐企業社會責任的十項原則，是我們持續為社會帶來正向發展的重要圭臬：

1. 堅持誠信正直，對股東、員工、及社會大眾皆同。
2. 遵守法律、依法行事、絕不違法。
3. 反對貪腐，拒絕裙帶關係；不賄賂、也不追求政商關係。
4. 重視公司治理，力求在股東、員工及所有利益關係人之間，達到利益均衡。
5. 不參與政治。
6. 提供優質工作機會，包括良好的待遇、具有高度挑戰的工作內容，及舒適安全的工作環境，以照顧員工的身心需求。
7. 因應氣候變遷，重視並持續落實環境保護措施。
8. 強調並積極獎勵創新，並充分管控創新改革的可能風險。
9. 積極投資固態照明以及太陽能等綠能產業，為環保節能盡一份心力。
10. 長期關懷社區，並持續贊助教育及文化活動。

在企業的「道德」方面，台積公司堅持誠信正直，反對貪腐，不賄賂、不追求政商關係。在企業的「商業水準」方面，除堅守上述倫理的要件之外，台積公司堅持良好的公司治理，營運透明，信守對所有利益關係人的承諾；同時積極鼓勵創新，帶動產業的發展，促進產業的繁榮。

在企業的「經濟」責任方面，由於台積公司對公司治理的堅持，加上良好的公司營運，積極鼓勵創新，提供待遇優良的優質工作機會，並予以股東優質的投資回饋，為社會創造價值。在「法治」責任方面，我們除了遵守法律、反對貪腐之外，更以最高的倫理和商業道德標準自我檢視和要求。

在「平衡生活」方面，台積公司提供員工優質的待遇與優良的工作環境，重視員工工作與生活的平衡；我們倡導減少不必要的會議、改善作業流程，主管以身作則，員工工作效率提高、工時減少，提供員工一個平衡健康的工作環境。

在「關懷地球與下一代」方面，為提供下一代良好健康的生活環境，做好環境保護、珍惜地球資源，產業界的努力尤其重要，台積公司更是責無旁貸。台積公司新建的廠房及辦公大樓均符合綠建築標準，為綠色的社會著想，使用符合環保要求的設備，室內亦有許多節能措施。

在關懷下一代的同時，台積公司亦善盡「公益」方面的努力，由員工自發性的組成台積電志工社，從事多樣公益活動，包括為大眾導覽、為學子導讀，並有節能志工將公司節能的專長分享給其他學校機構，除了有利社會，此志願性的

服務亦能帶給員工生活的快樂與平衡；此外，公司亦成立有台積電文教基金會，積極投入公益，獎勵莘莘學子，贊助社區及文化活動。

台積電公司持續在以上各個面向的企業社會責任上加倍努力，以成為促使社會向上提升的力量之一。在為所有利益關係人創造價值的同時，我們堅守對環境永續發展的承諾，矢志成為全球產業界的模範，樹立標竿。過去，經由全體同仁兢兢業業的奮鬥，台積電公司在公司治理、營運、投資人關係、員工福利、環保績效等各方面，獲得多項肯定；展望未來，台積電公司將更加深耕並落實上述企業社會責任的原則，為公司所有關係人開創多贏，為社會創造更美好的將來。

履行社會責任情形

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理 (一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。 (二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。 (三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	請參考以上所述。 本公司遵循董事長訂定之企業社會責任十大原則，各單位將企業社會責任的觀念融入各自負責之日常運作中，與利害關係人之溝通藉由個別管道定期或不定期收集其關切議題，各單位再將此些議題評估分析後，將重要議題納入執行計畫及日常運作中。 台積公司從業道德規範要求台積公司所有同仁、經理人和董事會成員均應信奉及實踐本規範，公司經營階層必須建立一重視道德誠信從業行為之良好典範。在董事會的監督下，公司經理人特別是執行長、財務長及法務長，應負責本公司向證券主管機關申報與所有公開對外溝通及揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時且可被了解的。公司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範及相關辦法之規定。 當同仁發現或合理懷疑有任何違反本規範之情形時，必須立即根據違反情形向以下之人員或管道提出報告：直屬主管、人力資源最高主管、員工申訴直通車、或審計委員會之主席。台積公司針對任何違反本規範之同仁，將根據公司獎懲辦法予以處分，包括解僱處分。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
二、發展永續環境 (一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。	台積公司新廠區的製程用水回收率皆達 85%以上，符合或優於科學工業園區管理局所訂定的標準，亦優於國際間半導體廠製程用水回收率。此外，台積公司對於削減非製程用水也不遺餘力，例如減少空調用水、衛生設施使用回收水、管控外牆清洗與景觀澆灌用水以及節約廚房用水等。我們亦使用公司內部網站系統，量測與收集全公司之水回收量。 台積公司成立專責單位統籌管理廢棄物。為了達到資源永續利用，台積公司對於廢棄物的管理，首重製程減廢，其次考量委外再利用或處理。為確實掌握廢棄物的流向，台積公司慎選廢棄物清除處理及再利用廠商，並且訂有年度稽核計劃，確認其證照文件、現場操作情形與行車路徑動向，確保所有廢棄物均經合法妥善處理或再利用，避免造成二次環境污染。民國一百零一年度，台積公司之廢棄物回收率為 92%，已達成 90%的年度目標，同時，衛生掩埋的比例自民國九十七年以來均維持在 1%以下。 台積公司各晶圓廠均設置空氣及水污染防治設備，並符合法規排放標準。此外，各種污染防治設備亦擁有緊急電源在內的備援設計，以確保萬一運轉中發生部分設備故障時，仍可由備援系統替代，降低污染物異常排放的風險。台積公司也將所有水污染防治、空氣污染防治設備的運轉狀況，納入中央監控系統，由每日二十四小時的輪值人員監控，並將系統效率檢知資訊列入重點追蹤項目，以確保空氣及廢水的排放品質。 台積公司與台灣半導體產業協會、行政院環境保護署與世界半導體協會已共同簽署備忘錄，主動制訂企業全氟化物排放減量政策及執行計劃，並於民國九十九年達到將全氟化物排放總量降至民國八十六年及八十八年平均値 90%以下之目標。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。 (四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	請見以上說明。 台積公司為減少氣候變遷所致之風險，持續積極採行節約能源措施、進行自願性溫室氣體全氟化物排放減量計劃，以及每年進行溫室氣體盤查與驗證。自民國九十四年起參與非營利組織碳揭露計劃 (Carbon Disclosure Project, CDP) 的評比，每年揭露氣候變遷相關訊息，包含全公司之溫室氣體排放與減量資訊。 對於新建廠房及辦公室建築物設計，台積公司採用台灣「綠建築標準」及美國綠建築協會 (U.S. Green Building Council, USGBC) 綠建築評量系統「能源與環境先導設計—新建工程 (Leadership in Energy and Environmental Design-New Construction, LEED-NC)」節能環保設計標準，較傳統設計更為節省能資源。同時，台積公司亦逐年改善現有辦公室建築物，以符合美國 LEED 標準。	
三、維護社會公益 (一) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。	「志同道合、適才適所」是台積公司在招募任用、薪酬設計、績效管理與訓練發展等政策與制度上所努力的方向。台積公司恪遵政府勞動法令，透過公平、公開之招募管道，不論性別、宗教、種族、國籍或政黨均一視同仁，惟才適用。此外，我們相信每位員工皆應受到公平的對待與尊重，致力維護並尊重國際公認人權(含聯合國世界人權宣言及國際勞動組織基本公約的核心勞動標準)。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。 (三) 公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。	民國一百零一年當中，台積公司不僅連續十六年被國內最具盛名的天下雜誌評選為「台灣最佳聲望標竿企業」，表彰我們在公司治理、企業承諾、人才培育等層面上之成就；同時，我們也獲選為中華徵信所舉辦的「十大幸福企業」調查中最幸福企業之首，肯定我們持續提倡工作與生活平衡，及對員工照顧的長期付出和承諾。 台積公司依據作業現場特性，進行工作環境改善，提供安全舒適的工作環境。針對危害作業場所，教導並要求員工必須使用個人防護具，將暴露的危害減低至可接受的範圍。我們透過持續改善安全衛生管理系統與教育訓練，達成預防意外事故、促進員工安全、衛生及保護公司資產的目標。 同仁的身心健康，是台積公司生產力的基石，我們持續透過多元的健康照護方案、舉辦健康促進相關活動以及推展員工協助方案，打造健康的職場環境。台積公司每年針對特殊及一般作業在職同仁舉辦到廠健檢服務，健檢項目與頻率皆優於法規要求。此外，也透過心理衛生講座、員工協助方案、心理諮商等各種健康促進活動與方案，整合多元管道與專業資源，積極強化同仁心理素質並提供相關協助。 台積公司重視雙向溝通，致力於強化主管與同仁，以及同仁與同仁間開放且透明的溝通管道，以促進勞資和諧，共創企業與員工的雙贏。我們定期舉辦各層級主管溝通會、跨階層會議，並舉辦員工滿意度調查等活動來傾聽同仁意見，以及時處理同仁反映問題。主要溝通管道包含： ■ 針對重大管理、財務、稽核等各項問題，提供下列機密申訴管道： (1) 具獨立性的審計委員會； (2) 由一位副總經理親自負責的「員工申訴直通車」。 ■ 針對工作與環境等一般性意見，提供員工意見箱，作為反映管道。針對個人工作與生活上的相關議題，可尋求各廠區馬上辦中心協助。	

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(四) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。 (五) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。 (六) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	台積公司定期舉辦年度客戶滿意度調查，以確保客戶的需求得到了了解與妥善照應，並達成高滿意度的服務。此滿意度調查係由中立第三者顧問公司透過網路或訪談來進行，台積公司針對客戶的意見提出改善計劃，並制訂有效的回報系統。 台積公司集合晶圓廠、資材管理、風險管理，以及品質系統管理等單位組成內部的委員會，致力於供應鏈管理。而委員會的主要任務為降低供應鏈風險及改善供應鏈。委員會包含一位資深副總及多位主管，訂定年度計劃及每季查核執行進度，並設置工作小組，與供應商分享風險管理的案例，協助供應商改善和提升品質系統、綠色採購、環境保護和工廠安全，同時，我們定期與供應商溝通，或經由公開的資訊，持續不斷地監控主要供應商的財務狀況及整體供應鏈的庫存變化，並備妥應變方案以降低風險。工作小組每個月定期開會追蹤各專案的進度，並積極解決供應商的問題。其他詳細內容請參考本公司網站企業社會責任相關資訊。 台積電文教基金會持續投入資源，開啟「高中物理實驗學程」、更新國立自然科學博物館「半導體的世界」展館，及開創「台積科學之旅」等多項專案，以推動科普知識，鞏固科學教育基礎。除教育文化紮根的耕耘不輟，台積電文教基金會亦持續支持「台積志工社」，號召台積同仁以實際行動關懷社區弱勢，擴大企業對社會的關懷。	
四、加強資訊揭露 (一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任	台積公司自民國九十七年起每年均發行「企業社會責任報告」，同時亦取得第三者驗證，符合 GRI G3 A+及 AA1000AS:2008 標準要求。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
任之情形。		
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司未訂定企業社會責任守則，有關本公司企業社會責任運作情形，請參閱本公司年報及網站企業社會責任相關資訊，網址： http://www.tsmc.com/chinese/csr/index.htm		
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 請參考本公司網站企業社會責任相關資訊，網址： http://www.tsmc.com/chinese/csr/index.htm		
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： （一）台積公司取得積體電路產品碳足跡驗證以及第三類環保產品標章，符合 PAS2050 與 ISO14025 標準。 （二）台積公司「企業社會責任報告」符合 GRI G3 A+及 AA1000AS:2008 標準要求。		

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施

道德價值之遵循

誠信正直一直是台積公司文化最重要的核心價值。台積公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動，並隨時自我警惕以誠信正直、準確且透明的精神，實踐我們所說及所為之事。

為維護公司文化的核心價值，台積公司訂有從業道德規範(以下稱「本規範」)，要求台積公司及其子公司每一位同仁都負有維護台積公司的道德價值及名譽，並遵守法令規定的重要責任。

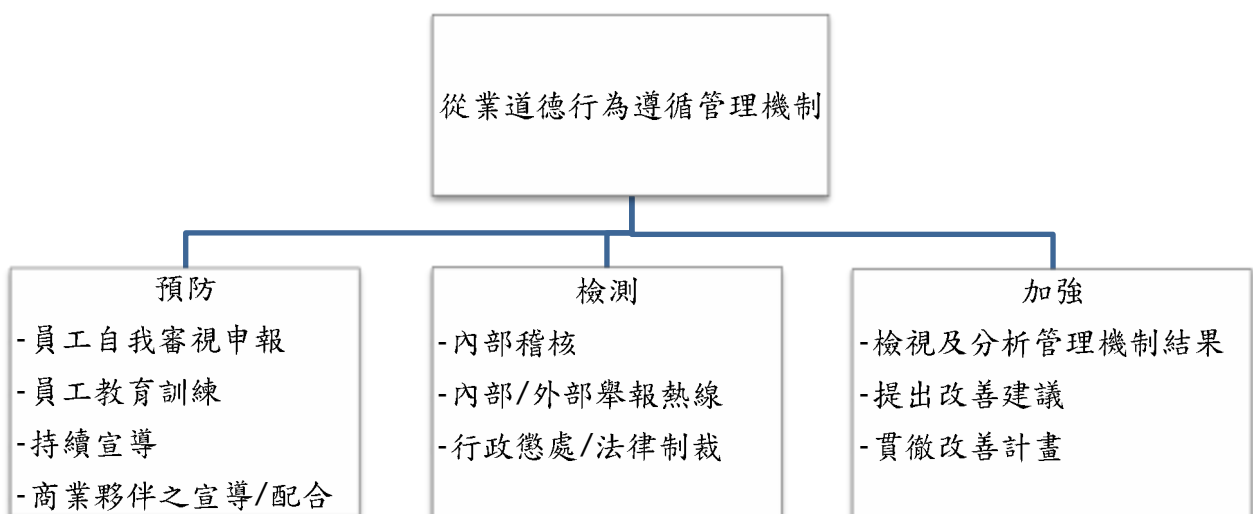
因此，每一位同仁必須做到：

- 避免造成因個人利益而犧牲公司利益或與公司利益有所衝突之情事；
- 迴避任何賄賂、不公平競爭、舞弊、浪費及濫用公司資源情形；
- 不得從事任何不利於公司、環境及社會的行為；
- 原物料採購來源符合社會責任精神；
- 遵守所有法令之立法精神及規範；避免任何不當影響任何人決定之行為，任何人包括政府官員、機構、法院、客戶、供應商及承包商。

為了持續建立一個創新環境、技術領先以及維持獲利成長，本規範要求我們應致力於倡導在絕對尊重台積公司及客戶等之智慧財產權、機密資訊以及營業秘密的基礎上，建立業務關係，並適當使用公司資產，不移作個人用途，以達成公司未來幾年的願景。

台積公司所有同仁、經理人和董事會成員均應信奉及實踐本規範，公司經營階層必須建立一重視道德誠信從業行為之良好典範。在董事會的監督下，公司經理人特別是執行長、財務長及法務長，應負責本公司向證券主管機關申報與所有公開對外溝通及揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時且可被了解的。

從業行為之管理及懲處



公司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範及相關辦法之規定。台積公司期待我們的客戶、供應商、承包商、顧問及其他與本公司有契約關係者了解並

尊重台積公司的道德標準及文化。

根據台積公司從業道德規範之遵循計劃，除了要求所有員工必須自行申報有利益衝突或可能有利益衝突等從業道德疑慮之事項，重要同仁及資深主管必須定期申報是否遵守本規範。另外，為鼓勵公開透明之從業道德文化，我們同時訂定有「Complaint Policy and Procedures for Certain Accounting and Legal Matters」以及「Procedures for Ombudsman System」，提供員工及告發者檢俱相關證據舉報任何財務、法律及誠信相關之不正當的從業行為之管道。當同仁發現或合理懷疑有任何違反本規範之情形時，必須立即根據違反情形向以下之人員報告：直屬主管、人力資源最高主管、負責員工申訴直通車之副總或審計委員會之主席。

為提倡並宣導從業道德行為，台積公司除將相關規範公布在公司內部網站供同仁隨時查詢，同時對每位同仁均進行公司核心價值及遵循制度之宣導。公司亦針對有關從業道德行為之重要議題，例如防止貪瀆及智慧財產權保護，定期提供所有同仁現場及線上相關教育訓練課程。公司內部網站刊登與誠信和從業道德行為等相關之指導原則和文章。台積公司亦要求利害關係人，如供應商、承包商或其他合作者遵守與台積經理人及同仁相同之道德標準，例如要求供應商、承包商或其他合作者提供其不會從事任何違法之商業行為及不會向台積同仁提供不當利益或賄賂等之書面承諾；定期邀集台積公司之商業夥伴，宣導台積公司之從業道德規範，以避免不誠信行為發生；同時在公司網站上設置違反從業道德舉報系統，任何相關人員可以利用此系統舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定資深管理階層親自處理。

公司之內部稽核部門亦隨時稽核公司、承包商、供應商、客戶是否遵守相關法令及規定。

本公司內部稽核藉審閱、覆核公司內部控制制度是否充分與有效，以協助董事會及管理階層，確保下述事項：

1. 財務、管理、營運資訊之正確性、可靠性與及時性。
2. 凡影響公司之法規皆已辨識且予適當之回應。
3. 員工行為遵循相關之政策、準則、程序與法規。
4. 資源係以最適之成本取得，且有效運用並有充分之保全。

為達成上述目標，內部稽核呈報合法規應查核事項之年度稽核計劃予董事會並取得其核准；於完成稽核後定期呈報董事會及管理階層相關之稽核結果與後續改善進度。

台積公司絕不允許任何違反從業道德相關規範之行為，簡而言之，任何經理人或員工，不論其年資，任何違反我們的從業道德標準的行為，將根據公司獎懲辦法受到嚴厲懲處，包括解僱處分及採取適當的法律行動。例如民國一百零一年公司針對不當使用公司智慧財產之違反從業道德行為，對已離職員工提出一件法律訴訟；另亦因違反機密資訊保護(Proprietary Information Protection, PIP) 政策及其他從業道德相關規範解僱員工四位。

落實誠信經營情形

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	誠信正直一直是台積公司文化最重要之核心價值。台積公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動。台積公司制訂有從業道德規範嚴格要求每位員工必須履行誠信政策，並於年報及企業社會報告中詳細說明公司誠信經營之政策以及董事會及管理階層承諾積極落實之情形。 為提倡並宣導誠信行為，台積公司除將相關規範公布在公司內部網站供同仁隨時查詢，同時對每位同仁均進行公司核心價值及遵循制度之宣導，並定期提供相關教育訓練課程。 台積公司亦要求與台積公司有商業往來之利害關係人，如供應商、承包商等必須遵守與台積員工相同之道德標準。 台積公司之內部稽核部門亦隨時稽核公司、承包商、供應商、客戶是否遵守相關法令及規定。 為防範任何不誠信行為，台積公司除了要求所有員工必須自行申報有利益衝突或可能有利益衝突等從業道德疑慮之事項，重要同仁及資深主管必須定期申報是否遵守本規範。 台積公司要求供應商、承包商或其他合作者提供其不會從事任何違法之商業行為及不會向台積同仁提供不當利益或賄賂等之書面承諾。 台積公司在公司內外部網站均設置舉報系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定資深管理階層親自處理。	無

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。 (四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	台積公司要求與台積公司之有商業往來之利害關係人，如供應商、承包商或其他合作者，遵守與台積經理人及同仁相同之道德標準，例如要求供應商、承包商或其他合作者提供其不會從事任何違法之商業行為及不會向台積同仁提供不當利益或賄賂等之書面承諾；並定期邀集台積公司之商業夥伴宣導台積公司之從業道德規範，以避免不誠信行為發生。 誠信正直一直是台積公司文化最重要之核心價值。台積公司自由董事長領導之董事會至專責副總經理（Ombudsman）、法務、人力資源、內部稽核等組織分別從不同層次及面向全力推動企業誠信經營。所有同仁、經理人和董事會成員均應信奉及實踐本規範，公司之經營階層必須建立一重視道德誠信從業行為之良好典範。在董事會之監督下，公司之經理人特別是執行長、財務長及法務長，應負責本公司向證券主管機關申報及所有公開對外溝通及揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、及時且可了解的。 台積公司除了於聘用新進員工時會請其簽署「新進員工利益衝突聲明書」外，亦要求所有在職員工必須自行申報有利益衝突或可能有利益衝突等從業道德疑慮之事項，重要同仁及資深主管必須定期作「年度利益衝突申報」。 台積公司要求供應商、承包商或其他合作者提供其不會從事任何違法之商業行為及不會向台積同仁提供不當利益或賄賂等之書面承諾。 台積公司在公司內外部網站均設置舉報系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定資深管理階層親自處理。 本公司一向注重確保其財務報導流程及其控制的正確性及完整性，並針對潛在具較高不誠信行為風險之作業程序設計相關內部控制制度，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂之年度稽核計劃執行查核，並作成稽核報告提報董事會。	無

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	台積公司在公司內外部網站均設置舉報系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定資深管理階層親自處理。 任何違反我們的從業道德標準的行為，將根據公司獎懲辦法受到嚴厲懲處，包括解僱處分及採取法律行動。例如民國一百零一年公司針對不當使用公司之智慧財產之違反從業道德行為，對已離職員工提出一件法律訴訟，另亦因違反機密資訊保護政策及其他從業道德相關規範，解僱員工四位。	無
四、加強資訊揭露 (一)公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。	台積公司於公司內部網站放置誠信經營相關規範及宣導資訊，以供同仁隨時查詢。 台積公司對外網站(http://www.tsmc.com ，中英文版)上放置的年報及企業社會責任報告中皆詳盡揭露誠信經營相關資訊。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 台積公司訂有從業道德規範，公司所有同仁、經理人及董事會成員均必須遵守本規範及相關辦法之規定。有關本公司從業道德規範運作情形，請參閱本公開說明書「公司履行誠信經營情形及採行措施」說明(第73-77頁)。		
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形)：請參閱本公開說明書「公司履行誠信經營情形及採行措施」(第73-77頁)		

(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式

台積公司堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，台積公司於民國九十一年及民國九十二年先後於董事會下成立審計委員會及薪酬委員會。有關本公司公司治理運作情形，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第55至78頁)。

(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總
無。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊
無。

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 樹 傑

黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 二 月 五 日

		一〇一一年十二月三十一日			一〇〇年十二月三十一日					一〇一一年十二月三十一日			一〇〇年十二月三十一日									
代	碼	資	產	金	額	%	金	額	%	負	債	及	股	東	權	益	金	額	%	金	額	%
流動資產																						
1100	現金及約當現金 (附註二及四)	\$	143,410,588	15	\$	143,472,277	19	2100	短期借款 (附註十五)	\$	34,714,929	4	\$	25,926,528	3							
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 (附註二、五及二六)		39,554	-		15,360	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債 (附註二、五及二六)		15,625	-		13,742	-							
1320	備供出售金融資產 (附註二、六及二六)		2,410,635	-		3,308,770	-	2200	避險之衍生性金融負債 (附註二、十一及二六)		-	-		232	-							
1330	持有至到期日金融資產 (附註二、七及二六)		5,056,973	1		3,625,680	1	2140	應付帳款		14,490,429	1		10,530,487	1							
1150	應收關係人款項 (附註三及二七)		353,811	-		185,764	-	2150	應付關係人款項 (附註二七)		748,613	-		1,328,521	-							
1143	應收票據及帳款 (附註三)		58,257,798	6		46,321,240	6	2160	應付所得稅 (附註二及二〇)		15,635,594	2		10,656,124	1							
1149	備抵呆帳 (附註二、三及八)	(	480,212	-	(	490,952	-	2171	應付薪資及獎金		7,535,296	1		6,148,499	1							
1148	備抵退貨及折讓 (附註二及八)	(	6,038,003	(1)	(	5,068,263	(1)	2219	應付員工紅利及董監酬勞 (附註二及二二)		11,186,591	1		9,081,293	1							
1180	其他應收關係人款項 (附註三及二七)		185,550	-		122,292	-	2224	應付工程及設備款		44,831,798	5		35,540,526	5							
1190	其他金融資產 (附註二八)		473,833	-		617,142	-	2170	應付費用及其他流動負債 (附註十三、十八、二六及三十)		13,148,944	1		13,218,235	2							
1210	存貨 (附註二及九)		37,830,498	4		24,840,582	3	2271	一年內到期之應付公司債及長期銀行借款 (附註十六、十七及二六)		128,125	-		4,562,500	1							
1286	遞延所得稅資產 (附註二及二〇)		8,001,202	1		5,936,490	1	21XX	流動負債合計		142,435,944	15		117,006,687	15							
1298	預付費用及其他流動資產		2,786,408	-		2,174,014	-															
11XX	流動資產合計		252,288,635	26		225,260,396	29															
長期投資 (附註二、六、七、十、十二及二六)																						
1421	採權益法之長期股權投資		23,430,020	3		24,900,332	3	2410	應付公司債 (附註十六及二六)		80,000,000	9		18,000,000	3							
1450	備供出售金融資產		38,751,245	4		-	-	2421	長期銀行借款 (附註十七、二六及二八)		1,359,375	-		1,587,500	-							
1460	持有至到期日金融資產		-	-		5,243,167	1	2443	其他長期應付款 (附註十八、二六及三十)		54,000	-		-	-							
1480	以成本衡量之金融資產		3,605,027	-		4,315,000	1	2446	應付租賃款 (附註二、十三及二六)		748,115	-		870,993	-							
14XX	長期投資合計		65,786,342	7		34,458,501	5	24XX	長期負債合計		82,161,490	9		20,458,493	3							
固定資產 (附註二、十三及二七)																						
地 產																						
1501	土地及土地改良		1,527,124	-		1,541,128	-	2810	應計退休負債 (附註二及二九)		3,979,541	-		3,908,508	-							
1521	建築物		197,314,677	21		172,872,550	22	2820	存入保證金		203,890	-		443,983	-							
1531	機器設備		1,279,167,719	134		1,057,588,736	137	2888	其他 (附註二七)		500,041	-		403,720	-							
1561	辦公設備		19,973,722	2		16,969,266	2	28XX	其他負債合計		4,683,472	-		4,756,211	-							
1611	租賃資產		766,732	-		791,480	-	21XXX	負債合計		229,280,906	24		142,221,391	18							
15X1	累積折舊	(	1,498,749,974	(157)	(	1,249,763,160	(161)															
15X9	備付款項及未完工程	(	1,000,284,504	(105)	(	876,252,220	(113)	3110	股本 (附註二二)		259,244,357	27		259,162,226	33							
1670	預付款項及未完工程		119,063,976	13		116,863,976	15		普通股股本—每股面額 10 元		56,137,802	6		55,846,357	7							
15XX	固定資產淨額		617,529,446	65		490,374,916	63		額定—28,050,000 份股		-	-		-	-							
無形資產																						
1760	商譽 (附註二)		5,523,707	1		5,693,999	1	32XX	資本公積 (附註二及二二)		259,162,226	27		259,162,226	33							
1780	遞延借項—淨額 (附註二及十四)		5,435,862	-		5,167,564	-		資本公積—其他		56,137,802	6		55,846,357	7							
17XX	無形資產合計		10,959,569	1		10,861,563	1	3310	保留盈餘 (附註二二)		115,820,123	12		102,399,995	13							
其他資產																						
1860	遞延所得稅負債—淨額 (附註二及二〇)		4,776,015	1		7,436,717	1	3320	法定盈餘公積		7,606,224	1		6,433,874	1							
1820	存出保證金 (附註二七)		2,426,712	-		4,518,863	1	3350	特別盈餘公積		287,124,942	30		213,357,286	28							
1880	其他 (附註二及二七)		1,267,886	-		1,353,983	-		未分配盈餘		410,601,289	43		322,191,155	42							
18XX	其他資產合計		8,470,613	1		13,309,563	2	34XX	股東權益其他項目		-	-		-	-							
累積換算調整數 (附註二)																						
未認列為退休基金成本之淨損失 (附註二)																						
金融商品未實現損益 (附註二、十一及二六)																						
股東權益其他項目合計																						
母公司股東權益合計																						
少數股權 (附註二)																						
股東權益合計																						
負債及股東權益總計																						
1XXX	資 產 總 計	\$	955,034,605	100	\$	774,264,942	100			\$	955,034,605	100	\$	774,264,942	100							

附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：

總經理：

會計主理：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度	一〇〇年度
	金額 %	金額 %
4110 銷貨收入總額（附註二及二七）	\$ 513,435,603	\$ 430,490,500
4170 銷貨退回及折讓（附註二及八）	7,187,023	3,409,855
4100 銷貨收入淨額（附註三四）	506,248,580 100	427,080,645 100
5110 銷貨成本（附註九、二一及二七）	262,628,681 52	232,937,388 55
5910 調整前銷貨毛利	243,619,899 48	194,143,257 45
5920 關聯企業間未實現銷貨毛利（附註二）	(25,029) -	(74,029) -
銷貨毛利	243,594,870 48	194,069,228 45
營業費用（附註二一及二七）		
6300 研究發展費用	40,402,138 8	33,829,880 8
6200 管理費用	17,638,088 3	14,164,114 3
6100 行銷費用	4,497,451 1	4,517,816 1
6000 合計	62,537,677 12	52,511,810 12
6900 營業利益（附註三四）	181,057,193 36	141,557,418 33
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益（附註二及十）	2,028,611 1	897,611 -
7110 利息收入	1,645,036 -	1,479,514 1
7480 和解賠償收入（附註三十）	883,845 -	947,340 -
7160 兌換淨益（附註二）	582,498 -	- -
7140 處分金融資產淨益（附註二及二六）	541,089 -	233,214 -
7480 技術服務收入（附註二七）	496,654 -	407,089 -
7310 金融商品評價淨益（附註二、五及二六）	- -	507,432 -
7480 其他收入（附註二及二七）	604,304 -	886,327 -
7100 合計	6,782,037 1	5,358,527 1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		一 〇 一 年 度		一 〇 〇 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7630	金融資產減損損失(附註二、六、十、十二及二六)	\$ 4,231,602	1	\$ 265,515	-
7510	利息費用	1,020,422	-	626,725	-
7630	閒置資產減損損失(附註二)	444,505	-	98,009	-
7530	處分固定資產損失(附註二)	31,816	-	200,673	-
7560	兌換淨損(附註二)	-	-	185,555	-
7880	其他損失(附註二、五及二六)	556,909	-	391,791	-
7500	合 計	<u>6,285,254</u>	<u>1</u>	<u>1,768,268</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	181,553,976	36	145,147,677	34
8110	所得稅費用(附註二及二十)	<u>15,590,287</u>	<u>3</u>	<u>10,694,417</u>	<u>3</u>
9600	合併總淨利	<u>\$ 165,963,689</u>	<u>33</u>	<u>\$ 134,453,260</u>	<u>31</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 166,158,802	33	\$ 134,201,279	31
9602	少數股權	(<u>195,113</u>)	-	<u>251,981</u>	-
		<u>\$ 165,963,689</u>	<u>33</u>	<u>\$ 134,453,260</u>	<u>31</u>
代 碼		稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	合併每股盈餘(附註二五)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 7.01</u>	<u>\$ 6.41</u>	<u>\$ 5.59</u>	<u>\$ 5.18</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 7.01</u>	<u>\$ 6.41</u>	<u>\$ 5.59</u>	<u>\$ 5.18</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



圖解之組法係本會編輯機關表之一部分。

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：		
歸屬予母公司股東之淨利	\$ 166,158,802	\$ 134,201,279
歸屬予少數股權之淨利（損）	(195,113)	251,981
調整項目		
折舊及攤銷	131,349,289	107,681,521
關聯企業間未實現銷貨毛利	25,029	74,029
金融資產折溢價攤銷數	4,850	24,711
員工認股權酬勞成本	6,219	-
金融資產減損損失	4,231,602	265,515
處分備供出售金融資產淨益	(399,598)	(212,442)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(141,491)	(20,772)
採權益法認列之投資淨益	(2,028,611)	(897,611)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	2,088,472	2,848,141
處分固定資產及其他資產淨益	(103)	(3,286)
獲配股票作價之賠償收入	(886)	(158,779)
閒置資產減損損失	444,505	98,009
遞延所得稅	573,234	(491,122)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資		
產及負債	(22,311)	(13,734)
應收關係人款項	(168,047)	123,265
應收票據及帳款	(11,936,558)	3,627,110
備抵呆帳	(10,633)	(12,844)
備抵退貨及折讓	975,853	(2,478,001)
其他應收關係人款項	(63,258)	2,294
其他金融資產	122,322	376,342
存 貨	(12,989,916)	2,611,297
預付費用及其他流動資產	(626,405)	(403,762)
應付帳款	1,395,907	(1,968,820)
應付關係人款項	(605,182)	462,578
應付所得稅	4,979,470	3,490,268
應付薪資及獎金	1,386,797	(275,565)
應付員工紅利及董監酬勞	2,105,298	(1,925,594)
應付費用及其他流動負債	2,337,647	212,128
應計退休金負債	66,617	98,915
營業活動之淨現金流入	<u>289,063,801</u>	<u>247,587,051</u>

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$ 246,137,361)	(\$ 213,962,521)
購買備供出售金融資產	(31,525,876)	(35,088,394)
購買持有至到期日金融資產	-	(584,280)
購買以成本衡量之金融資產	(56,512)	(403,908)
處分備供出售金融資產價款	964,367	59,305,023
持有至到期日金融資產領回	2,711,440	4,789,000
處分以成本衡量之金融資產價款	353,656	226,226
處分固定資產及其他資產價款	157,484	698,055
遞延借項增加	(1,782,299)	(1,715,892)
存出保證金減少	2,092,151	4,149,543
其他資產減少	26,688	63,723
投資活動之淨現金流出	(273,196,262)	(182,523,425)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	8,788,401	(5,287,416)
發放現金股利	(77,748,668)	(77,730,236)
舉借長期借款	50,000	2,250,000
償還長期借款	(212,500)	(1,142,968)
發行公司債	62,000,000	18,000,000
償還公司債	(4,500,000)	-
應付租賃款減少	(108,863)	-
其他長期應付款減少	(2,367,866)	(3,633,052)
存入保證金減少	(240,093)	(342,242)
員工行使認股權發行新股	242,488	217,697
買回庫藏股票	-	(71,598)
少數股權增加(減少)	286,200	(118,226)
融資活動之淨現金流出	(13,810,901)	(67,858,041)
現金及約當現金淨增加(減少)數	2,056,638	(2,794,415)
匯率影響數	(2,118,327)	(147,682)
合併個體變動影響數	-	(1,472,581)
年初現金及約當現金餘額	143,472,277	147,886,955
年底現金及約當現金餘額	\$ 143,410,588	\$ 143,472,277

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 736,607	\$ 540,611
資本化利息	(6,442)	(9,093)
不含資本化利息之支付金額	<u>\$ 730,165</u>	<u>\$ 531,518</u>
支付所得稅	<u>\$ 11,312,039</u>	<u>\$ 7,677,085</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產償款	\$ 257,689,153	\$ 207,175,565
應付工程及設備款減少(增加)	(11,551,723)	6,846,682
換出資產抵減償款	(69)	(3,164)
其他負債增加	-	(56,562)
支付現金金額	<u>\$ 246,137,361</u>	<u>\$ 213,962,521</u>
處分固定資產及其他資產償款	\$ 157,553	\$ 543,219
其他金融資產減少	-	158,000
換出資產抵減償款	(69)	(3,164)
取得現金金額	<u>\$ 157,484</u>	<u>\$ 698,055</u>
購置遞延借項償款	\$ 2,253,722	\$ 1,715,892
應付帳款增加	(303,584)	-
應付關係人款項增加	(25,274)	-
其他長期應付款增加	(142,565)	-
支付現金金額	<u>\$ 1,782,299</u>	<u>\$ 1,715,892</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
固定資產轉列閒置資產	<u>\$ 444,505</u>	<u>\$ 98,009</u>
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費 用及其他流動負債)	<u>\$ 913,485</u>	<u>\$ 3,399,855</u>
一年內到期之應付公司債	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,500,000</u>
一年內到期之長期銀行借款	<u>\$ 128,125</u>	<u>\$ 62,500</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 鴻 鵬

會計師 黃 樹 傑

林 鴻 鵬



黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 二 月 十 四 日

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1310	現金及約當現金（附註二及四）	\$ 143,472,277	19	\$ 147,886,955	20	2180	短期借款（附註十五）	\$ 25,926,528	3	\$ 31,213,944	4
	公平價值變動列入損益之金融資產（附註二、五及二六）	15,360	-	6,886	-	2200	公平價值變動列入損益之金融負債（附註二、五及二六）	13,742	-	19,002	-
1320	備供出售金融資產（附註二、六及二六）	3,308,770	-	28,883,728	4	2140	避險之衍生性金融負債（附註二、十一及二六）	232	-	814	-
1330	持有至到期日金融資產（附註二、七及二六）	3,825,680	1	4,796,589	1	2150	應付帳款	10,530,487	1	12,104,173	2
1150	應收關係人款項（附註三及二七）	185,764	-	2,722	-	2160	應付關係人款項（附註二七）	1,328,521	-	867,085	-
1143	應收票據及帳款（附註三）	46,321,240	6	51,029,885	7	2170	應付所得稅（附註二及二十）	10,656,124	1	7,184,697	1
1149	備抵呆帳（附註二、三及八）	(490,952)	-	(504,029)	-	2171	應付薪資及獎金	6,148,499	1	6,424,064	1
1148	備抵退貨及折讓（附註二及八）	(5,068,263)	(1)	(7,546,264)	(1)	2219	應付員工紅利及董監酬勞（附註二及二二）	9,081,293	1	11,096,147	2
1180	其他應收關係人款項（附註三及二七）	122,292	-	124,586	-	2224	應付工程及設備款	35,540,526	5	43,259,857	6
1190	其他金融資產（附註二八）	617,142	-	1,021,552	-	2170	應付費用及其他流動負債（附註十八、二六及三十）	13,218,235	2	10,779,923	1
1210	存貨（附註二及九）	24,840,582	3	28,405,984	4	2271	一年內到期之應付公司債及長期銀行借款（附註十六、十七、二六及二八）	4,562,500	1	241,407	-
1286	遞延所得稅資產—淨額（附註二及二十）	5,936,490	1	5,373,076	1	21XX	流動負債合計	117,006,687	15	123,191,113	17
1298	預付費用及其他流動資產	2,174,014	-	2,037,647	-		長期負債				
11XX	流動資產合計	225,260,396	29	261,519,317	36	2410	應付公司債（附註十六及二六）	18,000,000	3	4,500,000	1
	長期投資（附註二、六、七、十、十二及二六）					2421	長期銀行借款（附註十七、二六及二八）	1,587,500	-	301,561	-
1421	採權益法之長期股權投資	24,900,332	3	25,815,385	4	2443	其他長期應付款（附註十八、二六及三十）	-	-	6,554,208	1
1450	備供出售金融資產	-	-	1,033,049	-	2446	應付租賃款（附註二、十三及二六）	870,993	-	694,986	-
1460	持有至到期日金融資產	5,243,167	1	8,502,887	1	24XX	長期負債合計	20,458,493	3	12,050,755	2
1480	以成本衡量之金融資產	4,315,005	1	4,424,207	1		其他負債				
14XX	長期投資合計	34,458,504	5	39,775,528	6	2810	應計退休金負債（附註二及十九）	3,908,508	-	3,812,351	1
	固定資產（附註二、十三、二七及二八）					2820	存入保證金（附註三十）	443,983	-	789,098	-
1501	成 本	1,541,128	-	891,197	-	2881	遞延貨項	26,533	-	126,539	-
1521	土地及土地改良	172,872,550	22	145,966,024	20	2888	其 他	377,187	-	254,643	-
1531	建 築 物	1,057,588,736	137	913,155,252	127	28XX	其他負債合計	4,756,211	-	4,982,631	1
1561	機器設備	16,969,266	2	14,856,582	2		負債合計	142,221,391	18	140,224,499	20
1561	辦公設備	791,480	-	701,552	-		股本（附註二二）				
1611	租賃資產	1,249,763,160	161	1,075,570,607	149	3110	普通股股本—每股面額 10 元				
15X1	累積折舊	(876,252,220)	(113)	(773,278,157)	(107)		額定—28,050,000 仟股				
1670	預付款項及未完工程	116,863,976	15	86,151,573	12		發行—一〇〇年 25,916,222 仟股				
15XX	固定資產淨額	490,374,916	63	388,444,023	54		九十九年 25,910,078 仟股	259,162,226	33	259,100,787	36
	無形資產					32XX	資本公積（附註二及二二）	55,846,357	7	55,698,434	8
1760	商譽（附註二）	5,693,999	1	5,704,897	1		保留盈餘（附註二二）				
1780	遞延借項—淨額（附註二及十四）	5,167,564	-	6,027,085	1	3310	法定盈餘公積	102,399,995	13	86,239,494	12
17XX	無形資產合計	10,861,563	1	11,731,982	2	3320	特別盈餘公積	6,433,874	1	1,313,047	-
	其他資產					3350	未分配盈餘	213,357,286	28	178,227,030	24
1860	遞延所得稅資產（附註二及二十）	7,436,717	1	7,362,784	1	33XX	保留盈餘合計	322,191,155	42	265,779,571	36
1820	存出保證金	4,518,863	1	8,677,970	1		股東權益其他項目（附註二、十一、二四及二六）				
1880	其他（附註二及二八）	1,353,983	-	1,417,300	-	3420	累積換算調整數	(6,433,369)	(1)	(6,543,163)	(1)
18XX	其他資產合計	13,309,563	2	17,458,054	2	3450	金融商品未實現（損）益	(1,172,855)	-	109,289	-
						34XX	股東權益其他項目合計	(7,606,224)	(1)	(6,433,874)	(1)
							母公司股東權益合計	629,593,514	81	574,144,918	79
						3610	少數股權（附註二）	2,450,037	1	4,559,487	1
						3XXX	股東權益合計	632,043,551	82	578,704,405	80
1XXX	資 產 總 計	\$ 774,264,942	100	\$ 718,928,904	100		負債及股東權益總計	\$ 774,264,942	100	\$ 718,928,904	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	一 〇 〇 年 度	金 額	%	九 十 九 年 度	金 額	%
4110 銷貨收入總額(附註二及二七)	\$	430,490,500		\$	431,630,858	
4170 銷貨退回及折讓(附註二及八)		3,409,855			12,092,947	
4100 銷貨收入淨額		427,080,645	100		419,537,911	100
5110 銷貨成本(附註九、二一及二七)		232,937,388	55		212,484,320	51
5910 銷貨毛利		194,143,257	45		207,053,591	49
5920 關聯企業間未實現銷貨毛利 (附註二)	(	74,029)	-		-	-
已實現銷貨毛利		194,069,228	45		207,053,591	49
營業費用(附註二一及二七)						
6300 研究發展費用		33,829,880	8		29,706,662	7
6200 管理費用		14,164,114	3		12,803,997	3
6100 行銷費用		4,517,816	1		5,367,597	1
6000 合 計		52,511,810	12		47,878,256	11
6900 營業利益		141,557,418	33		159,175,335	38
營業外收入及利益						
7110 利息收入		1,479,514	1		1,665,193	-
7480 和解賠償收入(附註三十)		947,340	-		6,939,764	2
7121 採權益法認列之投資淨益 (附註二及十)		897,611	-		2,298,159	1
7310 金融商品評價淨益(附註 二、五及二六)		507,432	-		320,730	-
7480 技術服務收入(附註二七 及三十)		407,089	-		450,503	-
7140 處分金融資產淨益(附註 二及二六)		233,214	-		736,843	-
7480 其他收入(附註二及二七)		886,327	-		724,880	-
7100 合 計		5,358,527	1		13,136,072	3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一 〇 〇 年 度		九 十 九 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	\$ 626,725	-	\$ 425,356	-
7630	金融資產減損損失(附註二、十二及二六)	265,515	-	159,798	-
7530	處分固定資產損失(附註二)	200,673	-	849,254	-
7560	兌換淨損(附註二)	185,555	-	99,130	-
7630	閒置資產減損損失(附註二)	98,009	-	319	-
7880	災害損失(附註九)	-	-	190,992	-
7880	其他損失(附註二)	391,791	-	316,163	-
7500	合 計	<u>1,768,268</u>	-	<u>2,041,012</u>	-
7900	稅前利益	145,147,677	34	170,270,395	41
8110	所得稅費用(附註二及二十)	<u>10,694,417</u>	<u>3</u>	<u>7,988,465</u>	<u>2</u>
9600	合併總淨利	<u>\$ 134,453,260</u>	<u>31</u>	<u>\$ 162,281,930</u>	<u>39</u>
	歸屬於：				
9601	母公司股東	\$ 134,201,279	31	\$ 161,605,009	39
9602	少數股權	<u>251,981</u>	<u>-</u>	<u>676,921</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 134,453,260</u>	<u>31</u>	<u>\$ 162,281,930</u>	<u>39</u>
代 碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註二五)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.59</u>	<u>\$ 5.18</u>	<u>\$ 6.54</u>	<u>\$ 6.24</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.59</u>	<u>\$ 5.18</u>	<u>\$ 6.54</u>	<u>\$ 6.23</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年七月十一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

母 公 司 股 東 權 益 其 他 項 目	普 通 股 發 行 股 本	金 額	資 本 公 積	保 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品	庫 藏 股 票	母 公 司 股 東 權 益 合 計	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計
股 數 (仟 股)	股 數 (仟 股)	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
九十九年一月一日餘額	25,902,706	\$ 259,027,066	\$ 55,486,010	\$ 77,317,710	\$ -	\$ 104,564,972	\$ 181,882,682	(\$ 1,766,667)	\$ 453,621	\$ -	\$ 495,082,712	\$ 3,965,836	\$ 499,048,548
盈餘分配													
法定盈餘公積	-	-	-	8,921,784	-	(8,921,784)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,313,047	(1,313,047)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,708,120)	(77,708,120)	-	-	-	(77,708,120)	-	(77,708,120)
九十九年度合併總淨利	-	-	-	-	-	161,605,009	161,605,009	-	-	-	161,605,009	676,921	162,281,930
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	(17,885)	-	-	-	-	-	-	-	(17,885)	4,387	(13,498)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(4,776,496)	-	-	(4,776,496)	7,258	(4,769,238)
員工行使認股權發行新股	7,372	73,721	171,103	-	-	-	-	-	-	-	244,824	-	244,824
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(337,970)	-	(337,970)	3,949	(334,021)
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	59,206	-	-	-	-	-	(6,031)	-	53,175	31,702	84,877
現金流量迴除未實現損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(331)	-	(331)	(483)	(814)
少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130,083)	(130,083)
九十九年十二月三十一日餘額	25,910,078	259,100,787	55,698,434	86,239,494	1,313,047	178,227,030	265,779,571	(6,543,163)	109,289	-	574,144,918	4,559,487	578,704,405
盈餘分配													
法定盈餘公積	-	-	-	16,160,501	-	(16,160,501)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	5,120,827	(5,120,827)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,730,236)	(77,730,236)	-	-	-	(77,730,236)	-	(77,730,236)
一〇〇年度合併總淨利	-	-	-	-	-	134,201,279	134,201,279	-	-	-	134,201,279	251,981	134,453,260
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	59,898	-	-	-	-	-	-	-	59,898	1,152	61,050
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	109,794	-	-	109,794	7,587	117,381
員工行使認股權發行新股	7,144	71,439	146,258	-	-	-	-	-	-	-	217,697	-	217,697
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,241,249)	-	(1,241,249)	(3,325)	(1,244,574)
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	(56,094)	-	-	-	-	-	(41,133)	-	(97,227)	-	(97,227)
現金流量迴除未實現損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	238	344	582
庫藏股票交易—股東執行股份收買請求權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,598)	(71,598)	-	(71,598)
庫藏股票註銷	(1,000)	(10,000)	(2,139)	-	-	(59,459)	(59,459)	-	-	71,598	-	-	-
少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(379,334)	(379,334)
合併個體變動影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,987,855)	(1,987,855)
一〇〇年十二月三十一日餘額	25,916,222	\$ 259,162,226	\$ 55,846,357	\$ 102,399,995	\$ 6,433,874	\$ 213,357,286	\$ 322,191,155	(\$ 6,433,369)	(\$ 1,172,855)	\$ -	\$ 629,593,514	\$ 2,450,037	\$ 632,043,551

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量：		
歸屬予母公司股東之淨利	\$ 134,201,279	\$ 161,605,009
歸屬予少數股權之淨利	251,981	676,921
調整項目		
折舊及攤銷	107,681,521	87,810,103
關聯企業間未實現銷貨毛利	74,029	-
金融資產折溢價攤銷數	24,711	34,142
金融資產減損損失	265,515	159,798
處分備供出售金融資產淨益	(212,442)	(603,368)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(20,772)	(133,475)
採權益法認列之投資淨益	(897,611)	(2,298,159)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	2,848,141	320,002
處分固定資產及其他資產淨損(益)	(3,286)	633,230
獲配股票作價賠償收入	(158,779)	(4,434,364)
提列閒置資產減損損失	98,009	319
遞延所得稅	(491,122)	(377,248)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(13,734)	198,172
應收關係人款項	123,265	9,802
應收票據及帳款	3,627,110	(6,392,243)
備抵呆帳	(12,844)	(39,296)
備抵退貨及折讓	(2,478,001)	(1,178,217)
其他應收關係人款項	2,294	(3,294)
其他金融資產	376,342	740,959
存貨	2,611,297	(7,492,233)
預付費用及其他流動資產	(403,762)	(752,408)
應付帳款	(1,968,820)	933,894
應付關係人款項	462,578	84,078
應付所得稅	3,490,268	(1,615,552)
應付薪資及獎金	(275,565)	(2,892,971)
應付員工紅利及董監酬勞	(1,925,594)	4,277,804
應付費用及其他流動負債	304,582	248,192
應計退休金負債	98,915	15,319
遞延貨項	(92,454)	(59,150)
營業活動之淨現金流入	<u>247,587,051</u>	<u>229,475,766</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$ 213,962,521)	(\$ 186,944,203)
購買備供出售金融資產	(35,088,394)	(48,340,334)
購買持有至到期日金融資產	(584,280)	(4,101,501)
採權益法之長期股權投資增加	-	(6,242,350)
購買以成本衡量之金融資產	(403,908)	(1,812,928)
處分備供出售金融資產價款	59,305,023	37,816,288
持有至到期日金融資產領回	4,789,000	15,943,000
處分以成本衡量之金融資產價款	226,226	242,335
處分固定資產及其他資產價款	698,055	115,524
遞延借項增加	(1,715,892)	(1,801,728)
存出保證金減少(增加)	4,149,543	(5,944,827)
其他資產減少(增加)	63,723	(1,015,458)
投資活動之淨現金流出	(182,523,425)	(202,086,182)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(5,287,416)	31,213,944
舉借長期借款	2,250,000	-
償還長期借款	(1,142,968)	(967,034)
發行公司債	18,000,000	-
其他長期應付款減少	(3,633,052)	(1,107,333)
存入保證金減少	(342,242)	(232,925)
受領贈與	-	49,021
員工行使認股權發行新股	217,697	244,824
買回庫藏股票	(71,598)	-
發放現金股利	(77,730,236)	(77,708,120)
少數股權減少	(118,226)	(130,083)
融資活動之淨現金流出	(67,858,041)	(48,637,706)
現金及約當現金淨減少數	(2,794,415)	(21,248,122)
匯率影響數	(147,682)	(2,141,264)
合併個體變動影響數	(1,472,581)	-
年初現金及約當現金餘額	147,886,955	171,276,341
年底現金及約當現金餘額	\$ 143,472,277	\$ 147,886,955

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 531,518	\$ 392,805
支付所得稅	\$ 7,677,085	\$ 9,818,418
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產償款	\$ 207,175,565	\$ 201,696,476
應付工程及設備款減少(增加)	6,846,682	(14,599,987)
換出資產抵減償款	(3,164)	(124,746)
其他負債增加	(56,562)	(27,540)
支付現金金額	\$ 213,962,521	\$ 186,944,203
處分固定資產及其他資產償款	\$ 543,219	\$ 458,561
其他金融資產減少(增加)	158,000	(218,291)
換出資產抵減償款	(3,164)	(124,746)
取得現金金額	\$ 698,055	\$ 115,524
購買備供出售金融資產償款	\$ 35,024,974	\$ 48,405,875
應付費用及其他流動負債減少(增加)	63,420	(65,541)
支付現金金額	\$ 35,088,394	\$ 48,340,334
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之應付公司債	\$ 4,500,000	\$ -
一年內到期之長期銀行借款	\$ 62,500	\$ 241,407
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費用及其他流動負債)	\$ 3,399,855	\$ 1,406,601

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



會計師核閱報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇二年三月三十一日暨一〇一年十二月三十一日、三月三十一日及一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，因是無法對上開財務報告之整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述財務報告在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」及國際會計準則第34號「期中財務報導」而須作修正之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 高 逸 欣

高逸欣



會計師 黃 鴻 文

黃鴻文



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 五 月 十 四 日

民國一〇二年三月三十一日及一月三十一日

(單位:新台幣千元)

單位:新台幣千元

代 碼	說 明	一〇二年三月三十一日			一〇一年十二月三十一日			一〇一年三月三十一日			一〇一年一月三十一日			一〇二年三月三十一日			一〇一年十二月三十一日			一〇一年三月三十一日			一〇一年一月三十一日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%
1100	現金及約當現金(附註八)	\$	186,028,798	18	\$	143,410,588	15	\$	170,819,939	21	\$	143,472,127	18	\$	35,842,800	3	\$	34,714,929	4	\$	34,687,716	4	\$	25,926,528	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)		18,206	-		39,554	-		1,658	-		15,340	-		4,223	-		15,625	-		61,038	-		13,742	-
1125	備供出售金融資產(附註八)		1,162,904	-		2,410,635	-		3,577,801	-		3,308,770	-		-	-		-	-		135	-		232	-
1130	持有至到期日金融資產(附註九)		2,044,822	-		5,096,973	1		6,253,618	1		3,825,680	1		12,462,978	1		14,490,429	2		13,262,122	2		10,530,687	1
1170	應收票據及應收帳款(附註十一)		65,472,529	6		52,777,586	6		52,795,666	7		45,830,288	6		793,153	-		748,613	-		906,317	-		1,328,521	-
1180	應收關係人款項(附註三六)		434,206	-		353,811	-		647,314	-		185,794	-		5,079,209	1		7,335,296	1		4,226,594	-		6,148,499	1
1210	其他應收關係人款項(附註三六)		176,298	-		185,550	-		1,301,705	-		122,292	-		13,864,935	1		11,186,591	1		11,327,679	1		9,081,293	1
1310	存貨(附註五及十二)		37,833,465	4		37,830,498	4		27,759,150	3		24,840,582	3		48,601,349	5		44,831,798	5		34,070,990	4		35,540,526	5
1470	其他流動資產(附註十七)		3,339,372	-		2,786,408	-		3,087,516	-		2,174,034	-		20,114,514	2		15,835,594	2		13,511,557	2		10,656,124	1
1476	其他金融資產(附註三十七)		1,240,492	-		473,833	-		321,010	-		617,143	-		6,350,698	1		6,038,003	-		5,428,410	1		5,068,263	1
11XX	流動資產合計		287,251,192	28		260,329,436	26		266,815,377	32		238,392,149	28		14,915,135	1		13,148,944	1		14,052,743	2		13,718,235	2
1525	備供出售金融資產(附註八)		42,087,667	4		38,751,245	4		-	-		-	-		-	-		128,125	-		93,750	-		4,562,500	1
1527	持有至到期日金融資產(附註九)		-	-		-	-		2,030,812	-		5,243,167	1		131,250	-		-	-		-	-		-	-
1530	應收之利息及股利(附註十)		698,351	-		-	-		-	-		-	-		158,208,328	15		148,473,547	15		131,629,091	15		122,074,950	15
1543	以成本衡量之金融資產(附註十二)		3,701,503	1		3,605,077	-		4,180,185	-		4,315,005	1		-	-		-	-		-	-		-	-
1550	按市價衡量之投資(附註五及十四)		24,252,070	2		23,360,918	3		23,580,109	3		24,686,931	3		80,000,000	8		35,000,000	4		18,000,000	3		18,000,000	3
1600	不動產、廠房及設備(附註五及十五)		666,447,284	63		617,562,188	64		509,953,504	61		490,422,153	63		1,325,000	-		1,339,375	-		1,356,250	-		1,587,500	-
1780	無形資產(附註五及十六)		11,478,437	1		10,999,569	1		10,969,136	1		10,861,563	1		5,199	-		4,891	-		3,083	-		2,889	-
1840	遞延所得稅資產(附註五及三一)		11,610,593	1		13,128,219	2		14,210,531	2		13,604,218	2		54,000	-		54,000	-		50,558	-		-	-
1920	存出保證金(附註三六)		2,385,571	-		2,426,712	-		4,537,507	1		4,518,863	1		768,935	-		748,115	-		742,931	-		870,993	-
1990	其他非流動資產(附註十七及三六)		1,253,868	-		1,235,144	-		1,228,134	-		1,306,746	-		6,904,635	1		6,921,234	1		6,218,052	1		6,241,024	1
1996	其他非流動資產(附註十七及三六)		1,253,868	-		1,235,144	-		1,228,134	-		1,306,746	-		184,780	-		203,890	-		405,594	-		443,983	-
19XX	非流動資產合計		763,678,534	72		711,028,072	74		570,629,018	68		555,158,686	72		531,268	-		495,120	-		436,782	-		400,831	-
25XX	非流動負債合計		134,724,317	13		89,786,655	9		89,786,655	9		44,821,293	5		134,724,317	13		89,786,655	9		44,821,293	5		27,547,220	4
2XXX	負債合計		292,980,641	28		238,260,662	25		238,260,662	25		176,050,804	21		292,980,641	28		238,260,662	25		176,050,804	21		149,622,120	20
3110	股本(附註二四)		259,283,337	25		259,284,357	27		259,284,357	27		259,284,357	27		259,283,337	25		259,284,357	27		259,284,357	27		259,284,357	27
3200	資本公積(附註二四)		55,292,572	5		55,292,572	5		55,292,572	5		55,292,572	5		55,292,572	5		55,292,572	5		55,292,572	5		55,292,572	5
3310	法定盈餘公積		115,820,123	11		115,820,123	12		115,820,123	12		115,820,123	12		102,399,995	10		102,399,995	10		102,399,995	10		102,399,995	10
3320	特別盈餘公積		7,606,224	1		7,606,224	1		7,606,224	1		7,606,224	1		6,433,874	1		6,433,874	1		6,433,874	1		6,433,874	1
3350	未分配盈餘		326,561,997	30		288,985,121	29		288,985,121	29		288,985,121	29		288,985,121	29		288,985,121	29		288,985,121	29		288,985,121	29
3400	其他權益(附註二四)		447,088,344	42		447,088,344	42		447,088,344	42		447,088,344	42		447,088,344	42		447,088,344	42		447,088,344	42		447,088,344	42
31XX	母公司業主權益合計		766,131,268	72		720,550,680	75		720,550,680	75		720,550,680	75		766,131,268	72		720,550,680	75		720,550,680	75		720,550,680	75
36XX	非控制權益(附註二四)		2,517,817	-		2,543,226	-		2,543,226	-		2,543,226	-		2,517,817	-		2,543,226	-		2,543,226	-		2,543,226	-
3XXX	權益合計		768,649,085	72		723,093,906	75		723,093,906	75		723,093,906	75		768,649,085	72		723,093,906	75		723,093,906	75		723,093,906	75
TXXX	資產總計		\$1,061,629,726	100		\$ 861,354,508	100		\$ 837,495,295	100		\$ 779,550,815	100		\$1,061,629,726	100		\$ 861,354,508	100		\$ 837,495,295	100		\$ 779,550,815	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長



總經理



會計主管

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至三月三十一日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日			一 〇 二 年			一 〇 一 年		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
4000	營業收入淨額(附註五、二六、三六及四一)	\$	132,754,996	100	\$	105,614,831	100			
5000	營業成本(附註十二、三三及三六)		<u>71,988,726</u>	<u>54</u>		<u>55,210,347</u>	<u>52</u>			
5900	調整前營業毛利		60,766,270	46		50,404,484	48			
5920	與關聯企業間之已實現利益		<u>3,540</u>	<u>-</u>		<u>74,029</u>	<u>-</u>			
5950	營業毛利		<u>60,769,810</u>	<u>46</u>		<u>50,478,513</u>	<u>48</u>			
	營業費用(附註五、三三及三六)									
6300	研究發展費用		10,650,985	8		9,157,852	9			
6200	管理費用		4,695,520	3		4,657,004	4			
6100	行銷費用		<u>1,029,799</u>	<u>1</u>		<u>1,100,435</u>	<u>1</u>			
6000	合 計		<u>16,376,304</u>	<u>12</u>		<u>14,915,291</u>	<u>14</u>			
6510	其他收益及費損淨額(附註二七及三三)		<u>34,503</u>	<u>-</u>		<u>(445,909)</u>	<u>-</u>			
6900	營業淨利(附註四一)		<u>44,428,009</u>	<u>34</u>		<u>35,117,313</u>	<u>34</u>			
	營業外收入及支出									
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額(附註十四)		654,153	-		22,204	-			
7190	其他收入(附註二八)		346,321	-		501,236	-			
7230	外幣兌換淨益(損)	(	192,914)	-		429,743	-			
7050	財務成本(附註十及二九)	(	493,998)	-		(217,691)	-			
7020	其他利益及損失(附註三十)		<u>1,006,343</u>	<u>1</u>		<u>(179,751)</u>	<u>-</u>			
7000	合 計		<u>1,319,905</u>	<u>1</u>		<u>555,741</u>	<u>-</u>			

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日			一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日		
	一 〇 二 年		金 額	一 〇 一 年		金 額
		%			%	
7900 稅前淨利	\$ 45,747,914	35		\$ 35,673,054	34	
7950 所得稅費用 (附註三一)	<u>6,212,371</u>	<u>5</u>		<u>2,290,118</u>	<u>2</u>	
8200 本期淨利	<u>39,535,543</u>	<u>30</u>		<u>33,382,936</u>	<u>32</u>	
其他綜合損益 (附註十、十四、二四及三一)						
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,903,753	2		(2,624,773)	(2)	
8325 備供出售金融資產未實現評價利益	2,825,692	2		280,172	-	
8330 現金流量避險	-	-		97	-	
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	135,123	-		42,708	-	
8390 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益 (費用)	<u>43,239</u>	<u>-</u>		(<u>152</u>)	<u>-</u>	
8300 本期其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>5,907,807</u>	<u>4</u>		(<u>2,301,948</u>)	(<u>2</u>)	
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 45,443,350</u>	<u>34</u>		<u>\$ 31,080,988</u>	<u>30</u>	
本期淨利歸屬予						
8610 母公司業主	\$ 39,576,876	30		\$ 33,491,634	32	
8620 非控制權益	(<u>41,333</u>)	<u>-</u>		(<u>108,698</u>)	<u>-</u>	
	<u>\$ 39,535,543</u>	<u>30</u>		<u>\$ 33,382,936</u>	<u>32</u>	
本期綜合損益總額歸屬予						
8710 母公司業主	\$ 45,455,386	34		\$ 31,150,434	30	
8720 非控制權益	(<u>12,036</u>)	<u>-</u>		(<u>69,446</u>)	<u>-</u>	
	<u>\$ 45,443,350</u>	<u>34</u>		<u>\$ 31,080,988</u>	<u>30</u>	
每股盈餘 (附註三二)						
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 1.53</u>			<u>\$ 1.29</u>		
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.53</u>			<u>\$ 1.29</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣糖業股份有限公司

民國一〇二年三月三十一日

(僅限國內股東參考)

單位：除另予註明外，
為新台幣仟元

時 間	公 司								業 務 之 權 益					母 公 司 主 體		非 控 制 權 益		權 益 合 計
	普 通 股 發 行 股 本 股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	總 計	國 外 發 達 國 際 經 營 報 表 編 製 之 規 定 額	國 外 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	現 金 流 量 避 險	其 他 權 益 合 計	母 公 司 主 體 權 益 合 計	非 控 制 權 益	權 益 合 計	權 益 合 計	權 益 合 計	
一〇二年一月一日餘額	25,924,435	\$259,244,357	\$ 55,675,340	\$115,820,123	\$ 7,606,224	\$284,985,121	\$408,411,468	(\$ 10,753,806)	\$ 7,973,321	\$ -	(\$ 2,780,485)	\$270,550,680	\$ 2,543,226	\$723,093,906				
一〇二年一月一日至三月三十一日 淨利	-	-	-	-	-	39,576,876	39,576,876	-	-	-	-	-	39,576,876	(41,333)	39,535,543			
一〇二年一月一日至三月三十一日 稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	3,006,684	2,871,826	-	-	5,878,510	5,878,510	29,292	5,907,802			
一〇二年一月一日至三月三十一日 綜合損益總額	-	-	-	-	-	39,576,876	39,576,876	3,006,684	2,871,826	-	-	5,878,510	45,455,386	(12,036)	45,443,350			
員工行使認股權發行新股	3,797	37,970	69,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,354	-	107,354			
子公司員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,701	2,701			
採用權益法認列之關聯企業及合資 股權淨值之變動數	-	-	14,238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,238	-	14,238			
對於子公司持股比例變動之調整	-	-	3,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,610	(3,610)	-			
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,464)	(12,464)			
一〇二年三月三十一日餘額	25,928,232	\$259,282,327	\$ 55,762,572	\$115,820,123	\$ 7,606,224	\$324,561,997	\$447,988,344	(\$ 7,747,122)	\$ 10,845,147	\$ -	\$ 3,098,025	\$266,131,268	\$ 2,517,817	\$768,649,085				
一〇一年一月一日餘額	25,916,222	\$259,162,226	\$ 55,471,662	\$102,399,995	\$ 6,433,874	\$211,630,458	\$320,464,327	(\$ 6,433,364)	(\$ 1,172,762)	(\$ 93)	(\$ 7,606,219)	\$627,491,996	\$ 2,436,649	\$629,928,645				
一〇一年一月一日至三月三十一日 淨利	-	-	-	-	-	33,491,634	33,491,634	-	-	-	-	-	33,491,634	(108,698)	33,382,936			
一〇一年一月一日至三月三十一日 稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(2,630,808)	289,569	39	(2,341,200)	(2,341,200)	39,252	(2,301,948)				
一〇一年一月一日至三月三十一日 綜合損益總額	-	-	-	-	-	33,491,634	33,491,634	(2,630,808)	289,569	39	(2,341,200)	31,150,434	(69,446)	31,080,988				
員工行使認股權發行新股	4,382	43,820	92,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,204	-	136,204			
對於子公司持股比例變動之調整	-	-	29,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,006	(29,006)	-			
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,654	298,654			
一〇一年三月三十一日餘額	25,920,604	\$259,206,046	\$ 55,591,052	\$102,399,995	\$ 6,433,874	\$245,122,092	\$353,955,961	(\$ 9,064,172)	(\$ 883,191)	(\$ 54)	(\$ 9,247,419)	\$658,807,640	\$ 2,636,851	\$661,444,491				

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至三月三十一日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日	一 〇 二 年	一 〇 一 年
營業活動之現金流量：			
稅前淨利	\$ 45,747,914	\$ 35,673,054	
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用	35,964,677	27,477,221	
攤銷費用	531,513	528,186	
子公司員工認股權酬勞成本	2,701	-	
財務成本	493,998	217,691	
採用權益法認列之關聯企業及合資			
損益份額	(654,153)	(22,204)	
利息收入	(346,321)	(501,236)	
處分不動產、廠房及設備與無形資產			
淨損(益)	(28,710)	1,495	
不動產、廠房及設備減損損失	-	442,312	
金融資產減損損失	-	4,390	
處分備供出售金融資產淨益	(818,315)	(82,376)	
處分以成本衡量之金融資產淨			
損(益)	(2,105)	8,785	
處分關聯企業損失	484	-	
與關聯企業間之已實現利益	(3,540)	(74,029)	
外幣兌換淨損(益)	704,013	(1,688,863)	
獲配股票作價之收入	(8,565)	-	
備供出售金融資產之公允價值變動			
因避險有效而認列之損失	759,175	-	
與營業活動相關之資產／負債淨變動數			
衍生金融工具	9,946	60,998	
避險之衍生金融工具	(649,991)	-	
應收關係人款項	(80,495)	(461,550)	
應收票據及帳款淨額	(7,695,015)	(6,965,311)	
其他應收關係人款項	9,252	(33,996)	
存 貨	(2,967)	(2,918,568)	
其他流動資產	(541,426)	(987,853)	

(接次頁)

(承前頁)

	一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日	
	一 〇 二 年	一 〇 一 年
其他金融資產	\$ 66,064	\$ 57,572
應付帳款	(2,065,468)	2,731,635
應付關係人款項	69,794	(422,204)
應付薪資及獎金	(2,459,987)	(1,921,905)
應付員工紅利及董監酬勞	2,678,344	2,246,386
應付費用及其他流動負債	1,637,627	2,439,334
負債準備	306,904	363,996
應計退休金負債	(16,599)	(22,972)
營運產生之現金	73,608,749	56,149,988
支付所得稅	(39,077)	(48,354)
營業活動之淨現金流入	<u>73,569,672</u>	<u>56,101,634</u>

投資活動之現金流量：

取得備供出售金融資產	(4,022)	(1,477)
取得以成本衡量之金融資產	(16,511)	-
持有至到期日金融資產領回	3,091,725	594,140
處分備供出售金融資產價款	915,865	89,733
處分以成本衡量之金融資產價款	9,564	45,053
收取之利息	315,163	491,549
購置不動產、廠房及設備	(80,418,491)	(48,570,613)
購置無形資產	(951,989)	(403,491)
取得其他資產	(11,896)	(6,987)
處分不動產、廠房及設備價款	12,531	13,155
存出保證金增加	(5,693)	(35,623)
存出保證金收回	30,841	26,979
投資活動之淨現金流出	<u>(77,032,913)</u>	<u>(47,757,582)</u>

籌資活動之現金流量：

發行公司債	45,000,000	17,000,000
償還公司債	-	(4,500,000)
短期借款增加	230,321	9,452,100
償還長期借款	(31,250)	-
償還其他長期應付款	-	(1,434,277)
支付利息	(331,695)	(235,441)
收取存入保證金	3,436	7,544
存入保證金返還	(26,382)	(45,933)
應付租賃款減少	-	(81,995)
員工行使認股權發行新股	107,354	136,204
非控制權益增加(減少)	(12,464)	298,654
籌資活動之淨現金流入	<u>44,939,320</u>	<u>20,596,856</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一月一日至三月三十一日 一〇二年	一月一日至三月三十一日 一〇一年
匯率變動對現金及約當現金之影響	\$ 1,142,131	(\$ 1,593,246)
本期現金及約當現金淨增加數	42,618,210	27,347,662
期初現金及約當現金餘額	<u>143,410,588</u>	<u>143,472,277</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$186,028,798</u>	<u>\$170,819,939</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 樹 傑

黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 二 月 五 日

代碼	資產	一〇〇一年十二月三十一日		一〇〇〇年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	一〇〇一年十二月三十一日		一〇〇〇年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 109,150,810	12	\$ 85,262,521	11	2100	短期借款(附註十四)	\$ 34,714,929	4	\$ 25,926,528	3
1310	公平價值變動列入損益之金融資產(附註二、五及二三)	38,824	-	14,925	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債(附註二、五及二三)	6,274	-	-	-
1320	備供出售金融資產(附註二、六及二三)	1,845,052	-	2,617,134	-	2140	應付帳款	13,392,221	1	9,522,688	1
1330	持有至到期日金融資產(附註二、七及二三)	701,146	-	701,136	-	2150	應付關係人款項(附註二四)	3,230,342	-	2,992,582	-
1150	應收關係人款項(附註三及二四)	40,987,444	4	24,777,534	3	2160	應付所得稅(附註二及十七)	15,196,399	2	10,647,797	1
1143	應收票據及帳款(附註三)	15,726,431	2	19,894,386	3	2219	應付員工福利及董事酬勞(附註十九)	11,186,591	1	9,055,704	1
1149	備抵呆帳(附註二、三及八)	(474,037)	-	(485,120)	-	2224	應付工程及設備款	44,371,108	5	33,811,970	5
1148	備抵退貨及折讓(附註二及八)	(5,732,738)	(1)	(4,887,879)	-	2170	應付費用及其他流動負債(附註二三)	16,698,014	2	13,057,161	2
1180	其他應收關係人款項(附註三及二四)	274,963	-	188,028	-	2271	一年內到期之應付公司債(附註十五及二三)	-	-	4,500,000	1
1190	其他金融資產	175,261	-	122,010	-	21XX	流動負債合計	138,795,878	15	109,514,430	14
1210	存貨(附註二及九)	35,296,391	4	22,853,397	3		長期負債				
1286	遞延所得稅資產(附註二及十七)	7,728,464	1	5,779,544	1	2410	應付公司債(附註十五及二三)	80,000,000	9	18,000,000	2
1298	預付費用及其他流動資產	2,097,329	-	1,275,236	-	2440	其他長期應付款(附註二三)	54,000	-	-	-
11XX	流動資產合計	207,815,340	22	158,563,352	21	24XX	長期負債合計	80,054,000	9	18,000,000	2
	長期投資(附註二、七、十、十一及二三)						其他負債				
1421	採權益法之長期股權投資	139,264,161	15	128,200,718	17	2810	應計退休金負債(附註二及十六)	3,926,276	-	3,860,898	1
1460	持有至到期日金融資產	-	-	702,291	-	2820	存入保證金	199,315	-	439,032	-
1480	以成本衡量之金融資產	483,759	-	497,835	-	28XX	其他負債合計	4,125,591	-	4,299,930	1
14XX	長期投資合計	139,747,920	15	129,400,844	17	2XXX	負債合計	222,975,469	24	131,814,360	17
	固定資產(附註二、十二及二四)						股本(附註十九)				
1521	成本					3110	普通股股本—每股面額10元				
1531	建築物	173,344,932	18	149,495,478	20		額定—28,050,000 仟股				
1531	機器設備	1,202,761,097	127	984,978,666	129		發行—一〇一年 25,924,435 仟股				
1561	辦公設備	16,683,484	2	13,824,434	2		一〇〇年 25,916,222 仟股	259,244,357	27	259,162,226	34
15X1		1,392,789,513	147	1,148,298,578	151		資本公積(附註二及十九)	56,137,809	6	55,846,357	8
15X9	累積折舊	(924,961,566)	(98)	(804,740,797)	(106)	32XX	保留盈餘(附註十九)				
1670	預付款項及未完工程	118,275,347	13	110,815,252	14	3310	法定盈餘公積	115,820,123	12	102,399,995	13
15XX	固定資產淨額	586,603,294	62	454,373,533	59	3320	特別盈餘公積	7,606,224	1	6,433,874	1
	無形資產					3350	未分配盈餘	287,174,942	30	213,357,286	28
1760	商譽(附註二)	1,567,756	-	1,567,756	-	33XX	保留盈餘合計	410,601,289	43	322,191,155	42
1780	遞延價項—淨額(附註二及十三)	4,882,081	1	4,719,244	1		股東權益其他項目				
17XX	無形資產合計	6,449,837	1	6,287,000	1	3420	累積核算調整數(附註二)	(10,753,763)	(1)	(6,433,369)	(1)
	其他資產					3430	未認列為退休金成本之淨損失	(5,299)	-	-	-
1820	存出保證金	2,394,826	-	4,491,735	1	3450	金融商品未實現損益(附註二及二三)	7,973,321	1	(1,172,855)	-
1860	遞延所得稅資產(附註二及十七)	2,244,947	-	7,221,824	1	34XX	股東權益其他項目合計	(2,785,241)	-	(7,606,224)	(1)
1880	其他(附註二及二四)	917,019	-	1,069,586	-	3XXX	股東權益合計	723,197,714	76	629,593,514	83
18XX	其他資產合計	5,556,792	-	12,783,145	2		負債及股東權益總計	\$ 946,173,183	100	\$ 761,407,874	100
1XXX	資產總計	\$ 946,173,183	100	\$ 761,407,874	100						

後附之附註係本財務報表之一部分。

台灣積體電路製造股份有限公司

報 告 書

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度	一〇〇年度
	金額 %	金額 %
4110 銷貨收入總額（附註二及二四）	\$506,697,738	\$421,472,087
4170 銷貨退回及折讓（附註二及八）	<u>6,825,851</u>	<u>3,226,594</u>
4100 銷貨收入淨額	499,871,887 100	418,245,493 100
5110 銷貨成本（附註九、十八及二四）	<u>265,538,540</u> 53	<u>233,083,068</u> 56
5910 調整前銷貨毛利	234,333,347 47	185,162,425 44
5920 關聯企業間已（未）實現銷貨毛利（附註二）	(<u>25,029</u>) -	<u>398,440</u> -
銷貨毛利	<u>234,308,318</u> 47	<u>185,560,865</u> 44
營業費用（附註十八及二四）		
6300 研究發展費用	38,788,245 8	31,594,034 7
6200 管理費用	16,330,060 3	12,715,339 3
6100 行銷費用	<u>2,388,243</u> -	<u>2,345,729</u> 1
6000 合計	<u>57,506,548</u> 11	<u>46,655,102</u> 11
6900 營業利益	<u>176,801,770</u> 36	<u>138,905,763</u> 33
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益（附註二及十）	8,127,748 2	3,778,083 1
7480 和解賠償收入（附註二六）	883,845 -	947,340 1
7110 利息收入	867,227 -	697,196 -

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一 〇 一 年 度			一 〇 〇 年 度		
		金	額	%	金	額	%
7480	技術服務收入 (附註二四)	\$	497,638	-	\$	408,153	-
7310	金融商品評價淨益 (附註二、五及二三)		-	-		801,195	-
7480	其他收入 (附註二及二四)		811,619	-		655,079	-
7100	合 計		<u>11,188,077</u>	<u>2</u>		<u>7,287,046</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失							
7630	金融資產減損損失 (附註二、六及二三)		2,677,529	1		-	-
7510	利息費用 (附註二四)		945,114	-		445,887	-
7630	閒置資產減損損失 (附註二)		418,330	-		-	-
7530	處分固定資產損失 (附註二及二四)		146,647	-		202,901	-
7560	兌換淨損 (附註二)		-	-		673,085	-
7880	其他損失 (附註二)		172,279	-		163,092	-
7500	合 計		<u>4,359,899</u>	<u>1</u>		<u>1,484,965</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益		183,629,948	37		144,707,844	35
8110	所得稅費用 (附註二及十七)		<u>17,471,146</u>	<u>4</u>		<u>10,506,565</u>	<u>3</u>
9600	本年度淨利		<u>\$ 166,158,802</u>	<u>33</u>		<u>\$ 134,201,279</u>	<u>32</u>
每股盈餘 (附註二二)							
9750	基本每股盈餘	\$	<u>7.08</u>	<u>\$ 6.41</u>	\$	<u>5.58</u>	<u>\$ 5.18</u>
9850	稀釋每股盈餘	\$	<u>7.08</u>	<u>\$ 6.41</u>	\$	<u>5.58</u>	<u>\$ 5.18</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣水泥股份有限公司
民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

	普通股發行股本			盈餘				其他項目				
	股數(仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘合計	累積損其調整數	未認列為退休基金成本之淨損失	金融商品未實現損益	庫藏股票	股東權益合計
一〇〇年一月一日餘額	25,910,078	\$ 259,100,787	\$ 55,698,434	\$ 86,239,494	\$ 1,313,047	\$ 178,227,030	\$ 265,779,571	(\$ 6,543,163)	\$ -	\$ 109,289	\$ -	\$ 574,144,918
盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	16,160,501	-	(16,160,501)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	5,120,827	(5,120,827)	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,730,236)	(77,730,236)	-	-	-	-	(77,730,236)
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	134,201,279	134,201,279	-	-	-	-	134,201,279
採權益法認列被投資公司權益變動之調整	-	-	59,898	-	-	-	-	-	-	-	-	59,898
累積損其調整數	-	-	-	-	-	-	-	(112,326)	-	-	-	(112,326)
員工行使認股權發行新股	7,144	71,439	146,258	-	-	-	-	-	-	-	-	217,697
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,112,995)	-	-	(1,112,995)
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(165,851)	-	-	(165,851)
庫藏股票買回—股東執行股份收買請求權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,598)	(71,598)	(71,598)
庫藏股票減損	(1,000)	(10,000)	(2,139)	-	-	(59,459)	(59,459)	-	-	-	71,598	-
分割事業影響數	-	-	(56,094)	-	-	-	-	222,120	-	(3,298)	-	162,728
一〇〇年十二月三十一日餘額	25,916,222	259,162,226	55,846,357	102,399,995	6,433,874	213,357,286	322,191,155	(6,433,369)	-	(1,172,855)	-	629,593,514
盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	13,420,128	-	(13,420,128)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,172,350	(1,172,350)	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,748,668)	(77,748,668)	-	-	-	-	(77,748,668)
一〇一年度淨利	-	-	-	-	-	166,158,802	166,158,802	-	-	-	-	166,158,802
採權益法認列被投資公司權益變動之調整	-	-	131,095	-	-	-	-	-	-	-	-	131,095
累積損其調整數	-	-	-	-	-	-	-	(4,320,394)	-	-	-	(4,320,394)
員工行使認股權發行新股	8,213	82,131	160,357	-	-	-	-	-	-	-	-	242,488
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,347	-	1,998,347
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,299)	7,147,829	-	7,142,530
一〇一年十二月三十一日餘額	25,924,435	\$ 259,244,357	\$ 56,137,809	\$ 115,820,123	\$ 7,606,224	\$ 267,179,942	\$ 410,601,289	(\$ 10,753,763)	(\$ 5,299)	\$ 7,973,321	\$ -	\$ 723,197,714

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：		
本年度淨利	\$ 166,158,802	\$ 134,201,279
調整項目		
折舊及攤銷	124,399,879	102,925,423
關聯企業間未（已）實現銷貨毛利	25,029	(398,440)
金融資產折溢價攤銷數	2,281	9,860
處分備供出售金融資產利益	(110,634)	(35,151)
處分以成本衡量之金融資產損失	269	-
採權益法認列之投資淨益	(8,127,748)	(3,778,083)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	1,688,878	2,941,548
處分固定資產及其他資產淨損	125,488	99,884
金融資產減損損失	2,677,529	-
閒置資產減損損失	418,330	-
遞延所得稅	2,618,657	(493,026)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(17,625)	(22,759)
應收關係人款項	(16,209,910)	956,440
應收票據及帳款	4,167,955	2,356,519
備抵呆帳	(11,083)	(2,880)
備抵退貨及折讓	844,859	(2,453,565)
其他應收關係人款項	(89,347)	(38,049)
其他金融資產	(53,251)	138,196
存貨	(12,442,994)	2,775,646
預付費用及其他流動資產	(371,593)	(382,852)
應付帳款	1,361,012	(1,805,422)
應付關係人款項	(67,770)	418,132
應付所得稅	4,548,602	3,538,928
應付員工紅利及董事酬勞	2,130,887	(1,903,765)
應付費用及其他流動負債	3,556,824	(410,047)
應計退休金負債	65,378	96,880
營業活動之淨現金流入	<u>277,288,704</u>	<u>238,734,696</u>
投資活動之現金流量：		
分割事業現金支付數	-	(1,270,340)
購置固定資產	(242,063,668)	(202,757,541)
採權益法之長期股權投資增加	(2,259,244)	(7,390,883)

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
購買以成本衡量之金融資產	(\$ 1,093)	\$ -
被投資公司減資退回股款	587,902	320,013
處分備供出售金融資產價款	612,834	1,035,151
持有至到期日金融資產領回	700,000	4,789,000
處分以成本衡量之金融資產價款	14,900	-
處分固定資產及其他資產價款	93,984	4,650,078
遞延借項增加	(1,743,043)	(1,658,296)
存出保證金減少	2,096,909	4,147,014
其他資產減少	17,600	27,600
投資活動之淨現金流出	(241,942,919)	(198,108,204)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	8,788,401	(4,982,109)
現金股利	(77,748,668)	(77,730,236)
發行公司債	62,000,000	18,000,000
償還公司債	(4,500,000)	-
存入保證金減少	(239,717)	(308,855)
員工行使認股權發行新股	242,488	217,697
買回庫藏股票	-	(71,598)
融資活動之淨現金流出	(11,457,496)	(64,875,101)
現金及約當現金淨增加(減少)數	23,888,289	(24,248,609)
年初現金及約當現金餘額	85,262,521	109,511,130
年底現金及約當現金餘額	\$ 109,150,810	\$ 85,262,521
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 670,165	\$ 369,085
支付所得稅	\$ 10,312,114	\$ 7,454,386
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 255,108,068	\$ 195,932,728
應付工程及設備款減少(增加)	(12,764,075)	6,827,106
應付關係人款項增加	(280,256)	-
換出資產抵減價款	(69)	(2,293)
支付現金金額	\$ 242,063,668	\$ 202,757,541
處分固定資產及其他資產價款	\$ 91,641	\$ 3,370,165
其他應收關係人款項減少	2,412	1,124,206
其他金融資產款項減少	-	158,000
換出資產抵減價款	(69)	(2,293)
取得現金金額	\$ 93,984	\$ 4,650,078

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
購置遞延借項償款	\$ 2,184,901	\$ 1,658,296
應付帳款增加	(303,584)	-
應付關係人款項增加	(25,274)	-
其他長期應付款增加	(113,000)	-
支付現金金額	<u>\$ 1,743,043</u>	<u>\$ 1,658,296</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
固定資產轉列閒置資產	<u>\$ 418,330</u>	<u>\$ -</u>
一年內到期之其他長期應付款（帳列應付費 用及其他流動負債）	<u>\$ 59,000</u>	<u>\$ -</u>
一年內到期之應付公司債	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,500,000</u>

分割事業之補充揭露資訊

本公司於一〇〇年八月將固態照明事業及太陽能事業之相關營業分別分割轉讓與新設且持股 100% 之台積固態照明股份有限公司（台積固態照明公司）及台積太陽能股份有限公司（台積太陽能公司），分割之相關資訊如下：

	台積固態照明公司	台積太陽能公司	合 計
取得對該公司長期股權投資	<u>\$ 2,270,000</u>	<u>\$ 11,180,000</u>	<u>\$ 13,450,000</u>
分割轉讓之非現金項目			
流動資產	36,050	18,807	54,857
長期投資	2,872	7,912,710	7,915,582
固定資產	1,929,563	2,372,214	4,301,777
其他資產	234,696	201,677	436,373
流動負債	(292,728)	(337,439)	(630,167)
其他負債	(36,272)	(25,218)	(61,490)
資本公積	-	(56,094)	(56,094)
金融商品未實現損益	-	(3,298)	(3,298)
累積換算調整數	256	221,864	222,120
	<u>(1,874,437)</u>	<u>(10,305,223)</u>	<u>(12,179,660)</u>
支付分割事業現金數	<u>\$ 395,563</u>	<u>\$ 874,777</u>	<u>\$ 1,270,340</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

會計師 黃 樹 傑

林 鴻 鵬



黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 二 月 十 四 日



圖附光附註係本財報補充之一部分。



台灣積體電路股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年度	九十九年度
	金額 %	金額 %
4110 銷貨收入總額（附註二及二五）	\$ 421,472,087	\$ 418,666,448
4170 銷貨退回及折讓（附註二及八）	<u>3,226,594</u>	<u>11,703,136</u>
4100 銷貨收入淨額	418,245,493 100	406,963,312 100
5110 銷貨成本（附註九、十九及二五）	<u>233,083,068</u> 56	<u>209,921,268</u> 52
5910 銷貨毛利	185,162,425 44	197,042,044 48
5930 聯屬公司間已（未）實現銷貨毛利（附註二）	<u>398,440</u> -	<u>(52,742)</u> -
已實現銷貨毛利	<u>185,560,865</u> 44	<u>196,989,302</u> 48
營業費用（附註十九及二五）		
6300 研究發展費用	31,594,034 7	27,623,299 7
6200 管理費用	12,715,339 3	11,681,756 3
6100 行銷費用	<u>2,345,729</u> 1	<u>2,837,739</u> -
6000 合計	<u>46,655,102</u> 11	<u>42,142,794</u> 10
6900 營業利益	<u>138,905,763</u> 33	<u>154,846,508</u> 38
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益（附註二及十）	3,778,083 1	7,111,443 2
7480 和解賠償收入（附註二八）	947,340 1	6,939,764 2

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一〇〇年度			九十九年度		
		金	額	%	金	額	%
7310	金融商品評價淨益（附註二、五及二四）	\$	801,195	-	\$	312,862	-
7110	利息收入		697,196	-		764,027	-
7480	技術服務收入（附註二五）		408,153	-		446,746	-
7480	其他收入（附註二及二五）		<u>655,079</u>	-		<u>333,126</u>	-
7100	合計		<u>7,287,046</u>	<u>2</u>		<u>15,907,968</u>	<u>4</u>
營業外費用及損失							
7560	兌換淨損（附註二）		673,085	-		58,737	-
7510	利息費用（附註二五）		445,887	-		214,641	-
7530	處分固定資產損失（附註二）		202,901	-		838,750	-
7880	災害損失（附註九）		-	-		190,992	-
7880	其他損失		<u>163,092</u>	-		<u>161,152</u>	-
7500	合計		<u>1,484,965</u>	-		<u>1,464,272</u>	-
7900	稅前利益		144,707,844	35		169,290,204	42
8110	所得稅費用（附註二及十八）		<u>10,506,565</u>	<u>3</u>		<u>7,685,195</u>	<u>2</u>
9600	本年度淨利		<u>\$ 134,201,279</u>	<u>32</u>		<u>\$ 161,605,009</u>	<u>40</u>
每股盈餘（附註二三）							
9750	基本每股盈餘		<u>\$ 5.58</u>	<u>\$ 5.18</u>		<u>\$ 6.53</u>	<u>\$ 6.24</u>
9850	稀釋每股盈餘		<u>\$ 5.58</u>	<u>\$ 5.18</u>		<u>\$ 6.53</u>	<u>\$ 6.23</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



台灣積體電子股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

	實收資本 股數(仟股)	資本公積 金額	資本公積 金額	法定盈餘公積 金額	特別盈餘公積 金額	未分配盈餘 金額	保留盈餘合計 金額	累積虧損調整數 (金額)	金融商品未實現損益 金額	庫藏股票 金額	股東權益合計 金額
九十九年一月一日餘額	25,902,706	\$259,027,066	\$55,486,010	\$77,317,710	\$-	\$104,564,972	\$181,882,682	(\$ 1,766,667)	\$ 453,621	\$-	\$495,082,712
盈餘分配	-	-	-	8,921,784	-	(8,921,784)	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	1,313,047	(1,313,047)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(77,708,120)	(77,708,120)	-	-	-	(77,708,120)
現金股利-每股3.00元	-	-	-	-	-	161,605,009	161,605,009	-	-	-	161,605,009
九十九年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採權益法認列被投資公司盈餘淨值之調整	-	-	(17,885)	-	-	-	-	-	-	-	(17,885)
累積損益調整數	-	-	-	-	-	-	-	(4,776,496)	-	-	(4,776,496)
員工行使認股權發行新股	7,372	73,724	171,103	-	-	-	-	-	-	-	244,824
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(441,978)	-	(441,978)
採權益法認列被投資公司盈餘淨值之淨變動	-	-	59,206	-	-	-	-	-	97,646	-	156,852
九十九年十二月三十一日餘額	25,910,078	\$259,100,787	\$55,698,434	\$86,239,494	\$1,313,047	\$178,227,030	\$265,779,571	(6,543,163)	\$109,289	\$-	\$574,144,918
盈餘分配	-	-	-	16,160,501	-	(16,160,501)	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	5,120,827	(5,120,827)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(77,730,236)	(77,730,236)	-	-	-	(77,730,236)
現金股利-每股3.00元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	134,201,279	134,201,279	-	-	-	134,201,279
採權益法認列被投資公司盈餘淨值之調整	-	-	59,898	-	-	-	-	-	-	-	59,898
累積損益調整數	-	-	-	-	-	-	-	(112,326)	-	-	(112,326)
員工行使認股權發行新股	7,144	71,439	146,258	-	-	-	-	-	-	-	217,697
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,112,995)	-	(1,112,995)
採權益法認列被投資公司盈餘淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(165,851)	-	(165,851)
庫藏股票買回-股東執行股份收買請求權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,598)	(71,598)
庫藏股票註銷	(1,000)	(10,000)	(2,439)	-	-	(59,459)	(59,459)	-	-	71,598	-
分別事業新幣數	-	-	(56,024)	-	-	-	-	222,120	(3,298)	-	162,728
一〇〇年十二月三十一日餘額	25,916,222	\$259,162,220	\$55,846,337	\$102,359,995	\$6,433,874	\$213,357,286	\$322,191,155	(\$ 6,430,362)	(\$ 1,472,855)	\$-	\$629,393,514

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張志雄



經理人：何麗梅



會計主管：周嘉鑫



台灣積體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量：		
本年度淨利	\$134,201,279	\$161,605,009
調整項目		
折舊及攤銷	102,925,423	83,366,121
聯屬公司間未（已）實現銷貨毛利	(398,440)	52,742
金融資產折溢價攤銷數	9,860	18,611
處分備供出售金融資產淨益	(35,151)	-
處分以成本衡量之金融資產損失	-	1,263
採權益法認列之投資淨益	(3,778,083)	(7,111,443)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	2,941,548	422,490
處分固定資產及其他資產淨損	99,884	761,298
獲配股票作價賠償收入	-	(4,434,364)
遞延所得稅	(493,026)	(373,253)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(22,759)	189,577
應收關係人款項	956,440	(3,192,201)
應收票據及帳款	2,356,519	(2,366,385)
備抵呆帳	(2,880)	57,000
備抵退貨及折讓	(2,453,565)	(1,242,188)
其他應收關係人款項	(38,049)	85,830
其他金融資產	138,196	904,157
存貨	2,775,646	(6,816,132)
預付費用及其他流動資產	(382,852)	(445,797)
應付帳款	(1,805,422)	624,608
應付關係人款項	418,132	535,108
應付所得稅	3,538,928	(1,652,251)
應付員工紅利及董事酬勞	(1,903,765)	4,188,131
應付費用及其他流動負債	(410,047)	(3,124,307)
應計退休金負債	96,880	17,425
遞延貸項	-	(47,873)
營業活動之淨現金流入	<u>238,734,696</u>	<u>222,023,176</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
投資活動之現金流量：		
分割事業現金支付數	(\$ 1,270,340)	\$ -
購置固定資產	(202,757,541)	(182,335,032)
採權益法之長期股權投資增加	(7,390,883)	(8,262,519)
購買以成本衡量之金融資產	-	(480)
處分備供出售金融資產價款	1,035,151	-
持有至到期日金融資產領回	4,789,000	15,943,000
處分以成本衡量之金融資產價款	-	3,370
被投資公司減資退回股款	320,013	-
處分固定資產及其他資產價款	4,650,078	387,735
遞延借項增加	(1,658,296)	(1,538,301)
存出保證金減少(增加)	4,147,014	(5,940,633)
其他資產減少(增加)	27,600	(1,004,581)
投資活動之淨現金流出	(198,108,204)	(182,747,441)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(4,982,109)	30,908,637
發行公司債	18,000,000	-
存入保證金減少	(308,855)	(253,489)
員工行使認股權發行新股	217,697	244,824
買回庫藏股票	(71,598)	-
發放現金股利	(77,730,236)	(77,708,120)
融資活動之淨現金流出	(64,875,101)	(46,808,148)
現金及約當現金淨減少數	(24,248,609)	(7,532,413)
年初現金及約當現金餘額	109,511,130	117,043,543
年底現金及約當現金餘額	\$ 85,262,521	\$109,511,130
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 369,085	\$ 200,892
支付所得稅	\$ 7,454,386	\$ 9,640,396
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$195,932,728	\$195,950,918
應付工程及設備款減少(增加)	6,827,106	(13,491,140)
換出資產抵減價款	(2,293)	(124,746)
支付現金金額	\$202,757,541	\$182,335,032

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
處分固定資產及其他資產價款	\$ 3,370,165	\$ 1,872,880
其他應收關係人款項減少(增加)	1,124,206	(1,142,108)
其他金融資產款項減少(增加)	158,000	(218,291)
換出資產抵減價款	(2,293)	(124,746)
取得現金金額	\$ 4,650,078	\$ 387,735
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之應付公司債	\$ 4,500,000	\$ -
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費用及其他流動負債)	\$ -	\$ 718,637

分割事業之補充揭露資訊

本公司於一〇〇年八月將固態照明事業及太陽能事業之相關營業分別分割轉讓與新設且持股 100%之台積固態照明股份有限公司(台積固態照明公司)及台積太陽能股份有限公司(台積太陽能公司)，分割之相關資訊如下：

	台積固態照明公司	台積太陽能公司	合計
取得對該公司長期股權投資	\$ 2,270,000	\$ 11,180,000	\$ 13,450,000
分割轉讓之非現金項目			
流動資產	36,050	18,807	54,857
長期投資	2,872	7,912,710	7,915,582
固定資產	1,929,563	2,372,214	4,301,777
其他資產	234,696	201,677	436,373
流動負債	(292,728)	(337,439)	(630,167)
其他負債	(36,272)	(25,218)	(61,490)
資本公積	-	(56,094)	(56,094)
金融商品未實現損益	-	(3,298)	(3,298)
累積換算調整數	256	221,864	222,120
	(1,874,437)	(10,305,223)	(12,179,660)
支付分割事業現金數	\$ 395,563	\$ 874,777	\$ 1,270,340

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



2013 年 7 月 15 日

中華信用評等股份有限公司

台北市 11049 信義路五段 7 號 49 樓

發文字號：(一〇二)信評字第 223 號
台灣積體電路製造股份有限公司

主旨：台灣積體電路製造股份有限公司 102 年度第 3 期無擔保普通公司債信用評等結果如說明

中華信用評等公司（以下簡稱「中華信評」）依據貴公司之要求對以上所提之台灣積體電路製造股份有限公司 102 年度第 3 期無擔保普通公司債授予「twAAA」長期債務發行信用評等。

債券種類 無擔保普通公司債
金額 上限新台幣 125 億元
評等 twAAA

本封信函代表中華信評同意貴公司可依適用之法律與規定，向相關機構與個人傳達以上評等結果。惟關於此傳達評等結果之許可（不包括對受到適當保密協議約束之專業顧問的傳達），僅在中華信評已將評等結果公布於 www.taiwanratings.com/tw 網站上後始正式生效。任何由貴公司或貴公司委任機構於任何網站上的評等結果傳達必須包括該評等結果的完整評等報告，並包括所有的評等結果更新（如適用）。

為維持此評等，中華信評必須收到中華信評評等服務評等條款和條件中所指的所有資訊。貴公司瞭解，中華信評的信用評等監視過程，有賴貴公司、貴公司委任機構，或貴公司顧問所提供與評等有關資訊的正確性、及時性與完整性，以及持續提供重要資訊。請將所有資訊以電子檔案型式傳送至：
raymond.hsu@taiwanratings.com.tw。任何無法以電子檔案型式或未被張貼於適當網站之資訊，請將紙本寄送至：台北市 110 信義區信義路五段 7 號台北 101 大樓 49 樓 A 室，中華信用評等公司，轉：企業評等部。

本評等結果受以下所附之中華信評評等服務評等條款和條件之規範。

中華信評很高興有機會為貴公司提供評等意見。欲取得更多訊息，請參考中華信評網站 www.taiwanratings.com/tw。若貴公司有任何問題，請與中華信評聯絡。感謝貴公司選擇中華信評。

順頌商祺

中華信用評等公司
評等分析聯絡人
姓名：許智清



中華信評評等服務
評等條款和條件

貴公司了解並同意：

總則。中華信評評等服務（下稱“本評等服務”）的評等和其他觀點是意見的表達，而非對事實的陳述。評等並非推薦任何人購買、持有或出售任何證券的建議，亦非對任何證券的市場價格、適銷性、投資者偏好或適用性的評論。本評等服務的評等和其他觀點是根據發行體及其代理人和顧問提供的資料，以及本評等服務從其認為可靠的管道而得的其他資料所作出，但本評等服務並不會對所獲得之任何資料進行審查，也未負有必須對其進行盡職調查或獨立核證的責任。這類資料和本評等服務的觀點不應為作出任何投資決策的依據。本評等服務並未扮演“受託人”或投資顧問的角色。本評等服務現在或是將來都不會就某一發行體如何能夠或應當達到某一特定評等結果提出意見，且不論現在或將來，也都不會提供諮詢、顧問、財務和結構化方面的建議。

所有評等行動係依本評等服務之獨立判斷所為。在任何時候，本評等服務可獨立判斷決定授予、調升、調降、擱置或撤銷評等、或把評等列入信用觀察名單，以及授予或調整評等展望。儘管發行體可以要求進行保密或非公開評等或撤銷評等或終止本協議，但本評等服務仍可以採取上述行動。本評等服務不會將某一公開評等轉換為保密或非公開評等，亦不會將非公開評等轉換為保密評等。

發佈。除非貴公司在首次評等時明確要求以保密或非公開的形式授予和維持評等，否則本評等服務將保留使用、公佈、散播或授予其他方使用、公佈或散播評等和任何分析報告（包括評等理由）的權利。但是，假若保密或非公開評等或是既存之保密或非公開評等經由本評等服務或其聯屬企業以外之第三者的披露而公開，則本評等服務保留將該評等視為公開評等的權利，包括但不限於發佈該評等及任何相關分析報告。本評等服務發佈的任何分析報告並非是由貴公司、或代表貴公司、或應貴公司要求而發佈的。即使本文有任何與此相反的條款，但本評等服務將保留使用、公佈、散播，或授權其他方使用、公佈或散播已經撤銷的公開評等有關於分析報告的權利，不論撤銷的原因為何。本評等服務隨時都有可能公佈評等準則的釋義，且本協議對本評等服務日後認為有需要時必須修改或修訂其評等準則的能力，並不構成任何限制。

貴公司提供的資料。在本協議有效期內，貴公司保證將向本評等服務提供、或即刻促請他人提供，所有本評等服務根據適用的公開評等準則要求提供的所有資料。本評等服務對從貴公司或貴公司代理人或顧問獲得之資料的判斷，可能會影響評等

和評等的維護。除了下文定義的“除外資訊”，貴公司進一步保證由貴公司或貴公司代理人或顧問向本評等服務提供之與評等或評等監視（如適用）相關的所有資料，為截至提供當日的最新資訊，且該所有資料沒有對重要事實的錯誤陳述，亦未遺漏任何必要之關鍵事實，從而保證此類資料不具誤導性。”除外資訊”是指貴公司根據本項第一句促請其代理人或顧問提供的資訊，該代理人或顧問在向本評等服務提供的書面資料中，同意依本項做出保證，以及在違反此類保證時對本評等服務承擔的責任，與貴公司直接向本評等服務提供資訊的責任一致。實質違反本項的擔保保證將構成本協議的一種實質性違約情況。根據適用法律允許的範圍，貴公司應對本評等服務及其聯屬企業就下列情況導致之所有虧損、賠償、債務、審判結果、成本、支出和費用（包括合理的律師費）（總稱“損失”）負責，這些損失情況包括：

（1）在貴公司作為一方參與的訴訟程序中，由管轄法院最終裁判係直接肇因於實質違反本項之保證而實際發生的損失，或（2）在貴公司作為一方參與的訴訟程序中，由管轄法院最終裁判係直接肇因於貴公司或貴公司代理人或顧問向本評等服務提供之資訊侵犯或違反第三方智慧財產權而實際發生的損失；但若在貴公司作為一方參與的訴訟程中，管轄法院最終裁判該損失係源於本評等服務之疏忽、故意的不法行為或有意之不當行為，則為例外情況。為了避免產生疑義，損失可以包括本評等服務在相關訴訟之前實際發生的損失，但以第三方針對本評等服務提出的索賠要求，且經管轄法院最終裁判其係直接源自於實質違反本項之保證規定者（如上述（1）條款）為範圍。

保密資料。就本協議而言，“保密資料”指貴公司或貴公司代理人或顧問向本評等服務提供、標示為“保密”或（在此類資料披露之前或之後即刻）以書面形式知會本評等服務為“保密”的書面或口頭資料。儘管有此規定，如屬以下情況，貴公司或貴公司代理人或顧問所披露的資料將不被視為“保密資料”，本評等服務也無責任把該等資料以“保密資料”處理：（1）在資料披露當時，本評等服務或其聯屬企業已實質上知悉該等資料，且本評等服務並不知道該資料不得對外披露；（2）在資料披露當時，公眾已知悉該等資料；（3）在資料披露之後，公眾經由第三者（並非因為中華信評或其聯屬企業的緣故）知悉該等資料；（4）第三方在此類資料披露後向本評等服務或其聯屬企業披露，且本評等服務或其聯屬企業合理相信該第三方向本評等服務或其聯屬企業的此類披露行為並未受到禁止；（5）該資料係由本評等服務或其聯屬企業獨立產生，事前並未參考“保密資料”；（6）獲貴公司書面確認可向大眾披露該等資料，或（7）法律或監管規定該等資料必須由本評等服務或其聯屬企業予以披露。本評等服務瞭解中華民國證券法規可能規定在掌握實質性和非公開信息時禁止證券交易，且已採取了相應的證券交易和溝通政策。

本評等服務對資料的使用。除非另有規定，本評等服務不得向第三方披露保密資料。本評等服務可以（1）使用保密資料授予、調升、調降、擱置或撤銷評等、把評等列入信用觀察名單，以及授予或調整評等展望；以及（2）與參與評等業務但遵守適當保密義務的聯屬企業分享保密資料；在上述情況下，根據此限制性條款，

本評等服務及此類聯屬企業可以發佈由保密資料得出的資訊。本評等服務也可以根據其政策和適用法律和監管規定，或取得發行體或其代理人的同意，與參與評等或其他金融服務業務、且遵守適當保密義務的聯屬企業或代理人（下稱“相關聯屬企業和代理人”），基於建模、基準化和研究等目的而使用與分享保密資料；在上述情況下，根據此限制性條款，本評等服務及此類聯屬企業可以發佈由保密資料得出的資訊。關於並未以保密或非公開形式維護的資產證券化評等，本評等服務可以發佈以保密資料彙總得出的資料（下稱“相關資料”），但不包括特定及確定個別債務人之資料，且可與任何相關聯屬企業和代理人分享此類保密資料以向市場發佈相關資料。貴公司確認，盡貴公司所知，此類發佈不會違反貴公司對第三方的任何保密義務。本評等服務同意，貴公司有權尋求特定行為和禁令或其他平衡法的救濟，作為本評等服務違反本協議披露保密資料的補償。本評等服務及其聯屬企業保留使用、公佈、散播，或授予其他方使用、公佈或散播貴公司、貴公司代理人或顧問提供的任何非保密資料的權利。

本評等服務並非證券法所稱之專家、承銷商或賣方。本評等服務不同意且將來亦不會同意是任何適用證券法律或其他監管指導意見、規定或建議中所定義的“專家”或任何類似名稱，也不接受承擔與任何證券有關的任何募股說明書或上市說明之任何部分的責任或內容授權。本評等服務不是任何適用證券法律或其他監管指導意見、規定或建議中所定義的“承銷商”或“賣方”。本評等服務並不擔任與本協議有關的任何適用證券法律或其他監管指導意見、規定或建議中所定義的“承銷商”或“賣方”的相關角色或任務。

本評等服務對保密和非公開評等的使用。本評等服務可以在分析抵押債務債券（CDO）和其他投資工具發行的債務中使用保密和非公開評等。本評等服務可以用保密信用預期或評估的方式，將保密和非公開評等向 CDO 和類似投資工具的經理人披露。本評等服務可以允許 CDO 經理人在有限之範圍與多種限制條件下，使用和散播信用預期或評估；但本評等服務不得控制此類使用或散播。

整體協議。本協議不應阻止貴公司、發行體（若貴公司不是發行體）或本評等服務根據適用法律和監管規定採取行動。在前述基礎上，本協議（包括根據條款進行的任何修訂）構成訂約雙方就此提供之評等事宜達成之完整與全部協議。本協議之條款取代與貴公司或貴公司代理人和顧問向本評等服務提供之資料有關的任何其他條款和條件，該些條款和條件包括但不限於貴公司或貴公司代理人和顧問向本評等服務提供此類資料的網站或其他管道中（或適用於此）的條款和條件，而且不論此類條款和條件是否在本協議生效日之前或之後被加入。此類條款和條件對本評等服務應為無效。

賠償責任的限制。本評等服務不會也不能保證評等所依據之資料的準確性、完備性或及時性，以及因使用這些資料而獲致的結果。本評等服務不作出明示或默示的保

證，包括但不限於對特定目的或用途的適銷性或適用性的任何保證。本評等服務、其聯屬企業或第三方供應商或它們的任何管理人士、董事、股東、雇員或代理人，不須對貴公司、貴公司聯屬企業或任何個人，因任何不準確性、錯誤或遺漏而代表各自直接或間接利益而提出的索賠負責，且不論所提供評等或相關分析服務產生或相關的原因、訴訟、賠償（結果性的、特別的、間接的、附帶的、懲罰性的、補充性的、懲戒性的或其他）、索賠、債務、成本、費用、法律費用或損失（包括但不限於所損失的收入或所損失的利潤和機會成本），甚至在被告知此類損失或其他數額的可能性時皆然；但若在貴公司和本評等服務作為各方參與的訴訟程序中，管轄法院最終裁判的此類損失或其他數額係源於本評等服務疏忽、故意的不法行為或有意之不當行為，則為例外情況。此外，在不對前文構成限制的前提下，對於貴公司、貴公司聯屬企業或任何個人因依據任何看來是顧問或推薦意見而做出的任何決定而代表各自利益提出的索賠，本評等服務均不須負法律責任。儘管如此，如果本評等服務必須對貴公司、貴公司聯屬企業或任何個人根據本協議代表各自利益提出的損失索賠負責時，則賠償總額不得超過中華信評就本評等服務在該訴訟之前獲得之服務費用的總額。無論有關訴訟、賠償、索賠、責任、成本、支出或損失的形式如何，是屬於契約、法規或侵權（包括但不限於過失）或其他性質，本項的條文均將適用。各方不會放棄根據法律所獲賦予的保障、特權或辯護權利。

協議終止。任何一方均可在任何時間在向對方發出書面通知後終止本協議。除非明確規定僅在本協議有效期內有效，否則所有條款和條件在本協議終止後均繼續有效。

無第三方受益人。本協議或發佈之評等均不擬也不應被詮釋為代表任何第三者（包括但不限於任何接受評等的一方）設定任何權利。本協議或發出之評等不擬以任何人作其第三受益人。

約束力。本協議對本協議訂約雙方及其繼承人和受讓人均有約束力並利益及之。

可分割性。倘若本協議中有任何條款或條文被視為失效、無效或不能強制執行，則本協議其餘的條款或條文將不會因而受影響、減少效力或失效，且將各自具有法律所容許的最大效力和強制執行性。

修訂。本協議不得進行修訂或取代，除非以特別提及本協議的書面並且由雙方授權代表簽署或以雙方同意的電子簽署方式執行。

管轄法律。本協議及依其提供之各項評等均受中華民國法律所管轄。訂約雙方不能撤銷地同意，對於因本協議引起或有關的任何爭議，必須以台北地方法院作為管轄法院。如果本協議存在中英文二個版本，訂約雙方同意以中文本為準。

www.taiwanratings.com

台灣積體電路製造股份有限公司

董事會會議記錄

(中華民國一百零一年度第二次董事常會)

(節錄本)

時 間： 壹、中華民國一百零二年五月十三日下午四點

貳、中華民國一百零二年五月十四日上午九點

地 點： 台北市基隆路一段三三三號十八樓一八〇三室

親自出席董事共九人： 張忠謀、曾繁城、Peter L. Bonfield、施振榮、
Thomas J. Engibous、鄒至莊、陳國慈、李鍾熙、
蔡力行

主 席： 張忠謀 博士

記 錄： 方淑華

列席人員： (略)

(前略)

八、 決議事項

(前略)

第五項： 提請本會核准於不高於新台幣 45,000,000,000 元之額度內（按美金對新台幣匯率 1：29.8 計算，折合美金約 1,510,000,000 元）於國內市場分次募集無擔保普通公司債以支應本公司產能擴充之資金需求，並核准就上述公司債向主管機關申請發行，並於台灣證券櫃檯買賣中心上櫃交易；另請授權董事長決定上述公司債之主要條款及發行時間。

經提案表決全體出席董事一致通過決議如下：

決議：照案通過。

(後略)

台灣積體電路製造股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

台灣積體電路製造股份有限公司本次為募集發行一〇二年度第三期無擔保普通公司債，發行總額上限為新臺幣壹佰貳拾伍億元整，票面金額均為新臺幣壹仟萬元整，向金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，台灣積體電路製造股份有限公司本次向金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此 致

台灣積體電路製造股份有限公司

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 高 逸



中 華 民 國 一 〇 二 年 七 月 十 六 日

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長：張忠謀

